

# 江苏长电科技股份有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书



发行人:	江苏长电科技股份有限公司
注册总额度:	40 亿元
本期发行金额:	20 亿元
本期发行利率	固定利率
发行期限:	5 年
担保情况:	无
信用评级机构及评级结果	经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用级别为 AA+, 评级展望为稳定

主承销商、簿记管理人: 招商银行股份有限公司



联席承销商: 中国工商银行股份有限公司



二〇一九年九月

## 重要提示

本公司发行的本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司已批准本募集说明书，公司承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

## 目录

第一章 释义 .....	4
第二章 风险提示及说明 .....	10
一、中期票据的投资风险 .....	10
二、发行人相关风险 .....	10
第三章 发行条款 .....	19
一、主要发行条款 .....	19
二、发行安排 .....	20
第四章 募集资金运用 .....	22
一、本次注册中期票据募集资金运用 .....	22
二、发行人承诺 .....	24
三、发行人补充偿债计划 .....	24
第五章 公司基本情况 .....	25
一、公司基本情况 .....	25
二、发行人历史沿革 .....	25
三、控股股东及实际控制人 .....	27
四、发行人的独立性 .....	29
五、发行人重要权益投资 .....	30
六、发行人治理情况 .....	35
七、发行人董事、监事和高级管理人员 .....	42
八、发行人业务范围及主要业务情况 .....	47
九、发行人在建工程与拟建工程 .....	56
十、发行人业务发展目标 .....	58
十一、发行人所在行业情况 .....	58
十二、发行人在行业中的地位和竞争优势 .....	70
第六章 发行人主要财务状况 .....	75
一、财务报表及审计意见 .....	75
二、财务报表适用的会计制度及主要会计政策变更情况 .....	75
三、财务报表合并范围及变动情况 .....	77

四、发行人近三年及一期财务报表 .....	79
五、主要财务数据及指标分析 .....	87
六、有息债务 .....	108
七、关联交易 .....	112
八、或有事项 .....	122
九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 .....	123
十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 .....	124
十一、海外投资情况 .....	124
十二、直接债务融资计划 .....	125
第七章 发行人资信状况 .....	126
一、公司债务融资的历史主体评级 .....	126
二、中诚信国际评级报告摘要 .....	127
三、跟踪评级有关安排 .....	129
四、公司其他资信情况 .....	129
第八章 担保 .....	132
第九章 税项 .....	133
一、投资债务融资工具所纳税项 .....	133
二、声明 .....	134
第十章 信息披露安排 .....	135
一、本期债务融资工具发行前的信息披露 .....	135
二、存续期内重大事项的信息披露 .....	135
三、本期中期票据存续期内的定期信息披露安排 .....	135
四、本期中期票据本息兑付前的信息披露安排 .....	136
五、发行人承诺 .....	136
第十一章 投资者保护机制 .....	138
一、违约事件 .....	138
二、违约责任 .....	138
三、投资者保护机制 .....	138
四、不可抗力 .....	143
六、弃权 .....	143

第十二章 发行有关机构 .....	145
一、发行有关机构的信息披露 .....	145
二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 .....	147
第十三章 备查文件 .....	148
一、备查文件 .....	148
二、查询地址 .....	148
三、查询网站 .....	148
附录 指标计算公式 .....	150

## 第一章 释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

### 一、常用词语释义

“发行人/公司/本公司/长电科技”	指	江苏长电科技股份有限公司
“中期票据”	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具
“本期中期票据”	指	“江苏长电科技股份有限公司 2019 年度第一期中期票据”
“本次发行”	指	本期中期票据的发行
“募集说明书”	指	公司为发行本期中期票据并向投资者披露发行相关信息而制作的《江苏长电科技股份有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书》
“发行文件”	指	在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书）
“簿记管理人”	指	制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据由招商银行股份有限公司担任
“簿记建档”	指	发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿按约定的定价和配售方式确定最终发行利率价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理

“承销团”	指	由主承销商为本期发行组织的由主承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销团
“承销协议”	指	主承销商与发行人签订的《江苏长电科技股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》
“余额包销”	指	本期中期票据的主承销商按照《江苏长电科技股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期中期票据全部自行购入
“法定节假日”	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
“工作日”	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
“最近三年”	指	2016 年度、2017 年度及 2018 年度
“最近一期”	指	2019 年 1-6 月
“最近三年及一期”	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月
“元”	指	如无特别说明，指人民币元
“上海清算所”	指	银行间市场清算所股份有限公司
“交易商协会”	指	中国银行间市场交易商协会
“北金所”	指	北京金融资产交易所有限公司
“银行间市场”	指	全国银行间债券市场
“中诚信国际”	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
“《公司法》”	指	《中华人民共和国公司法》
“《管理办法》”	指	由中国人民银行制定，2008 年 3 月 15 日第五次行长办公会公布的《非金融企业债务融资工具管理办法》

<b>封装</b>	指	将集成电路或分立器件芯片装入特制的管壳或用特等材料将其包容起来，保护芯片免受外界影响而能稳定可靠地工作；同时通过封装的不同形式，可以方便地装配（焊接）于各类整机
<b>IC/集成电路/芯片</b>	指	集成电路（Integrated Circuit,简称IC，俗称芯片）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
<b>分立器件/TR</b>	指	只具备单一功能的电路，包括电容、电阻、晶体管和熔断丝等
<b>IDM</b>	指	从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及产品销售的垂直整合型公司
<b>SiP</b>	指	系统级封装
<b>FBP</b>	指	平面凸点式封装
<b>QFN</b>	指	四侧无引脚扁平封装
<b>CSP</b>	指	芯片尺寸封装
<b>DIP</b>	指	双列直插式封装
<b>SOP</b>	指	小外型封装
<b>SSOP</b>	指	窄间距小外型塑料封装
<b>QFP</b>	指	方型扁平式封装
<b>PGA</b>	指	插针网格阵列封装
<b>TQFP</b>	指	薄型四方扁平封装
<b>BGA</b>	指	球栅阵列封装
<b>TSV</b>	指	硅穿孔封装



<b>WLCSP</b>	指	圆片级芯片尺寸封装
<b>SOD</b>	指	小外型（片式）二极管
<b>SOT</b>	指	小外型（片式）半导体
<b>TSOP</b>	指	薄的缩小型 SOP
<b>FC</b>	指	倒装芯片
<b>MCM</b>	指	多芯片组件
<b>MIS</b>	指	微间距系统引线框
<b>MOSFET</b>	指	金属氧化物半导体场效应管
<b>3M FF</b>	指	300万像素固定对焦
<b>5M AF</b>	指	500万像素自动对焦
<b>Flip Chip on L/F</b>	指	倒装在引线框上的集成电路封装
<b>MEMS</b>	指	微机电封装
<b>hfe</b>	指	晶体管电流放大系数
<b>Bumping</b>	指	晶圆凸块技术，一种中道封装技术
<b>eWLB</b>	指	Embedded Wafer Level Ball Grid Array的缩写，嵌入式晶圆级球栅阵列
<b>eWLCSP™</b>	指	Embedded Wafer Level Chip Scale Packaging的缩写，嵌入式晶圆级芯片尺寸封装
<b>WB</b>	指	Wire Bond的缩写，引线焊接封装
<b>FCOL</b>	指	FlipChip on leadframe的缩写，金属框架上的倒装芯片封装
<b>OSAT</b>	指	半导体委外封测
<b>新潮集团</b>	指	江苏新潮科技集团有限公司
<b>长电先进</b>	指	江阴长电先进封装有限公司

新顺微电子	指	江阴新顺微电子有限公司
长电国际	指	长电国际（香港）贸易投资有限公司
芯长电子	指	江阴芯长电子材料有限公司
新基电子	指	江阴新基电子设备有限公司
深圳长电	指	深圳长电科技有限公司
长电科技（宿迁）	指	长电科技（宿迁）有限公司
长电科技（滁州）	指	长电科技（滁州）有限公司
新晟电子	指	江阴新晟电子有限公司
芯智联	指	江阴芯智联电子科技有限公司
长江电器	指	江阴长江电器有限公司
长电新科	指	苏州长电新科投资有限公司
长电新朋	指	苏州长电新朋投资有限公司
JCET-SC	指	JCET-SC（SINGAPORE） PTE. LTD
星科金朋/SCL	指	STATS CHIPPAC PTE. LTD.
产业基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
华芯投资	指	华芯投资管理有限责任公司
芯电半导体	指	芯电半导体（上海）有限公司
中芯国际	指	Semiconductor Manufacturing International Corporation（中芯国际集成电路制造有限公司）
华进半导体	指	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司
JSCK/长电韩国	指	JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED
芯鑫租赁	指	芯鑫融资租赁有限责任公司
JSCC/星科金朋江阴	指	星科金朋半导体（江阴）有限公司

<b>JSCT</b>	指	星科金朋集成电路测试（江阴）有限公司
<b>星科金朋南韩</b>	指	STATS ChipPAC Korea Ltd.
<b>科林环境</b>	指	江阴城东科林环境有限公司
<b>达仕新能源</b>	指	公司全资子公司江阴达仕新能源科技有限公司
<b>台星科</b>	指	台星科股份有限公司及台星科企业股份有限公司

## 第二章 风险提示及说明

本期中期票据无担保，中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认真地考虑下述各项风险因素：

### 一、中期票据的投资风险

#### （一）利率风险

本期中期票据的利率水平是根据当前市场的利率水平和本期中期票据信用评级确定的。在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益造成一定程度的影响。

#### （二）流动性风险

本期中期票据将在银行间市场上进行交易，主要取决于市场上投资人对该债券的价值需求与风险判断，在转让时可能由于无法及时找到交易对手而难以将中期票据变现，存在一定的流动性风险。

#### （三）偿付风险

在本期中期票据的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差，从而导致本期中票不能如期足额兑付，对投资者按期收回本息构成风险。

### 二、发行人相关风险

#### （一）财务风险

##### 1、主营业务盈利能力较弱且波动性较大的风险

近三年又一期，发行人分别实现营业收入 191.55 亿元、238.56 亿元、238.56 亿元和 91.48 亿元，主营业务毛利率分别为 11.82%、11.71%、11.43%和 9.30%，营业利润分别为-45,635.06 万元、-2,188.62 万元，-80,383.87 万元和-45,892.47 万元。

近三年又一期发行人盈利能力波动变化较大且主营业务能力较弱，2015 年 8 月，发行人合并星科金朋，星科金朋的亏损拖累发行人整体的盈利能力，使 2016 年营业利润亏损较大。2017-2018 年主营业务有了明显改善，但盈利能力有待改善，2018 年亏损扩大主要系公司前期收购星科金朋当期计提商誉减值准备及坏账准备导致资产减值损失较大。发行人存在主营业务盈利能力较弱且波动性较大

的风险。

## 2、净利润为负，利润依赖政府补贴的风险

近三年又一期,发行人实现营业利润分别为-44,497.83 万元、-2,188.62 万元、-80,383.87 万元和-45,892.47 万元,实现净利润分别为-31,613.35 万元、7,353.98 万元、-92,664.05 万元和-25,799.75 万元,其中营业外收入分别为 21,838.02 万元、7,017.31 万元、986.37 万元和 47.69 万元,2017 年后营业外收入下降主要是由财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》,将政府补贴计入其他收益科目。2017 年、2018 年发行人其他收益为 28,744.63 万元和 15,484.71 万元。发行人净利润依赖于政府补贴,发行人存在净利润对政府补贴依赖度较高的风险。

## 3、汇率波动风险

2016-2018 年发行人产品出口收入分别为 157.39 亿元、194.97 亿元、189.06 亿元,占同期营业收入的比重分别为 82.17%、81.73%和 79.25%。公司出口产品主要以美元结算,因此汇率波动将对公司经营产生一定影响。人民币的升值一方面直接降低以美元结算的国外订单收入和利润水平,另一方面还导致公司出口产品价格竞争力的下降,从而影响公司产品的出口量。如果未来人民币继续进一步升值,将对公司利润额产生一定的影响。

由于发行人子公司星科金朋的日常运营中涉及美元、新元、韩元等多种货币,而长电科技的合并报表采用人民币编制。伴随着人民币、美元、新元、韩元等货币之间的汇率变动,将可能给发行人未来运营带来汇兑风险。

## 4、未来资本支出较大的风险

半导体行业是资金和技术密集型行业,近三年又一期累计研发投入约 6.38 亿元、7.84 亿元、8.88 亿元和 3.49 亿元,用于多种封装技术的研究与开发,资本投入大,为保持公司在行业中的核心竞争优势和竞争实力,未来还将有大规模的资本投入,进行生产基地的建设和生产线及技术改造,将会加大发行人未来的融资压力。

## 5、经营性净现金流波动较大的风险

受行业周期影响,半导体行业国内外市场近年来波动较大,直接影响了公司的经营活动现金流量;发行人近三年又一期经营性净现金流分别为 26.69 亿元、36.57 亿元、25.09 亿元和 8.17 亿元,波动较大,面临一定风险。

## 6、存货跌价的风险

存货是发行人流动资产的主要构成部分,近三年又一期存货分别为 185,131.21 万元、231,302.72 万元、227,358.49 万元和 216,250.85 万元,在流动资产中的占比分别为 23.93%、27.21%、20.85%和 24.04%。公司按照企业会计准

则规定计提了相应的减值准备。由于各种不确定因素的影响，公司仍然存在因存货价格下降从而导致损失的可能性。

#### **7、所有者权益构成不稳定的风险**

截至2018年末，发行人所有者权益为1,229,222.40万元，其中股本160,287.46万元，资本公积1,024,249.84万元，未分配利润14,262.25万元，少数股东权益294.01万元，占所有者权益的比例分别为13.04%、83.33%、1.16%和0.02%。截至2017年末，发行人所有者权益为957,772.94万元，其中股本135,984.40万元，资本公积689,122.52万元，未分配利润111,593.40万元，少数股东权益13,265.90万元，占所有者权益的比例分别为14.20%、71.95%、11.65%和1.39%。由于发行人所有者权益的各项构成变化较大，目前以资本公积为主，未分配利润与少数股东权益部分波动较大。发行人的所有者权益存在构成不稳定的风险。

#### **8、短期偿债压力增加的风险**

近三年又一期，公司负债总额分别为 2,304,696.34 万元、2,112,097.53 万元、2,213,223.69 万元和 2,064,825.21 万元，流动负债分别为 1,138,259.45 万元、1,309,859.22 万元、1,840,487.72 万元和 1,696,006.85 万元，流动负债占负债总额的比重分别为 49.39%、62.02%和 83.16%和 82.14%，发行人流动负债占比较大，负债结构不尽合理，存在一定的流动性风险。如果将来公司未能合理管理现金流，短期负债规模较大将导致公司短期内偿债风险增加。

#### **9、受限资产金额较大的风险**

公司资产受限的原因主要为向银行融资而进行的资产抵押或质押。截至2019年6月末，发行人受限资产的账面价值合计986,941.09万元，其中货币资金的受限金额为78,950.72万元，主要为银票承兑汇票及保函、海关保证金；用于质押的应收票据账面价值为1,733.56万元；为取得银行借款用于抵押的固定资产账面价值为875,418.10万元；为取得银行借款用于质押的无形资产的账面价值为30,838.70万元。公司受限资产金额较大，将会使公司面临变现能力降低的风险。

#### **10、应收账款较大的风险**

近三年又一期，公司应收账款账面值分别为272,179.98万元、284,123.33万元、277,938.26万元和270,799.73万元，占流动资产比例分别为35.18%、33.42%、25.49%和30.10%，近几年应收账款规模较大，主要是销售商品的货款，公司的生产规模逐年扩大，为巩固原有的市场份额并开拓新的市场区域和客户群，公司采取灵活的销售政策，针对重点和长期客户给予一定的信用期，但若无法按时收回应收账款，可能在一定程度上对发行人的资产质量和盈利能力产生不利影响。

#### **11、关联交易风险**

发行人与其关联方存在一定量的关联交易，截至2018年末，发行人向关联方

采购原材料金额为13,895.98万元, 发行人向关联方销售商品金额为15,072.04万元, 发行人向关联方出租资产, 收取租金为2,135.32万元, 同时发行人与关联方存在借款担保关系以及其他关联交易。发行人关联交易活动遵循商业原则, 基本做到公正、公平、公开, 关联交易的价格遵循市场价格的原则, 且关联交易占销售采购比例较小, 但若发行人未来较依赖关联方交易, 可能降低发行人的竞争能力和独立性。

## 12、期间费用占比较高的风险

近三年及一期, 发行人期间费用合计分别为279,296.95万元、323,230.71万元、341,530.20万元和145,888.35万元, 占营业收入的比例分别为14.58%、13.55%、14.32%、15.95%, 发行人存在期间费用占比较高的风险。

## 13、资产流动性较差的风险

近三年又一期, 发行人的流动比率分别为 0.68、0.65、0.59 和 0.53, 速动比率分别为 0.52、0.47、0.47 和 0.40, 资产流动性相对较差。发行人近几年短期借款持续大幅增加, 流动负债增加较多, 流动比率和速动比率均较低。

## 14、主营业务集中度较高的风险

近三年及一期公司营业收入分别为 191.54 亿元、238.56 亿元、238.56 亿元和 91.48 亿元, 近三年呈稳中有增态势。其中芯片封测的主营业务收入分别为 187.23 亿元、234.13 亿元、233.36 亿元, 占公司营业收入的比重分别为 97.75%、98.14%、97.82%, 其他收入主要来自于芯片和分立器件的销售业务, 占比较小。芯片封装测试业务在发行人主营业务中的占比过大, 当发行人主营业务过于集中时, 若主营业务对应行业出现市场周期性波动、或未来市场出现萎缩, 则会影响到发行人的主营业务, 导致盈利能力的下降。

## 15、投资活动现金流净额持续为负的风险

近三年又一期发行人的投资活动现金流净额分别为 -429,686.80 万元、-362,304.29 万元、-355,585.73 万元和 -142,939.75 万元, 持续为负。发行人为了加快技术推广和客户导入, 发挥滁州、宿迁低成本生产基地作用, 保持传统产品的竞争力, 目前发行人正在加大对重点投资项目的投入, 包括系统集成封装 SiP, 晶圆级封装 EWL B、WLCSP、BUMP, 射频封装 LGA, 倒装 FCBGA、FCOL 等高端产品项目, 截止 2018 年末, 发行人在建项目账面余额约 34.55 亿元, 未来拟建工程预计投入约 30 亿元。集成电路技术含量要求较高, 期初设备的投入较大, 技术更新较快, 存在项目建设支出增加的风险。

## 16、衍生产品公允价值变化较大风险

2018 年, 公司的长短期衍生金融负债余额为 13,793.51 万元, 较 2017 年增加 3,311.68 万元, 主要系星科金朋对已剥离的其原台湾子公司的最低采购承诺公允

价值变动影响，2018年最低采购承诺为13,384.94万元。由于发行人收购星科金朋产生了金额较大的衍生产品，未来衍生产品价值变化将会给发行人的盈利能力带来一定的风险。

### 17、资产减值损失与商誉减值的风险

近三年及一期，发行人资产减值损失分别为6,854.79万元、2,269.38万元、54,692.00万元和1,402.74万元，占当期营业利润的比例分别为-15.02%、-103.69%、-68.04%和-3.06%，波动较大。2018年度发行人资产减值损失较2017年增加52,422.62万元，主要来源于星科金朋商誉减值和应收账款计提坏账准备金。

发行人于2015年8月收购星科金朋集团，形成初始商誉人民币235,097.90万元，2018年度计提商誉减值损失人民币36,577.86万元。并购后星科金朋持续亏损，导致公司的整体业绩呈现亏损，该状况将在一定时期内持续。由于星科金朋整合不及预期，后续可能仍存在资产减值损失与商誉减值风险。

## （二）经营风险

### 1、行业周期性波动风险

公司所处的集成电路半导体行业具有周期性波动的特点。2008年，受全球金融危机的影响，我国集成电路半导体产业20年来首次负增长，增长率-0.4%；2009年初市场规模进一步下滑，企业普遍面临订单下降、开工率不足、产品价格整体下降等问题，并导致企业亏损。但自2009年二季度开始至2010年，行业经营出现好转，景气度开始逐渐回升。但2011-2012年，集成电路半导体行业景气度又陷入低迷，部分产品价格下滑，订单不充足。但2013年至2017年集成电路半导体行业又有所好转，呈温和增长态势。2018年下半年和2019年上半年由于存储器等产能过剩导致行业景气度下滑，故集成电路半导体行业能否保持平稳增长具有不确定性，因而仍面临一定的风险。

### 2、产品质量责任相关风险

公司业务主要以接受委托的方式为客户的集成电路和分立器件提供封装和测试服务，客户将公司封装和测试后的芯片或分立器件嵌入其产品。迄今为止，公司未因提供的封装测试服务使客户产品出现重大的产品质量问题。但是，如果出现下列情况之一，则公司有可能会承担独立或连带责任，并可能会被要求向客户或最终用户赔偿：①公司的服务未达到客户要求的质量保证标准；②含有公司封装测试后的产品因质量问题使客户产品出现重大瑕疵；③公司封装测试后的产品因质量问题而被提起诉讼。因而存在产品质量责任相关风险。

### 3、技术创新的风险

近年来，世界半导体技术以及集成电路产业正沿着摩尔定律（技术升级）和超摩尔定律（创新发展模式）两种方式快速发展。按照摩尔定律，半导体技术以硅基CMOS技术为基础，继续沿着特征尺寸越来越小的方向前进。按照超摩尔定



律，半导体技术以产品多功能化为方向，沿着多重技术创新的方式发展。工艺上的精益求精和功能上的多元化方针，对企业提出了更高的技术要求。若不能紧跟技术革新的步伐，将对企业的行业领先地位产生一定的影响。

#### 4、技术授权许可的风险

芯片凸块技术系公司子公司长电先进用于生产WLCSP产品的技术之一，为公司WLCSP产品技术的关键技术之一，由新加坡先进向长电先进授权使用，许可期限为20年（2003年8月7日 - 2023年8月7日）。长电先进在引进该技术后开发出具有自主知识产权的多项核心技术，如三维再布线技术、凸点植球技术、铜凸点互联技术等，已取得和在申请专利19项，成功实现了WLCSP产品的产业化。

虽然上述授权许可期限长，截至目前尚有7年有效期，而半导体行业技术更新速度快，目前长电先进该产品产业化技术比较成熟，是全球少数几家成功实现该产品产业化的封装测试企业之一，公司子公司长电国际持有新加坡先进股份为19.06%，双方具有稳定的合作关系，但仍不能排除上述授权许可发生变化或进一步对外许可从而对公司业务及经营业绩可能产生不利影响。

#### 5、原材料价格波动风险

公司产品所需主要原材料为芯片、金丝、引线框架等，其中芯片主要材质为单晶硅，受单晶硅价格波动因素影响较大。金丝主要材质为黄金，引线框架主要材质为铜。2016年至2018年，上述主要原材料成本合计占公司生产成本的比重较高。近年来，单晶硅、铜、黄金价格波动较大，公司原材料价格均呈现不同程度的波动使公司的定价策略、成本控制、供应链管理等方面面临较大的管理压力，并可能造成盈利水平的相应波动。

#### 6、并购海外公司引发的经营风险

2015年8月，发行人公告收购境外星科金朋公司，通过整合协同星科金朋的先进封装技术、客户资源、产能分配、供应链管理等，进一步巩固公司先进封装技术水平和研发实力，提高公司行业地位和国际市场竞争力，拓展海外市场并扩大客户基础。收购完成后通过一年的整合，发行人销售收入行业内排名上升到第3名。虽然从总体来看，全球半导体行业仍然处于增长的态势，但受行业波动周期的影响，半导体行业能否保持平稳增长具有不确定性，可能对公司及标的公司整体经营业绩造成不利影响。并购后星科金朋持续亏损，导致公司的整体业绩呈现亏损，该状况将在一定时期内持续，使公司业绩存在下滑的风险。此外，并购对公司的管理水平、决策能力和风险控制水平提出了更高要求，若发行人不能对业务及资产实施有效的管理，将给公司的持续发展带来风险。

#### 7、突发事件引发的经营风险

发行人虽一直通过不断完善管理机制，强化内部管理，加大控制发展中的各种潜在风险的力度，如果发行人未来遭遇事故灾难、公共事件、社会安全事件、公司管理层无法履行职责等事项，可能造成公司社会形象受到影响，人员生命及

财产安全受到危害，公司治理机制不能顺利运行等，对发行人的正常经营可能造成不利影响。

#### **8、无控股股东和实际控制人，且第一大股东持股比例较低的风险**

2016年末发行人第一大股东为江苏新潮科技集团有限公司，持股比例为18.37%；2017年末公司第一大股东变为芯电半导体（上海）有限公司，持股比例为14.28%；2018年8月公司非公开发行股份募集资金36.19亿元，发行对象分别为国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司和无锡金投领航产业升级并购投资企业，发行完成后，国家集成电路基金成为公司第一大股东，持股比例为19.00%。截至2019年6月末，发行人前三大股东为国家集成电路产业基金、芯电半导体（上海）有限公司及江苏新潮科技集团有限公司，持股比例分别为19.00%、14.28%和6.46%。三个股东互相不存在一致行动关系，公司无控股股东和实际控制人。此外，公司近年来第一大股东变化频繁，且最大股东持股比例一直维持在20%以内，三大股东任何一方均无法单独控制董事会和管理层决策、单独支配公司行为。可能存在公司重大决策无法及时落实的风险。

#### **9、市场竞争加剧的风险**

近几年，全球半导体封测行业呈现快速整合的态势，使全球封测行业集中度大幅提高，封测行业全球第一和第三的日月光和矽品的合并，整合技术、市场等相关产业资源，抢夺订单市场，在规模和研发上进一步拉大与后面企业的距离，将使公司在市场竞争中面临较高的市场竞争压力。

#### **10、收入依赖境外销售风险**

发行人在境外拥有多家子公司。2015年10月12日，公司间接控股子公司JCET-SC通过要约收购，完成对新加坡星科金朋100%股权的收购。2018年度，公司境外销售额1,890,615.31万元，占全部营业收入的79.62%。若海外投资子公司出现业绩波动，将会给发行人主营业务收入带来较大的波动。

#### **11、国际贸易环境变化对公司未来盈利水平影响的风险**

发行人所处的集成电路行业易受国际贸易环境的影响。面对国际贸易环境的变革调整，传统的集成电路优势国家采取应对措施，一方面抢占技术高点，另一方面调动各类贸易工具应对中国产业崛起。与此同时，中美两国贸易摩擦不断升级、集成电路下游产业市场波动等不利因素叠加导致发行人下游需求疲软。但国际贸易环境的变化也让中国集成电路行业受到了前所未有的重视，政策、资本以及产业链资源不断聚集，面临困难的同时也是一种新的机遇和挑战。国际贸易环境变化可能会对公司未来的盈利能力产生影响。

### **（三）管理风险**

#### **1、规模扩张引致的管理风险**

近三年持续投资使公司资产规模及业务规模的不断扩张，2018 年末，公司的资产总额达 344.27 亿元，营业收入达 238.56 亿元，业务规模在全球半导体封装测试企业中排名第 3 位（资料来源：芯思想）。资产及收入规模的扩张对公司的管理水平、决策能力和风险控制水平提出了更高要求，若发行人不能对业务及资产实施有效的管理，将给公司的持续发展带来风险。

## 2、人力资源风险

封装测试行业技术进步快、产品更新率高，研发能力对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。公司已与核心技术人员签订了保密协议，防止核心技术外流，并实施了各项激励政策，以保持技术人员的稳定性，但公司无法完全确保核心技术及科研开发人员不出现外流，从而给公司的可持续发展带来风险。

## 3、突发事件引发公司治理突然变化的风险

发行人通过积极改革传统的管理模式，吸收现代管理理念，经过几年的摸索、总结，已经形成了组织严密、控制严格、结构合理的组织架构，建立了董事会、管理委员会、高级管理人员互相协作、互相制衡、各司其职的较为完善的公司治理机制，但如遇突发事件，造成董事会、管理委员会和高级管理人员无法履行相应职责，对现行公司治理结构产生影响，从而改变公司现有治理结构，对发行人的正常经营可能造成不利影响。

## 4、对下属子公司管理的风险

截止到2019年6月末，发行人合并范围内的子公司共23家，且子公司除了分布在大陆及香港地区以外，还分布在新加坡、美国、韩国等7个国家，国外各子公司由于各国的政策、法律等因素，对公司经营、管理各子公司带来一定的影响，存在子公司经营风险的可能。

### （四）政策风险

集成电路半导体产业一直是我国政府重点扶持的产业，国家相继出台了一系列鼓励政策，促进了半导体产业的快速发展、技术水平不断提升。其中2000年国务院出台《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发18号文），是集成电路产业的核心政策。《集成电路产业研究与开发专项基金管理暂行办法》（财建[2005]132号）为18号文修改后的重要补充部分，按照该办法，以后每年国家将会持续提供资金来支持集成电路的研发项目，并明确将资金的申请对象扩大到封装测试企业。同时《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号），对软件、集成电路产业的企业所得税优惠政策进行了明确。规定自2008年1月1日起至2010年底，对集成电路生产企业、封装企业的投资者，以其取得的缴纳企业所得税后的利润，直接投资于本企业增加注册资本，或作为资本投资开办其他集成电路生产企业、封装企业，经营期不少于5年的，按40%的比例退还

其再投资部分已缴纳的企业所得税税款。2019年5月国常会决定延续集成电路企业所得税优惠政策，吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。会议决定，在已对集成电路生产企业或项目按规定的不同条件分别实行企业所得税“两免三减半”或“五免五减半”的基础上，继续实施2011年明确的所得税“两免三减半”优惠政策。同时，有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。

从全球范围而言，公司所在集成电路行业一直受到各国政府的关注和政策支持。根据“十三五”发展规划纲要以及“中国制造 2025”国家产业发展战略，集成电路行业是我国国家产业政策重点发展的行业之一。从目前国家政策变化趋势看，集成电路产业将继续得到国家和地方政府的重视，并将在政策、资金、市场等方面给予进一步的支持。随着经济全球化和产业结构调整的不断深入，国家若对集成电路行业的政策进行调整，将带来整个行业格局的变化。公司作为半导体产业链后端的封装测试企业，是我国本土民族企业的龙头，产品 50%以上用于出口，直接与国际知名企业竞争。如果上述政策发生变化，将对公司造成一定的影响。

## 第三章 发行条款

### 一、主要发行条款

- 1、中期票据名称：江苏长电科技股份有限公司 2019 年度第一期中期票据
- 2、发行人：江苏长电科技股份有限公司
- 3、中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记托管。
- 4、发行人中期票据注册文号“中市协注【2019】MTN【 】”号。
- 5、待偿还直接债务融资余额：截至本募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还直接债务融资余额为人民币 0.00 亿元。
- 6、注册金额：人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000.00 元）。
- 7、本期发行中期票据金额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000.00 元）。
- 8、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100 元）。
- 9、中期票据期限：不超过五年。
- 10、计息年度天数：平年 365 天，闰年 366 天。
- 11、发行价格：本期中期票据采用面值发行。
- 12、发行利率：发行利率采用固定利率形式，利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，由集中簿记建档方式确定，在本期中期票据存续期内保持不变，不计算复利，逾期不另计利息。
- 13、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
- 14、承销方式：主承销商和联席主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据。
- 15、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。
- 16、簿记建档时间：2019 年 月 日。
- 17、发行首日：2019 年 月 日。
- 18、缴款日：2019 年 月 日。
- 19、债权债务登记日：2019 年 月 日。
- 20、起息日：2019 年 月 日。
- 21、上市流通日：2019 年 月 日。
- 22、还本付息方式：本期中期票据的利息分年支付，但最后一期利息随本金

的兑付一起支付。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

23、兑付日:2019 年 月 日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)。

24、兑付价格:按中期票据面值兑付,即人民币壹佰元/每百元面值。

25、兑付方式:本期中期票据的本息兑付通过托管人办理。本息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。根据国家税收法律法规,投资人投资本期融资券应缴纳的有关税费由投资人自行承担。

26、信用评级机构及评级结果:中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的本期中期票据信用等级为 AA+级,发行人主体信用评级为 AA+级,评级展望为稳定。

27、中期票据信用增进:本期中期票据不设信用增进。

28、本期中期票据的托管人:银行间市场清算所股份有限公司。

29、赎回条款或回售条款:无

30、集中簿记建档系统技术支持机构:北金所

## 二、发行安排

### (一) 集中簿记建档安排

1、本期中期票据簿记管理人为招商银行股份有限公司,本期中期票据承销团成员须在 2019 年 月 日,通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《江苏长电科技股份有限公司 2019 年度第一期中期票据申购要约》(以下简称“《申购要约》”),申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元(含 1,000 万元),申购金额超过 1,000 万元的必须是 500 万元的整数倍。

### (二) 分销安排

1、认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者(国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外)。

2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户,或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户;其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。

### (三) 缴款和结算安排

1、缴款时间:2019 年 月 日。

2、簿记管理人将在 2019 年 月 日通过集中簿记建档系统发送《江苏长电科技股份有限公司 2019 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配中期票据面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

户名：招商银行

开户行：招商银行

账号：910051040159917010

支付系统行号：308584000013

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期中期票据发行结束后，中期票据认购人可按照有关主管机构的规定进行中期票据的转让、质押。

#### **（四）登记托管安排**

本期中期票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期中期票据的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期中期票据进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

#### **（五）上市流通安排**

本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2019 年 月 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

#### **（六）其他**

无。

## 第四章 募集资金运用

### 一、本次注册中期票据募集资金运用

近年来，公司已进入新一轮快速增长期，随着经营规模的日益扩大，公司对营运资金的需求也逐渐提高，同时公司需要构建更加多元化的融资渠道，以降低融资成本，优化债务结构，进一步提高财务管理水平。

发行人本期中期票据的注册金额为不超过人民币 40 亿元，首期中期票据发行金额为人民币 20 亿元，其中拟 18 亿用于归还发行人本部及子公司金融机构借款、2 亿用于补充营运资金。

#### （一）偿付有息债务

截至 2019 年 6 月末，发行人合并口径下的短期借款为 1,106,666.02 万元，一年内到期的长期借款为 49,728.00 万元，长期借款为 221,567.28 万元。2018 年度，发行人筹资活动现金流出 1,032,198.80 万元；2019 年 1-6 月，发行人筹资活动现金流出 1,035,908.36 万元。发行人计划偿还的有息债务明细如下：

图表 4.1：发行人本期中期票据拟偿还的有息债务明细

单位：人民币万元

贷款行	金额	借款日	到期日	利率	担保方式
兴业银行	10,000.00	2019/4/12	2019/10/11	4.79	保证
兴业银行	10,000.00	2019/4/16	2019/10/15	4.79	保证
兴业银行	12,500.00	2019/4/16	2019/10/15	4.79	保证
建设银行	5,000.00	2018/10/23	2019/10/22	4.35	保证
进出口银行	2,600.00	2019/5/17	2019/10/22	4.35	保证
农业银行	10,000.00	2018/10/23	2019/10/22	4.57	保证
农商行	3,000.00	2018/10/26	2019/10/25	5.30	保证
广发银行	10,000.00	2018/11/22	2019/11/18	4.15	保证
广发银行	5,000.00	2019/2/18	2019/11/21	4.79	保证
华夏银行	6,500.00	2018/11/27	2019/11/28	4.93	保证
南洋银行	5,000.00	2018/12/28	2019/12/1	4.79	保证
南洋银行	7,000.00	2018/11/27	2019/12/2	3.70	保证
招商银行	20,000.00	2019/6/4	2019/12/3	4.35	保证
建设银行	5,000.00	2018/12/18	2019/12/17	4.35	保证
宿迁中行	6,000.00	2018/12/26	2019/12/17	4.35	保证
邮储银行	20,000.00	2018/12/25	2019/12/23	4.26	保证
广发银行	25,000.00	2019/1/2	2020/1/1	4.79	保证
建设银行	9,500.00	2019/1/3	2020/1/2	4.35	保证
交通银行	4,800.00	2019/1/3	2020/1/2	4.57	保证
交通银行	4,700.00	2019/1/3	2020/1/2	4.57	保证
中国银行	5,000.00	2019/1/10	2020/1/2	4.35	抵押
建设银行	5,500.00	2019/1/4	2020/1/3	4.35	保证
华夏银行	20,000.00	2019/1/3	2020/1/6	4.93	保证



贷款行	金额	借款日	到期日	利率	担保方式
中信银行	10,000.00	2019/1/10	2020/1/10	4.25	保证
华夏银行	7,800.00	2019/1/24	2020/1/24	4.93	保证
中信银行	10,000.00	2019/2/15	2020/2/7	4.35	保证
华夏银行	12,800.00	2019/2/12	2020/2/13	4.93	保证
交通银行	4,000.00	2019/2/25	2020/2/24	4.79	保证
交通银行	6,300.00	2019/2/25	2020/2/24	4.79	保证
<b>合计</b>	<b>263,000.00</b>				

## (二) 补充营运资金

发行人近年来主营业务发展速度较快，整体运营成本支出也相应增长。2016-2018年及2019年1-6月，发行人营业收入分别为1,915,452.77万元、2,385,551.24万元、2,385,648.74万元和914,846.16万元；营业成本分别为1,689,061.57万元、2,106,101.27万元、2,113,075.83万元和829,739.98万元；公司经营产生的现金流出分别为1,732,983.35万元、2,203,054.79万元、2,323,472.32万元和950,447.76万元，其中购买商品、接受劳务支付的现金分别为1,243,752.35万元、1,701,238.11万元、1,808,940.44万元和717,599.08万元。发行人本次补充的流动资金主要用于支付到期的应付票据，截至2019年6月末，发行人的应付票据为52,148.81万元。

发行人合并口径下的营运资金需求测算见下表：

图表4.2：发行人营运资金需求测算表

项目	财务数据
2018年度营业收入（亿元）	238.56
2018年度销售毛利率（%）	11.43
2019年预计营业收入年增长率（%）	11.60
2018年度存货周转率（次）	9.21
2018年度应收账款周转率（次）	8.49
2018年度应付账款周转率（次）	4.75
2018年度存货周转天数（天）	39.07
2018年度应收账款周转天数（天）	42.41
2018年度应付账款周转天数（天）	75.73

2018年度营业周期（天）	5.75
2018年度营业周转率（次）	62.61
<b>营运资金需求量（亿元）</b>	<b>3.77</b>

注：营运资金缺口计算公式如下：

营运资金需求量=2018年度销售收入×（1-2018年度销售毛利率）×（1+2019年度预计销售收入年增长率）/2018年度营业周转率；

营业周转率=360/营业周期；

营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数；

存货周转天数=360/存货周转率，应收账款周转天数=360/应收账款周转率，应付账款周转天数=360/应付账款周转率；

2019年度预计营业收入年增长率取发行人近三年营业收入的平均增长率。

结合发行人实际需求，本次募集资金中的 2 亿元用于补充发行人流动性较为合理，可满足集团的实际需求。

## 二、发行人承诺

公司承诺在本次发行的中期票据存续期间内，若变更募集资金用途，将及时披露有关信息。本次募集资金仅应用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不用于长期投资，不用于房地产的土地储备、项目开发建设、房地产项目开发贷款等与房地产相关的业务。本次募集资金严禁进入证券、期货市场、土地、房地产、固定资产及股本权益性投资等国家规定禁入领域。

发行人承诺本次债务融资工具的募集资金不用于并购或收购资产，承诺募集资金应用符合国家法律法规及政策要求，不得用于长期投资以及委托贷款、担保等金融业务。

## 三、发行人补充偿债计划

随着市场环境的改善，发行人主营业务收入今年呈增长趋势。近三年又一期，发行人分别实现营业收入191.55亿元、238.56亿元、238.56亿元和91.48亿元，销售收入保持稳定的增长趋势。因此，发行人比较充裕的货币资金和稳步增长的主营业务收入将成为本期中期票据的本息偿付的主要来源。

同时为了确保本期中期票据本息的正常兑付、维护本期中期票据券持有人的合法利益，发行人制订了一整套偿债工作计划，包括设立本期中期票据偿付工作小组、合理安排资金的使用并制定管理措施、加强信息披露等，以确保本期中期票据安全兑付。

## 第五章 公司基本情况

### 一、公司基本情况

- 1、中文名称：江苏长电科技股份有限公司
- 2、英文名称：Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co.,Ltd.
- 3、注册地址：江苏省无锡市江阴市澄江镇长山路78号
- 4、法定代表人：LEE CHOON HEUNG
- 5、设立日期：1998年11月6日
- 6、营业执照注册号：91320200142248781B
- 7、发行人联系人：沈菊
- 8、发行人联系电话：0510-86199126
- 9、发行人传真号码：0510-86199000
- 10、发行人邮编：214429
- 11、注册资本：人民币160,287.4555万元
- 12、企业类型：股份有限公司
- 13、经营范围：研制、开发、生产、销售半导体，电子原件，专用电子电气装置，销售本企业自产机电产品及成套设备，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，开展本企业进料加工和“三来一补”业务；道路普通货物运输。

### 二、发行人历史沿革

发行人的前身是江阴长江电子实业有限公司（简称实业有限公司），成立于1998年11月6日。江阴长江电子实业有限公司是在江阴长江电子实业公司（简称实业公司）的基础上改制设立的有限责任公司，是由江阴长江电子实业公司联合江阴长江电子实业公司工会、厦门永红电子有限公司、宁波康强电子有限公司、连云港华威电子集团有限公司共同出资设立。

2000年5月28日，实业有限公司通过未分配利润转增资本，注册资本金增加为5,416.8万元。2000年7月12日，实业公司将其所持有的221.6628万元出资转让给自然人王新潮，将517.2132万元出资转让给实业公司工会，实业公司工会及王新潮接受让出资额以1:1比例对实业有限公司现金增资共计738.876万元，其中，王新潮投入现金221.6628万元，持有公司注册资本221.6628万元；实业公司工会投入现金517.2132万元，持有公司注册资本517.6628万元。

2000年7月27日，经股东会决议通过，实业有限公司吸收上海恒通资讯网络有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司增资，注册资本增加到8,272.862万元。2000年10月9日，江阴市新潮科技有限公司分别受让自然人王新潮和实业公司工

会所持有的443.3256万元和2,809.0924万元出资，本次转让后，新潮科技持有实业有限公司的出资为3,252.418万元，占注册资本的39.31%；2000年10月25日，上海华易投资有限公司受让实业公司所持有的1,000万元出资；并以1: 1.75的溢价向公司增资，投入现金2,147.4915万元，持有实业有限公司注册资本1,227.138万元。

2000年11月11日，实业有限公司的全体股东一致同意以2000年10月30日为审计基准日，以经审计后的公司净资产额12,787万元，按1: 1比例折合的股本为12,787万元。2000年12月，经江苏省人民政府（2000）227号文批准，发行人由江阴长江电子实业有限公司整体变更为江苏长电科技股份有限公司。

2003年4月28日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）40号核准，公司于2003年5月19日向社会公开发行境内上市人民币普通股5,500万股，并于2003年6月3日在上海证券交易所上市交易（股票代码：600584）。本次发行后，公司股本变更为18,287.00万元。

2004年4月19日，公司召开的2003年度股东大会审议通过了公司《2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，决定以资本公积转增股本，每10股转增6股，本次转增后股本变更为29,259.20万元。

2007年1月10日，公司获取中国证监会证监发行字（2007）2号文“关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的通知”，2007年1月增发新股8,000万股A股。此次增发后，公司股本变更为37,259.20万元。

2008年4月18日，公司召开的2007年度股东大会审议通过《2007年度利润分配方案》，以公司以资本公积和未分配利润37,259.20万元转增股本，每10股转增10股，转增后公司股本变更为74,518.40 万元。

2010年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1328号文件核准，公司向原股东配售10,794.961万股的新股。本次配股后，发行人注册资本和股本变更为85,313.361万元。

2014年9月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]874号文件核准，核准长电科技非公开发行不超过235,404,896股新股，有效期6个月，公司非公开发行人民币普通股（A股）131,436,390股。本次增发后，发行人注册资本和股本变更为98,457.00万元。

2015年8月，长电科技通过境内成员公司在新加坡设立的JECT-SC公司，以7.8亿美元收购了新加坡星科金朋。

2015年11月，产业基金依据《债转股协议》将对长电新朋股东借款转换为长电新朋股权。上述转股完成后，长电科技、产业基金和芯电半导体分别持有长电新科 50.98%、29.41%和 19.61%股权，长电新科和产业基金分别持有长电新朋 77.27%和 22.73%股权。

2017年6月,公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,公司第一大股东由新潮集团变更为芯电半导体,第二大股东新潮集团和第三大股东产业基金分别持股13.99%和9.54%。2018年3月,公司全资子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司以3.5亿元人民币(等值美元现金出资),与其他投资方共同对芯鑫融资租赁有限责任公司(简称“芯鑫租赁”)进行增资。公司占芯鑫租赁注册资本为3.156%。

2018年5月,公司非公开发行股票事项获得证监会通过,此次发行对象为产业基金、芯电半导体和金投领航。2018年8月,公司非公开发行股票事项实施完成,公司前三大股东变更为:产业基金持股19%,芯电半导体持股14.28%,新潮集团持股10.42%,三家主要股东的股权比例仍较为接近,同时三家股东仍各提名2名非独立董事,且互相之间不存在一致行动关系或安排。截至目前,本公司仍无控股股东、无实际控制人。

2018年12月,公司出售分立器件自销业务相关资产,将所持有的江阴新顺微电子有限公司(以下简称“新顺微电子”)75%股权、深圳长电科技有限公司(以下简称“深圳长电”)80.67%股权及为承接公司本部分立器件自销业务而新设的全资子公司江阴新申弘达半导体销售有限公司(以下简称“新申公司”)100%股权出售给上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京华泰新兴产业成长投资基金(有限合伙)等交易对方。

截至2019年6月末,公司注册资本为人民币160,287.4555万元。

截至本报告报送日,发行人注册资本未发生变化。

### 三、控股股东及实际控制人

#### 1、发行人前十名股东及持股情况

截至2019年6月末,发行人前十名股东及持股情况如下表所示:

图表5.1: 截至2019年6月末公司前10名股东及持股情况

单位:股

股东名称	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	304,546,165	19.00	304,546,165	无	0	境内国有法人
芯电半导体(上海)有限公司	228,833,996	14.28	228,833,996	无	0	境内非国有法人
江苏新潮科技集团有限公司	103,598,484	6.46		质押	91,890,000	境内非国有法人
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	41,129,396	2.57	0	未知		未知
无锡金投领航产业升级并购	33,579,583	2.09	33,579,583	未知		境内非国

股东名称	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
投资企业(有限合伙)						有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	31,363,300	1.96		未知		未知
香港中央结算有限公司	27,461,518	1.71	0	未知		未知
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪	21,911,339	1.37	0	未知		未知
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	18,133,099	1.13	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	16,914,207	1.06	0	未知		未知

## 2、控股股东

图表5.2: 发行人持股10%以上的股东

单位: 万元 币种: 人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	王占甫	2014年09月26日	911100007178440918	9,872,000	股权投资、投资咨询; 项目投资及资产管理; 企业管理咨询。
芯电半导体(上海)有限公司	ZHAO HAIJUN (赵海军)	2009年03月03日	913101156840682323	1,200 万美元	半导体(硅片及各类化合物半导体) 集成电路芯片制造、针测及测试, 与集成电路有关的开发、设计服务、光掩膜制造、测试封装、销售自产产品。

截至本募集说明书报送日, 公司无控股股东和实际控制人。

2017年6月, 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项, 公司第一大股东由新潮集团变更为芯电半导体, 第二大股东新潮集团和第三大股东产业基金分别持股13.99%及9.54%, 三家主要股东的股权比例较为接近, 且互相之间不存在一致行动关系或安排。同时, 产业基金、芯电半导体、新潮集团均向公司提名2名非独立董事。产业基金、芯电半导体及新潮集团任何一方均不能单独控制上市公司, 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥

有上市公司控制权认定的相关规定，公司为无控股股东、无实际控制人。

2018年8月，公司非公开发行A股股票事项已实施完成，公司前三大股东变更为：产业基金（持股 19.00%）、芯电半导体（持股 14.28%）和新潮集团（持股10.42%），三家主要股东的股权比例仍较为接近，同时三家股东仍各提名2名非独立董事，且互相之间不存在一致行动关系或安排。截至募集说明书签署日，本公司仍无控股股东、无实际控制人。

（1）国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有发行人19.00%的股权，是发行人第一大股东。产业基金成立于2014年9月，注册地址位于北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室，法定代表人王占甫。产业基金注册资本9,872,000万人民币。

产业基金经营范围：股权投资、投资咨询；项目投资及资产管理；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）芯电半导体（上海）有限公司持有发行人14.28%的股权，是发行人第二大股东。芯电半导体成立于2009年3月，性质为有限责任公司，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区张江路18号2号楼1楼-1，法定代表人ZHAO HAIJUN（赵海军）。芯电半导体注册资本1,200万美元。由芯电半导体(香港)有限公司100%出资。

芯电半导体经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、光掩膜制造、测试封装、销售自产产品。

## 2、实际控制人

截至本募集说明书报送日，发行人无实际控制人。

## 四、发行人的独立性

截至本募集说明书报送日，公司无控股股东。发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

### （一）业务方面

发行人主要从事集成电路和分立器件的封装、测试、销售业务，控股股东及其关联企业不生产与公司相同或类似的产品。长电科技具有独立完整的业务体系以及面向市场的自主经营能力，拥有独立完整的产、供、销系统，原材料的采购和产品的销售均不依赖于控股股东及其关联企业。长电科技的业务完全独立于控股股东及其控制的企业。

## (二) 人员方面

发行人建立了独立完整的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制度。长电科技拥有独立于控股股东及其他关联方的员工，所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用后签订劳动合同，并在社会保障、工薪报酬等方面实行独立管理。

## (三) 资产方面

发行人拥有的资产权属清晰，未出现公司控股股东占用公司资产、资金的情况，公司也未向公司实际控制人及其关联方提供担保。

## (四) 机构方面

发行人拥有独立的决策、管理机构，公司及职能部门与控股股东及职能部门各自独立运作，不存在与控股股东合署办公的情况；控股股东及其下属机构未以任何形式影响公司经营管理的独立性。

## (五) 财务方面

发行人拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，配备了专职的会计人员，开设了独立的银行账户，单独进行纳税。能自主作出公司的财务决策，资金运用不受控股股东干预。

## 五、发行人重要权益投资

### (一) 控股子公司

截至2019年6月末，发行人纳入合并范围的下属子公司共计23家，具体情况如下表：

图表5.3：截至2019年6月末纳入合并报表范围的子公司

序号	子公司名称	注册资本	持股比例		表决权比例(%)	业务性质	级次
			直接(%)	间接(%)			
1	长电科技(宿迁)有限公司	25,000.00 万元	100.00	-	100.00	生产、销售	一级
2	长电科技(滁州)有限公司	30,000.00 万元	100.00	-	100.00	生产、销售	一级
3	江阴芯长电子材料有限公司	5,000.00 万元	100.00	-	100.00	销售	一级
4	苏州长电新科投资有限公司	754,340.00 万元	100.00	-	100.00	实业投资	一级
5	江阴新基电子设备有限公司	2,002.34 万元	74.78	-	74.78	生产、销售	一级
6	江阴长电先进封装有限公司	5,100.00 万美元	96.49	3.51	100.00	生产、销售	一级
7	江阴达仕新能源科技有限公司	10,000.00 万元	100.00	-	100.00	生产、销售	一级



序号	子公司名称	注册资本	持股比例		表决	业务性质	级次
8	江阴城东科林环境有限公司	300.00 万元	100.00	-	100.00	污水处理及其再生利用	一级
9	长电国际(香港)贸易投资有限公司	186,291.08 万港元	100.00	-	100.00	销售	一级
10	JCET Stats ChipPac Korea Limited	4,521,925.00 万韩元	-	100.00	100.00	生产、销售	二级
11	苏州长电新朋投资有限公司	976,223.00 万元	22.73	77.27	100.00	实业投资	二级
12	JCET-SC(Singapore) Pte. Ltd.	128,061.89 万美元	-	100.00	100.00	投资控股	三级
13	STATS ChipPAC Pte. Ltd.	322,067.61 万新加坡元	-	100.00	100.00	提供高端半导体产品的封装测试	四级
14	星科金朋半导体(江阴)有限公司	32,500.00 万美元	-	100.00	100.00	生产、销售	五级
15	STATS ChipPAC(Thailand) Limited.	12,500.00 万泰铢	-	100.00	100.00	生产、销售	五级
16	STATS ChipPAC, Inc.	51.00 美元	-	100.00	100.00	销售	五级
17	STATS ChipPAC Services(Thailand) Limited.	600.00 万泰铢	-	100.00	100.00	交易和投资	五级
18	星科金朋集成电路测试(江阴)有限公司	30,000.00 万元	-	100.00	100.00	生产、销售	六级
19	STATS ChipPAC (Barbados) Ltd.	24,533.21 万美元	-	100.00	100.00	投资控股	六级
20	ChipPAC International Company Limited	100.00 美元	-	100.00	100.00	投资控股	六级
21	STATS ChipPAC (BVI) Limited	14,999.99 万美元	-	100.00	100.00	销售	七级
22	STATS ChipPAC Shanghai Co., Ltd.	910.00 万美元	-	100.00	100.00	生产、销售	八级
23	STATS ChipPAC Korea Ltd.	13,311,174.00 万韩元	-	100.00	100.00	生产、销售	八级

### 发行人主要子公司情况:

#### (1) STATS CHIPPAC PTE. LTD.

STATS CHIPPAC PTE. LTD.为发行人间接全资子公司，注册地新加坡，主营半导体封装设计、凸焊、针测、封装、测试和布线解决方案提供商，全球集成电路封测外包公司。

截至 2018 年末，公司总资产为 212,295.64 万美元，净资产为 50,496.54 万美元；2018 年公司实现营业收入 116,856.04 万美元，实现净利润-27,145.21 万美元。

截至 2019 年 6 月末，公司总资产为 189,345.30 万美元，净资产为 83,704.80 万美元；2019 年 1-6 月公司实现营业收入 45,772.44 万美元，实现净利润-4,320.00

万美元。

净利润为负主要由于：SCL 智能手机产品占比较大，2018 年下半年进入新旧动能转化期，数字货币市场大幅度波动；赎回 4.25 亿优先票据产生的溢价及消化摊销费用，最低采购承诺公允价值变动，计提资产减值准备，个别工厂大客户订单下滑，产能利用率不足。

### **(2) 长电科技(滁州)有限公司 (以下简称“长电科技(滁州)”)**

长电科技(滁州)注册资本 30,000 万元人民币，主营研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

截至 2018 年末，公司总资产为 212,473.43 万元，净资产为 49,930.99 万元；2018 年公司实现营业收入 15,9515.47 万元，实现净利润 24,138.38 万元。

截至 2019 年 6 月末，公司总资产为 103,644.45 万元，净资产 57,390.92 万元，2019 年 1-6 月公司实现营业收入 52,722.23 万元，实现净利润 7,459.93 万元。

### **(3) 长电科技(宿迁)有限公司 (以下简称“长电科技(宿迁)”)**

长电科技(宿迁)成立于 2010 年 11 月 26 日，注册资本 25,000 万元人民币，主营研制、开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

截至 2018 年末，公司总资产为 109,998.24 万元，净资产为 14,251.26 万元；2018 年公司实现营业收入 93,610.14 万元，比上年同期增加 10.80%；实现净利润 5,418.61 万元，比上年同期增加 25.66%。

截至 2019 年 6 月末，公司总资产为 69,984.38 万元，净资产 14,955.34 万元；2019 年 1-6 月公司实现营业收入 39,478.77 万元，实现净利润 704.09 万元。

### **(4) 江阴长电先进封装有限公司 (以下简称“长电先进”)**

长电先进为中外合资经营企业，成立于 2003 年 10 月 30 日，注册资本 5,100 万美元，其中长电科技持有其 96.488% 的股权，长电科技全资子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司持有长电先进 3.512% 股权。主营半导体芯片凸块及封装测试产品。2018 年长电先进重点客户的新产品开发方面有较大的突破，多个重要客户的新产品进入量产或者试量产；Fan-in 和 Fan-out ECP 进入批量生产；Bumping 智能化制造实现业内首个无人化量产应用的突破。

截至 2018 年末，公司总资产为 360,152.49 万元，净资产为 154,121.16 万元；2018 年度公司实现营业收入 245,403.79 万元，实现净利润 23,385.47 万元。

截至 2019 年 6 月末，公司总资产为 386,306.68 万元，净资产为 164,677.30 万元，2019 年 1-6 月公司实现营业收入 121,462.10 万元，实现净利润 11,328.78 万元。

### **(5) JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED (长电韩国)**

长电韩国为本公司全资子公司长电国际在韩国设立的全资子公司，主营高端封装测试产品，主要进行高阶 SiP 产品封装测试。

截至 2018 年末，公司总资产为 46,444.29 万美元，净资产为 22,277.60 万美元；2018 年公司实现营业收入 78,878.16 万美元，比上年同期增加 4.40%，净利润 755.97 万美元，同比减少 66.73%。2018 年，净利润下滑主要是受终端智能手机促销策略的影响，导致封测产品的价格下降。

截至 2019 年 6 月末，公司总资产为 42,154.67 万美元，净资产为 19,729.29 万美元，2019 年 1-6 月公司实现营业收入 16,836.84 万美元，实现净利润-2,548.31 万美元。受市场因素影响，订单较上年同期下滑幅度较大，导致亏损。

#### (6) 长电国际（香港）贸易投资有限公司（以下简称“长电香港”）

长电香港主要对外进行进出口贸易业务、实业投资，注册资金 186,291.08 万港元。2015 年在韩国投资成立 JCET Stats ChipPac Korea Ltd.，投资高阶 SiP 产品封测项目。

截至 2018 年末，公司总资产为 412,920.06 万元，净资产 183,595.17 万元，2018 年度公司实现营业收入 658,974.73 万元，实现净利润 3,390.18 万元。

截至 2019 年 6 月末，公司总资产为 388,748.28 万元，净资产为 171,650.23 万元，2019 年 1-6 月公司实现营业收入 167,483.32 万元，实现净利润 -17,634.30 万元。净利润为负主要受子公司长电韩国亏损影响。

#### (7) 江阴新基电子设备有限公司（以下简称“新基电子”）

新基电子成立于 2001 年 3 月 14 日，法定代表人王晓华，注册资本 2,002.3397 万人民币。新基电子经营范围：生产半导体封装、检测设备、精密模具、刀具及零配件；弱电系统的设计、安装、维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截至 2018 年末，公司总资产为 7,858.48 万元，净资产为 3,821.54 万元，2018 年度公司实现营业收入 10,965.35 万元，实现净利润 824.68 万元。

截至 2019 年 6 月末，公司总资产为 7,849.26 万元，净资产为 4,178.82 万元，2019 年 1-6 月公司实现营业收入 4,953.79 万元，实现净利润 357.29 万元。

### (二) 主要参股公司

图表 5.4: 发行人主要参股公司情况

单位：万元

序号	公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
1	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	无锡	21,100.00	8.53%	集成电路封装与系统集成等领域研究
2	SJ SEMICONDUCTOR	开曼	USD214,942.31	8.63%	对外投资

	CORPORATION			(间接)	
--	-------------	--	--	------	--

### 1、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司成立于 2012 年 9 月，注册资本 23,445.00 万元，公司经营范围：集成电路封装与系统集成等相关领域核心技术等研究。

截至 2018 年末，公司总资产为 56,750.67 万元，净资产为 18,638.33 万元，2018 年度实现营业收入 7,207.79 万元，实现净利润 3,111.60 万元。

截至 2019 年 6 月末，公司总资产为 50,465.18 万元，净资产为 19,934.32 万元，2019 年 1-6 月公司实现营业收入 948.44 万元，实现净利润 438.71 万元。

### 2、SJ SEMICONDUCTOR CORPORATION

该公司成立的背景是：发行人为加强与中芯国际集成电路制造有限公司的合作，共同出资搭建该海外投资控股平台，以设立中芯长电半导体（香港）有限公司（以下简称“中芯长电（香港）”）及中芯长电半导体（江阴）有限公司（以下简称“中芯长电（江阴）”）。中芯国际集成电路制造有限公司（“中芯国际”，纽交所代号：SMI，港交所股份代号：981），是世界领先的集成电路芯片代工企业之一，也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路芯片制造企业，总部地址在上海，主要业务是根据客户或第三方的集成电路设计为客户制造集成电路芯片，曾获《半导体国际》杂志颁发的“2003年度最佳半导体厂”奖项。

基于中芯国际为中国内地规模最大、技术最先进的集成电路代工企业，长电科技为中国内地最大的封装测试服务供应商，二者合作将创造产业链上下游互补优势，故双方开展合作如下：

(1) 2014年8月，发行人通过其全资子公司——长电国际（香港）投资贸易有限公司与中芯国际共同投资设立SJ Semiconductor Corporation，即中芯长电（开曼），注册资本214,942.31万美元，其中发行人间接持股8.63%。该公司仅为发行人搭建海外投资平台设立，仅有投资控股业务，无其他业务。

(2) 2014年11月，发行人通过SJ Semiconductor Corporation设立全资控股公司中芯长电半导体（香港）有限公司（以下简称“中芯长电（香港）”），中芯长电（香港）又全资设立中芯长电半导体（江阴）有限公司（以下简称“中芯长电（江阴）”）。中芯长电（江阴）注册资本4,950万美元，为长电科技就近建立的配套后段封装生产线。截止到2018年末，注册资本已变更为39,950万美元，中芯长电（江阴）总资产170,613.97万元，净资产141,196.62万元，全年营业收入33,661.17万元，净利润-5,181.07万元

长电科技与中芯国际的合作将具备为客户提供一站式服务的能力，并建立起

国内首条完整的芯片制造产业链。中芯国际拥有国内最强的前段生产和研发实力，长电科技则在先进封装核心技术和关键工艺上拥有丰富的经验，就近建立的中芯长电（江阴）又配套了后段封装生产线，双方已打造完成国内首条完整的半导体制造产业链。该产业链缩短了芯片从前段到中段及后段工艺之间的运输周期，并有效控制了中间环节的成本，更重要的是贴近国内移动终端市场，将极大地缩短市场反应时间，更好地为快速更新换代的移动芯片设计业服务，未来发展景可期。

截至 2018 年末，SJ SEMICONDUCTOR CORPORATION 的总资产为 31,250.74 万美元，净资产为 27,853.98 万美元，2018 年度实现营业收入 5,105.16 万美元，实现净利润-566.65 万美元。

截至 2019 年 6 月末，SJ SEMICONDUCTOR CORPORATION 的总资产为 35,084.80 万美元，净资产为 27,069.09 万美元，2019 年 1-6 月公司实现营业收入 3,675.18 万美元，实现净利润-864.98 万美元。净利润为负主要系全资子公司产能利用率不足所致。

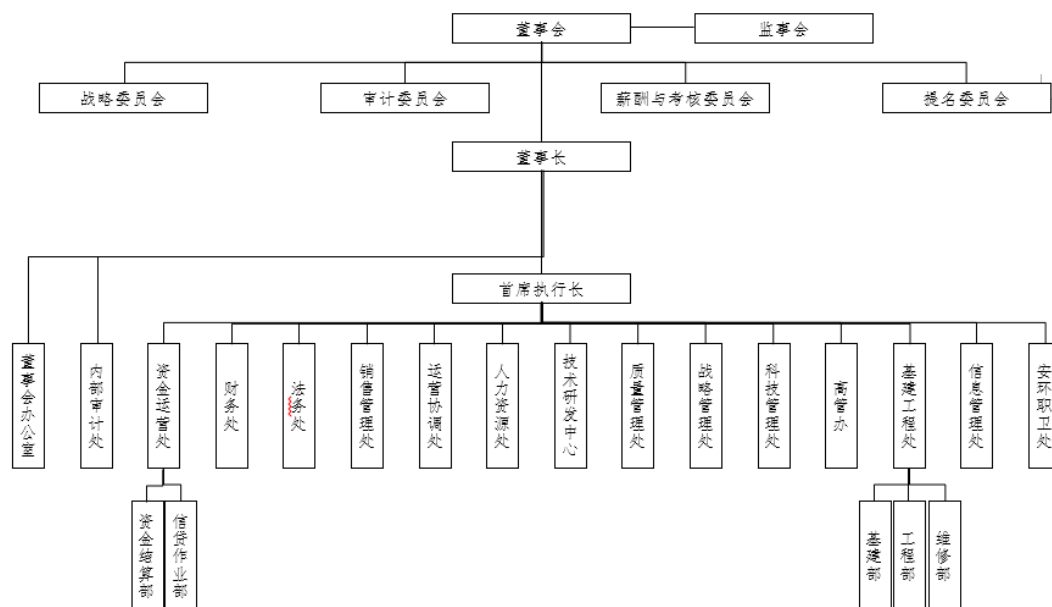
## 六、发行人治理情况

### （一）发行人组织机构

#### 1、发行人内部组织结构

截至 2019 年 6 月末，发行人内部组织结构图如下：

图表 5.5：发行人组织结构图



#### 2、公司主要部门职能

**高管办：**负责高管日常事务管理、档案管理、印章管理等事宜；政府沟通；后勤、会务组织等。

**销售管理处:**协助公司分管领导进行重大客户关系维护;区块销售资源协调;客户抱怨跟踪管理;销售指标分解、费用管理等。

**战略管理处:**负责中长期战略规划;投资管理;产能规划;加强内部控制等;

**质量管理处:**规划、建立公司质量管理、环境、有害物质等各类体系并监控其适宜性和有效性,负责年度体系审核;负责公司标准化管理和文件管理;负责各总厂、各供应商质量管理工作;负责客户投诉处理和失效分析;组织实施公司内部稽核工作;跨 BU 质量交流和协调等。

**财务处:**制定公司财务管理制度以及会计核算规程;结合公司现状,制定切实可行的全面预算管理制度,并检查督促相关部门执行;进行财务核算管理、物料盘点管理、固定资产管理、财务档案管理、税务管理、成本管理、核价管理纳税规划和管理;参与重要经营活动、合同研究等。

**董事会办公室:**负责与监管机构的沟通、董事会日常工作;对外投资管理;参与公司战略的制定、执行、监督,研究公司发展方向,选择公司战略合作伙伴等。

**人力资源处:**参与公司人力资源战略决策;分析人力资源供求现状,制定人力资源规划;进行绩效分析,薪酬管理;招聘管理;培训管理;人员编制管理;负责员工入职、调动、晋升、降职、离职等手续办理;人事档案管理;劳动合同管理;劳动纪律、考勤管理等。

**安环职卫处:**负责公司生产、消防、治安安全,环境保护、能源管理、职业卫生;新、改、扩项目评价及验收;配合公安机关日常管理工作等。

**基建工程处:**负责公司年度新改扩建项目的实施管理工作;负责各项工程的预、决算;竣工验收等。

**信息管理处:**负责公司信息管理制度建设;信息安全规划和落实;信息技术线路图等。

**科技管理处:**负责收集政府法规、文件、通知以及项目申报信息,组织人员根据科技攻关、专项资金等项目要求,编写项目可研报告,进行项目申报;负责对竣工项目组织开展验收工作;负责公司固定资产投资项目的政府备案或核准工作。相关奖励、荣誉申报等。

**内部审计处:**负责内部财务收支、预算、合同、合规性、投资、资金使用等审计监督。

**资金运营处:**根据预算统筹安排资金,组织资金来源、降低资金成本;负责集团内企业的资金收支等。

**法务处:**负责法务制度建设和流程优化;诉讼方向决策;日常规章制度、合同等审查;风险防范等。

**运营协调处:**负责关键物料供应商管理;各专项管理;BU间运营协调等。

**技术研发中心：**负责关键技术管理研发；知识产权等。

## （二）发行人公司治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律和规章的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会，聘任了管理层，建立了严格的法人治理结构。

### 1、股东大会

股东大会是公司最高权力机构，决定公司重大事项，依法行使职权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，于上一个会计年度结束后的六个月内举行。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《公司法》和《公司章程》，股东大会行使下列职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （3）审议批准董事会的报告；
- （4）审议批准监事会的报告；
- （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （8）对公司发行债券作出决议；
- （9）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；
- （10）修改章程；
- （11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （12）审议本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- （13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
- （14）审议批准变更募集资金用途事项；
- （15）审议股权激励计划；

(16) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

## 2、董事会

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

董事会行使下列职权：

- (1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 执行股东大会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (9) 决定公司内部管理机构的设置；
- (10) 聘任或者解聘公司首席执行官（CEO）、董事会秘书；根据首席执行官（CEO）的提名，聘任或者解聘公司总裁、执行副总裁、首席财务长等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (11) 决定公司的基本管理制度；
- (12) 制订本章程的修改方案；
- (13) 管理公司信息披露事项；
- (14) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (15) 听取公司首席执行官（CEO）的工作汇报并检查首席执行官（CEO）的工作；
- (16) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

## 3、监事会

公司设有监事会，监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会行使以下职权：



- (1) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
- (2) 检查公司财务;
- (3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
- (4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
- (5) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
- (6) 向股东大会提出提案;
- (7) 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
- (8) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;

#### 4、管理层

公司设首席执行官 (CEO) 1 名,公司首席执行官 (CEO)、总裁、执行副总裁等高级管理人员由董事会聘任或解聘。公司首席执行官 (CEO)、总裁、执行副总裁、首席营运长、首席技术长、首席财务长、首席营销长、董事会秘书、首席法务长、首席人力资源长为公司高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。首席执行官 (CEO) 对董事会负责,行使下列职权:

- (1) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
- (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (3) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (4) 拟订公司的基本管理制度;
- (5) 制定公司的具体规章;
- (6) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
- (7) 提请董事会聘任或者解聘公司总裁、执行副总裁、首席营运长、首席技术长、首席财务长、首席营销长、首席法务长、首席人力资源长; ;
- (8) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
- (9) 行使法定代表人的职权;
- (10) 本章程或董事会授予的其他职权

#### (三) 发行人的内部控制制度

发行人已建立了较为完善合理的内部控制制度,并得到了一贯有效的遵循和执行,能够对公司各项业务活动的健康运行及执行国家有关法律法规提供保证。同时,发行人将根据业务发展和内部机构调整的需要,及时修订并补充内部控制制度,提高内部控制制度的有效性和可操作性,有效地控制经营风险和财务风险,准确提供公司的管理及财务信息,保证公司生产经营持续、稳健、快速发展。

### 1、财务会计控制

发行人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求制定了适合本公司实际情况的《江苏长电科技股份有限公司财务管理制度》,通过选用先进的财务管理系统软件、按业务流程设置相应的权限以形成符合内控要求的、严密的会计监控体系。

发行人已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序,办理货币资金业务的不相容岗位已作分离,相关机构和人员存在相互制约关系。制订了银行存款的结算程序以及收付款审批权限及审批流程等一系列程序。本公司财会处下设会计部和财务部,采取了“钱帐分管、票印分管、审批、收付、记帐三分离”的货币资金内控管理模式,所有的货币资金收款均汇入公司账户。

### 2、投资及融资管理制度

投资管理方面,发行人制订了《江苏长电科技股份有限公司重大决策管理制度》、《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》、《江苏长电科技股份有限公司商品类套期保值交易业务内部控制制度》,就投资范围、资金来源、投资决策权限及程序等有关内容做出了规定,以保证严格按照国家相关法律法规的要求进行投资运营活动,对长期投资实行统一决策、分类分级管理的办法,以保证公司对外投资的资金安全,确保投资回报效果。在融资管理方面,本公司大额的资金筹措均经由董事会审议批准,并能较合理地确定筹资规模和筹资结构,选择恰当的筹资方式,较严格地控制财务风险以降低筹资成本,并保证筹措的资金与原计划使用情况相符。

### 3、关联交易制度

为了规范关联交易管理,防范关联交易风险,发行人在《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》中对关联方关系、关联交易的内容、关联交易的决策程序等进行了明确规定,确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行,保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

### 4、对外担保控制

发行人在《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《江苏长电科技股份有限公司重大决策管理制度》中对担保事项作出了明确规定。发行人依法保障独立董事的检查监督权利,凡涉及到对外担保事项的,必须经公司

独立董事审核并出具相关独立意见，公司积极配合独立董事履行相关职务行为，以切实维护公司股东特别是社会公众股股东的合法权益。发行人严格落实对外担保程序，有效保障了公司和股东的权益。

#### 5、人事管理制度

发行人设置了人力资源处，负责根据国家的法律法规，拟定公司的人力资源政策。为持续提高公司的人力资源准备度，不断吸引、培养、激励优秀人才，公司根据国家及地方相关政策法规并结合实际情况，制定了《劳动工资管理规定》、《奖惩制度》、《员工考勤和晋升制度》、《考勤管理制度》、《员工休假管理规定》等人力资源管理内控制度，从制度上规范了员工薪酬管理工作，保障了企业和员工的共同利益，调动了员工的工作积极性。

#### 6、对下属子公司管理制度

发行人《对子公司、分公司财务管理的补充规定》中明确了对下属子公司的管理制度。发行人子公司的日常经营管理由子公司总经理组织实施，子公司董事会由发行人绝对控制。子公司统一执行发行人本部的财务会计制度，并相应制定自身的会计核算和内部控制制度，子公司的报表纳入发行人的合并报表。发行人对子公司实行内部审计制度，对子公司实行全面考核制度，由公司本部财务部、人力资源部对子公司进行考核。同时规范了子、分公司的资金管理和费用控制等规则。

#### 7、生产经营控制

发行人根据相关的法律、法规和规范性文件的规定，以公司内部控制为基础建立起涵盖了组织机构运行管理、人力资源管理、财务管理、质量管理、生产管理、销售管理、绩效管理、企业文化管理、设备管理、资产管理、安全保卫管理等整个生产经营过程的规章制度，形成了较为完善的内部控制制度体系，确保各项工作都有章可循，并得到了严格有效的贯彻执行。

#### 8、质量管理控制

发行人建立起一整套符合公司管理实际的质量流程体系，使公司在生产组织、市场营销等生产管理方面实现有序经营，贯彻实施了 ISO9001、ISO14001、ISO9002、ISO/TS16949、QC080000 质量管理体系，并严格按照体系要求规范运作。同时本公司还会不定期地对各项流程的执行情况进行评估，根据实际情况不断加以修改完善。

#### 9、信息披露管理控制

发行人制定了《信息披露管理制度》，明确了信息披露责任人、信息披露事务管理部门和相关义务人、各责任人及义务人职责、信息披露的内容与标准、信息披露的审核流程、信息披露相关文件及资料的档案管理、投资者关系活动等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序做出了严格的规定。

## 10、预算管理制度

发行人制定了预算管理制度，要求预算管理决策部门、管理部门和执行部门按照企业制定的发展战略目标，确定年度经营目标，逐层分解，下达于企业内部各个经济单位，以一系列的预算、控制、协调、考核为内容，自始至终地将各个经济单位经营目标同企业发展战略目标联系起来，对其分工负责的经营全过程进行控制和管理，并对实现的业绩进行考核与评价。

## 11、短期资金调度应急预案

发行人根据外部市场环境、自身资金需求动态制定资金计划以应对短期资金调度；发行人与各家金融机构建立了良好的合作关系，间接融资能力较强。公司融资渠道通畅，集团内货币资金较为充裕；若出现短期资金周转需求，发行人拥有的较大未使用银行授信额度以及较强的债券市场直接融资能力均能够有力支持发行人资金调度。

## 12、资金管理制度

发行人设立内部资金结算中心，由结算中心对集团及所属企业的资金实施统一调度、使用、管理、监控，从而实现提高资金运营效率和使用效益；根据集团发展战略的需要，合理谨慎融资，保持合理的长短期债务比例，力求达到财务风险与资金成本的均衡。

## 13、资金运营管理制度

发行人对公司及下属子公司的资金实施统一调度、使用、管理、监控，从而实现提高资金运营效率和使用效益；根据公司发展战略的需要，合理谨慎融资，保持合理的长短期债务比例，力求达到财务风险与资金成本的均衡。

## 七、发行人董事、监事和高级管理人员

截至 2019 年 6 月末，发行人董事及高级管理人员情况如下：

图表 5.6：发行人董事及高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止时间
周子学	男	62	董事长	2019 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 16 日
任凯	男	47	董事	2019 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 16 日
高永岗	男	54	董事	2019 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 16 日
张春生	男	51	董事	2019 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 16 日
李春兴	男	61	董事、CEO、首席技术长	2019 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 16 日
罗宏伟	男	59	董事、执行副总裁	2019 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 16 日
潘青	男	45	独立董事	2019 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 16 日
李建新	女	61	独立董事	2019 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 16 日
石璩	女	56	独立董事	2019 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 16 日
林桂凤	女	57	监事会主席	2019 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 16 日
王永	男	40	监事	2019 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 16 日
郑芳	女	46	监事	2019 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 16 日

姓名	性别	年龄	职务	任期起止时间
马岳	男	40	职工监事	2019年5月17日-2022年5月16日
沈阳	男	50	职工监事	2019年5月17日-2022年5月16日
穆浩平	男	56	首席财务长	2019年5月17日-2022年5月16日
俞红	女	57	首席人力资源长	2019年5月17日-2022年5月16日
吴宏鲲	男	41	董事会秘书	2019年5月17日-2022年5月16日

### (一) 董事会成员

周子学先生，现任本公司董事，中芯国际集成电路制造有限公司董事长、执行董事，及中芯国际若干附属公司之董事。周博士亦任中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长，中国半导体行业协会理事长。周博士拥有电子科技大学管理学硕士学位及华中师范大学经济学博士学位。周博士在工业和信息化领域有逾三十年的经济运行调节、管理工作经验。出任现职前，周博士在工业和信息化部工作，曾任总经济师、财务司司长等职，在此之前，彼曾于信息产业部、电子工业部、机械电子工业部的不同部门和国营东光电工厂工作。周博士现任云南南天电子信息产业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司：000,948）独立董事、青岛海信电器股份有限公司（上海证券交易所上市公司：600,060）独立董事。

任凯，男，汉族，1972年4月生，中国国籍，中国共产党党员，高级工程师；北京交通大学，工程硕士；现任华芯投资管理有限责任公司董事、副总裁、本公司董事，并兼任产业基金若干关联公司之董事、董事长。历任国家开发银行评审二局评审三处副处长、评审四处副处长、评审四处处长。长期从事装备、电子领域的贷款项目评审和投资业务工作，熟悉产业政策，对集成电路及相关产业有深刻理解，在开发银行评审二局工作期间，带领团队完成了上百个重大项目评审，年均评审承诺额超千亿元，累计在集成电路领域承诺贷款达300多亿元，具有丰富的投资管理经验。

高永岗先生，1965年3月出生，中国国籍，高级会计师，澳洲注册会计师；南开大学国际商学院毕业，管理学博士。现任本公司董事，中芯国际执行董事兼联席公司秘书、战略规划执行副总裁、首席财务官，并兼任中芯国际若干关联公司之董事、董事长。历任大唐电信科技产业集团总会计师，大唐电信科技产业控股有限公司董事、高级副总裁，大唐电信集团财务有限公司董事长，大唐投资管理(北京)有限公司董事长，大唐高新创业投资有限公司执行董事，海南大唐发控股权投资基金管理有限公司董事长，大唐创业投资(海南)有限公司董事长，海南信息产业创业投资基金执行事务合伙人委托代表，中芯国际董事，中国会计学会常务理事，南开大学、天津财经大学、天津工业大学等大学兼职导师，财政部评审专家。拥有20多年的财务管理工作经验，先后在商业、工业、市政公用事业及综合性企业等行业的国有、民营、合资(独资)企业、政府机关担任财务负责人或总会计师，在财务管理及投融资领域有丰富的实践经验和理论研究，曾主持多个国家级、省部级重点研究项目并发表多篇著作。

张春生，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，中共党员；中国人民大学世界经济专业毕业，经济学硕士。现任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁、本公司董事。历任中远对外劳务合作公司研发部经理，中远人力资源开发公司办公室主任，信息产业部经济体制改革与经济运行司经济调节处正处级干部、处长，工业和信息化部财务司综合处处长、财经政策处处长，中国电子信息产业发展研究院副院长。

李春兴，男，美国凯斯西储大学理论固体物理博士。现任本公司董事、首席执行官(CEO)兼星科金朋 CEO，同时兼任本公司若干附属公司之董事、董事长。历任安靠研发中心负责人、全球采购负责人、高端封装事业群副总、集团副总、高级副总、首席技术长(CTO)。在半导体领域有 20 年的广泛封装经验，拥有较强的国际化项目管理能力和领导能力，在初创、扭转和快速变化的环境中实现收入、利润和业务增长目标方面取得了多项可验证的成功经历。李春兴先生目前拥有专利 59 件，并在国际上发表了 19 篇学术论文。

罗宏伟，男，1960 年出生，中国国籍，中共党员，本科毕业，高级经济师。现任本公司执行副总裁、长电科技本部总经理，并兼任本公司若干附属公司之董事。历任江阴晶体管厂设备科长、江苏长电科技股份有限公司 IC 厂厂长、生产部部长、总经理助理、副总经理。

潘青，男，1974 年出生，美国国籍。北京外国语大学本科毕业，美国波士顿东北大学获 MBA 及会计学硕士双学位；拥有美国、中国、香港三地注册会计师执业执照。现任诺亚财富集团旗下歌斐资产管理公司管理合伙人兼 CFO、本公司独立董事，曾任德勤会计师事务所资深审计合伙人。

李建新，女，1958 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，国土资源经济研究员职称。现任中国总会计师协会航天分会会长。历任中国地质大学管理干部学院教师，地质矿产部审计局处长，副局长；审计署社会保障审计局，农业审计司，教育审计局，长沙特派员办事处，社会保障审计司，新闻报刊审计局等副局长，副司长，局长，特派员，司长；中国航天科工集团公司董事会秘书，副总会计师等职。曾兼任中国地质大学，南京审计学院，首都经贸大学兼职教授和校外导师，审计署审计科研所博士后导师等。

石瑛，女，1963 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，教授级高级工程师，工商管理硕士，哈佛大学访问学者。现任中国半导体行业协会支撑业分会秘书长，集成电路材料产业技术创新战略联盟秘书长，北京多维电子材料技术开发与促进中心主任，宁波芯盟电子材料有限公司总经理。历任北京有色金属研究总院高级工程师，科研处副处长，教授级高工；有研半导体材料股份有限公司总经理助理，有研新材料股份有限公司总经理助理。2017 年被聘为国家新材料产业发展专家咨询委员会委员。近 15 年来专注于微电子材料领域科技创新与产业技术与发展战略，基于信息网络技术的科技项目全生命周期管理等。主持和参与国家科技攻

关，863 计划，国家科技平台，国家高技术产业化示范工程，北京市科技专项计划等国家和省级项目 10 余项；主持和参与集成电路及先进封装和半导体材料领域科技发展战略研究和国家科技发展规划研究近 10 项；主持设计并完成基于课题全生命周期和过程控制的项目管理网络化平台。兼任唐山三孚硅业股份有限公司独立董事，上海正帆科技股份有限公司独立董事。

## （二）监事会成员

林桂凤，女，1962 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，助理经济师；北京师范大学经济学院世界经济专业毕业，研究生学历；现任江苏长电科技股份有限公司监事会主席，国家集成电路产业投资基金股份有限公司监事会主席；历任财政部预算管理司主任科员，财政部预算司综合处副处长，财政部预算司综合处处长，财政部预算司副司长，财政部预算司巡视员，财政部社会保障司司长。

王永，男，1979 年 7 月出生，哈尔滨商业大学经济学院金融学专业本科，中国矿业大学管理学院会计学专业硕士，管理科学与工程专业博士。现任中芯国际集成电路制造有限公司财务会计中心总监。历任中国青年政治学院经济系教师；国家开发银行信贷管理局管理资产处副处长；北京市二商集团财务部部长助理；大唐电信集团财务有限公司金融市场部总经理；中芯国际集成电路制造有限公司资金运营处助理总监，总监。曾兼任北京理工大学经管院 MBA 授课教师；中国社会科学院金融研究所金融学在职研究生授课教师。王永先生曾获“煤炭工业协会科学技术三等奖”和“大唐电信集团创先争优优秀个人”的荣誉，在国内外共发表了 6 篇论文。

郑芳，女，1973 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。现任江阴长电先进封装有限公司行政副总，党支部书记，工会负责人。历任江阴长江电子实业有限公司外经科副科长，江阴斯菲尔电力仪表有限公司办公室主任，江阴新顺微电子任综合部部长，江阴长电先进封装有限公司生产计划处长，行政总监，质量副总等职务。郑芳女士曾获“江阴市先进工作者”，“2012 年度-2014 年度江阴市优秀党务工作者”，“2019 年无锡市五一巾帼标兵”等荣誉。

马岳，男，1979 年出生，大学本科，中国国籍，中共党员。现任本公司办公室主任；历任江苏长电科技股份有限公司行政管理部科员，法律事务部法务专员，办公室主任助理，副主任。

沈阳，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，本科，文化师，助理工程师；现任本公司党委副书记，工会主席；历任江苏长电科技股份有限公司董事，团委书记，公司办公室主任，副主任，总经理秘书。

## （三）高级管理人员

罗宏伟先生，1960 年出生，中国国籍，中共党员，本科毕业，高级经济师。现任本公司执行副总裁、长电科技本部总经理，并兼任本公司若干附属公司之董事。历任江阴晶体管厂设备科长、IC 厂厂长、生产部部长、总经理助理、

副总经理。

穆浩平，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，研究员级高级会计师；西安交通大学工商管理专业(MBA)，硕士研究生学历。现任本公司高级副总裁，首席财务长。历任彩虹集团公司财务副总监，彩管总厂总会计师等职务，中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长，中卫国脉通信股份有限公司董事，董事长，中国卫通集团股份有限公司董事，党委书记，副总经理，财务总监等职务。

俞红，女，1961 年 5 月出生，中国国籍，中共党员；中欧国际工商管理学院毕业，MBA 硕士。现任本公司首席人力资源长。历任上海市仪表局上海自动化仪表(集团)公司自仪十一厂人事组织科科长，费希尔-罗斯蒙有限公司(世界 500 强美国艾默生电气子公司)人事行政部经理，艾默生中国总公司(艾默生在中国的总部)中国人力资源总经理并兼任艾默生贸易(上海)有限公司法人代表，上海华虹(集团)有限公司人事行政资深总监并兼任上海华虹 NEC 电子有限公司人力资源总监，华虹集团华虹国际公司党委书记，工会主席，副总裁，上海海泰房地产(集团)有限公司副总裁，长江计算机(集团)公司人力资源资深总监，长电科技监事会主席，中芯国际集成电路制造有限公司资深副总裁，工会主席。

吴宏鲲，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，加拿大劳瑞尔大学(Wilfrid Laurier University)商业经济学硕士。历任展讯通信有限公司商务经理，中芯国际集成电路制造有限公司董事长助理、投资者关系部经理、高级经理、助理总监。在半导体领域有近十五年的工作经验，对国内外资本市场与投资者关系管理有深刻的了解和丰富的经验。曾获评机构投资者的最佳投资者关系专业人士的 2018 年度亚洲前三名(硬件/半导体类)。

发行人上述高管人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

#### (四) 发行人员工情况

截至 2019 年 6 月末，公司在职员工 22,446 人，发行人员工结构如下表：

图表 5.7: 截至 2019 年 6 月末公司人员专业构成

按专业类别	数量(人)	占员工人数比例(%)
生产人员	13,880	61.85
销售人员	277	1.23
技术人员	5,978	26.63
财务人员	128	0.57
行政人员	818	3.64
其他人员	1,365	6.08
<b>合计</b>	<b>22,446</b>	<b>100.00</b>



按文化素质:	数量(人)	占员工人数比例(%)
本科及本科以上	4,298	19.15
大专	4,667	20.79
大专以下	13,481	60.06
<b>合计</b>	<b>22,446</b>	<b>100.00</b>

## 八、发行人业务范围及主要业务情况

### (一) 经营范围

发行人经营范围：研制、开发、生产、销售半导体，电子原件，专用电子电气装置，销售本企业自产机电产品及成套设备，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，开展本企业进料加工和“三来一补”业务；道路普通货物运输。

### (二) 各板块在营业收入和成本中的金额和比例

发行人主营业务为集成电路、分立器件的封装、测试与销售。经过多年的发展，发行人的主要业务板块为芯片封测业务（包括集成电路封测业务和分立器件业务）。

图表 5.8：近三年及一期公司各板块营业收入及占比情况

单位：亿元/%

项目明细	2019 年 1-6 月		2018 年		2017 年		2016 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>营业收入</b>	<b>91.48</b>	<b>100.00</b>	<b>238.56</b>	<b>100.00</b>	<b>238.56</b>	<b>100.00</b>	<b>191.55</b>	<b>100.00</b>
芯片封测	91.13	99.62	233.36	97.82	234.13	98.14	187.23	97.75
芯片销售	0.00	0.00	4.10	1.72	3.44	1.44	2.99	1.56
其他业务	0.35	0.38	1.11	0.46	0.99	0.41	1.32	0.69
<b>营业成本</b>	<b>82.97</b>	<b>100</b>	<b>211.31</b>	<b>100.00</b>	<b>210.61</b>	<b>100.00</b>	<b>168.91</b>	<b>100.00</b>
芯片封测	82.66	99.63	207.76	98.32	207.60	98.57	165.95	98.25
芯片销售	0.00	0.00	3.12	1.47	2.23	1.06	2.01	1.19
其他业务	0.31	0.37	0.44	0.21	0.77	0.37	0.95	0.56
<b>毛利润</b>	<b>8.51</b>	<b>100.00</b>	<b>27.26</b>	<b>100.00</b>	<b>27.95</b>	<b>100.00</b>	<b>22.64</b>	<b>100.00</b>
芯片封测	8.47	99.53	25.61	93.94	26.53	94.92	21.29	94.03
芯片销售	0.00	0.00	0.98	3.59	1.21	4.32	0.98	4.31

项目明细	2019 年 1-6 月		2018 年		2017 年		2016 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他业务	0.04	0.47	0.67	2.46	0.21	0.76	0.37	1.65
<b>毛利率</b>	<b>9.30</b>		<b>11.43</b>		<b>11.71</b>		<b>11.82</b>	
芯片封测	9.29		10.97		11.33		11.37	
芯片销售	0.00		23.92		35.12		32.68	
其他业务	11.43		60.60		21.54		28.32	

注：2013年起，发行人因生产经营模式和成本核算的变动不再在芯片封装测试、芯片设计制造销售项下细分集成电路与分立器件。2018年末，发行人出售与芯片生产销售相关的子、分公司资产，2019年起，发行人已无芯片制造销售业务。

2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，发行人分别实现主营业务收入 191.55 亿元、238.56 亿元、238.56 亿元和 91.48 亿元。公司 2017 年较 2016 年营收同比增长 24.54%，主要原因包括企业优化产品结构和星科金朋江阴厂运营情况较好。

从营业收入的结构上来看，芯片封测是发行人的第一大收入来源，2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，芯片封测对营业收入的贡献度分别为 97.75%、98.14%、97.82% 和 99.62%。

2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，发行人的主营业务毛利率分别为 11.82%、11.71%、11.43% 和 9.30%，近三年较稳定。从各个业务板块的毛利率情况来看，2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，芯片封测的毛利率分别为 11.37%、11.33%、10.97% 和 9.29%，近三年以来芯片封测的毛利率保持稳定。

发行人 2015 年报告将星科金朋纳入合并报表范围。发行人总体销售状况稳步提升，随着投资规模的扩大，发行人负债规模也呈现大幅度的增加，造成偿债能力下降；同时并购整合需要一定的时间，星科金朋可能持续亏损，拖累发行人盈利能力。

### （三）发行人主要经营模式

发行人主营业务板块为芯片封装测试业务，该业务所处行业上下游的界定为：集成电路产业链是以电路设计为主导，由电路设计公司设计出集成电路，然后委托芯片制造厂生产晶圆，再委托封装厂进行集成电路封装、测试，然后销售给电子整机产品生产企业。集成电路设计企业委托公司进行封装加工，是公司的客户；封装支撑企业为公司提供生产所需的原材料，是公司的供应商。公司的分立器件业务采用代工模式，和上述界定类似。

#### 1、采购模式

发行人制定了《供应处管理制度》等规章制度，明确了采购部门的责任、岗位职责、工作程序等，并将责任落实到个人，从而保证了采购工作的有效进行。

公司生产所需的主要原材料为金丝、引线框架、塑封树脂和芯片，主要原材料简介如下：

①引线框架：随着全球封装业向国内的转移，我国引线框架的需求增长迅速。目前国内主要引线框架企业有 10 多家，规模差距不大。随着封装方式向尺寸小、密度高的方向发展，引线框架也在向高端化发展，其引脚越来越多、间距越来越小、精度则越来越高，而且在 BGA、CSP、MCM 和 SiP 等先进封装技术中，已出现引线框架被层压基板所取代的现象，国内引线框架业的产业结构将随之作出调整。

②键合金丝：随着国内封装技术的进步，低端键合金丝产品的需求日趋下降。为满足不断提高的市场需求，键合金丝生产企业也不断加大投入，研发制造出可以适应先进封装技术的更细线径的、拥有更高性能电参数、强度参数、成球参数等指标的优质键合金丝产品。

③塑封材料：由于国内半导体封装技术的发展和产品技术的升级换代，特别是海外封装企业加快向国内转移，一些高端的封装产品相继在大陆市场上加工投产，导致芯片塑封料市场需求量持续增长。塑封料厂家顺应这种趋势，不断加大投入以扩大规模和提高技术，产品结构逐渐优化，技术持续升级，芯片塑封料的国内自给率将不断提高。目前中国大陆芯片塑封料年产能已达到 8 万吨。

发行人最近三年不存在向单一供应商采购超过采购总额 50% 的情况，也不存在依赖于少数供应商的情况。发行人 2018 年度向前五名供应商采购金额为 43.43 亿元，占年度采购总额的 28.56%，2019 年 1-6 月向前五名供应商采购金额为 11.09 亿元，占年度采购总额的 25.73%。发行人近一年及一期向前五名大供应商采购情况如下：

图表 5.9：2018 年发行人向五大供应商采购情况

序号	供应商名称	采购金额（亿元）	占总采购的比例（%）
1	供应商 A	20.21	13.29
2	供应商 B	8.45	5.56
3	供应商 C	7.47	4.91
4	供应商 D	3.99	2.62
5	供应商 E	3.31	2.18
	合计	43.43	28.56

图表 5.10：2019 年 1-6 月发行人向五大供应商采购情况

序号	供应商名称	采购金额（亿元）	占总采购的比例（%）
----	-------	----------	------------

1	供应商 A	3.93	9.12%
2	供应商 B	3.41	7.91%
3	供应商 C	1.52	3.53%
4	供应商 D	1.20	2.78%
5	供应商 E	1.03	2.39%
	合计	11.09	25.73%

注:本表数据包括星科金朋采购信息,但涉及相关保密条款,具体供应商名称无法披露。

由于公司封装形式种类极多,故主要原材料类型和规格众多,使用的金丝主要有 5 种规格,引线框架有上百种之多,塑封树脂有 30 多种规格,芯片有 50 多种。

## 2、销售模式

公司主要是以芯片来料加工业务为主,生产模式是代工模式。封装业务分为先进封装、传统封装、测试和芯片级封装几个部分,其中先进封装以 BGA、LGA 为主的基板封装以及以 QFP、SOP、QFN、DIP、MIS 为主的电路封装,和 DFN、FBP、SOT/SOD、TO 系列的分立器件为主。

客户群体涵盖全球半导体前五十大半导体厂商中除去圆片代工制造之外的绝大部分半导体公司。发行人服务的客户超过一千家,其中活跃客户也在五百家以上。客户选择主要看客户所需要的产品发行人能否提供,结合客户所在的市场或者所需的封装形式是否为公司主要发展方向以及目前工厂产能的紧张程度等决定,新客户导入由业务提出,需要市场、工程、工厂等部门批准后可以建立客户代码。客户的结算方式、帐期、加工产品等需经过公司相关评估后方可导入,并与其签订合同,后续按合同内容执行。欧美客户多数采用 B2B 系统进行结算,因此多数欧美客户的账期都在 30 天,并且根据系统数据自动结算。市场占有率约 19%左右。

### (四) 发行人主要产品产销情况

#### 1、主要消费群体及主要产品销售情况

##### (1) 公司产品的消费群体

公司已经掌握了集成电路封测的中高端技术,特别是 FBP/QFN、WLCSP、SiP、Bump、FC、Fan-in、Fan-out eWLB 等封装技术在国内同行业中处于领先地位,公司有能力把握封测代工业务增量市场的机遇。公司小型分立器件封测已基本达到国际一流水平,产品具有较强的竞争能力和广阔的市场前景,并完全有能力为手机厂商提供分立器件的配套服务。公司主要面向的客户为国际芯片设计制造厂商,产品则主要定位于消费电子、网络通讯、电源管理和汽车电子等应用领域。

## (2) 公司主要产品销售数量和销售价格的变动情况

图表 5.11: 发行人近三年及一期主要产品销售情况

均价单位: 元/块, 元/只, 元/片

产品	2016 年度		2017 年度		2018 年度		2019 年 1-6 月	
	销量	均价	销量	均价	销量	均价	销量	均价
先进封装(百万只)	26,097.26	0.61	28,600.34	0.72	30,361.35	0.68	12,934	0.61
传统封装(百万只)	25,298.38	0.05	29,029.00	0.06	30,277.51	0.06	12,314.55	0.06
测试(百万只)	4,093.34	0.37	4,006.50	0.26	3,700.62	0.27	1,386.81	0.36
芯片(万片)	92.63	322.58	97.21	353.70	92.21	394.69	-	-

注: 芯片销量仅为外销芯片销量, 不包含公司自用部分。

## 2、发行人最近三年及一期向前五名客户销售情况

最近三年及一期公司不存在向单一客户销售金额超过销售总额 50%的情况, 也不存在依赖于少数客户情况。发行人近一年及一期前五名客户具体销售占比情况如下:

图表5.12: 2018年公司向前五名客户销售明细

单位: 亿元、%

序号	客户名称	销售收入	占总销售收入比例
1	客户 A	15.35	6.46
2	客户 B	11.71	4.93
3	客户 C	11.67	4.91
4	客户 D	10.16	4.28
5	客户 E	8.42	3.55
合计		57.31	24.13

图表5.13: 2019年1-6月公司向前五名客户销售明细

单位: 亿元、%

序号	客户名称	销售收入	占总销售收入比例
1	客户 A	4.30	4.70%
2	客户 B	3.70	4.04%
3	客户 C	3.67	4.01%
4	客户 D	3.64	3.98%
5	客户 E	3.45	3.77%

合计	18.76	20.50%
----	-------	--------

注：本表包含星科金朋数据，但涉及相关保密条款，具体客户名称无法披露。

### 3、主营业务收入的区域构成情况

图表 5.14：发行人近三年及一期销售区域构成情况

单位：亿元

业务	2016 年度		2017 年度		2018 年度		2019 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	34.16	17.83%	49.73	20.85%	59.33	24.87%	20.41	22.40%
境外	157.39	82.17%	188.83	79.15%	179.23	75.13%	70.72	77.60%
合计	191.55	100.00%	238.56	100.00%	238.56	100.00%	91.13	100.00%

### （五）公司主要能源供应情况

公司生产所需的主要能源包括电、水、蒸汽。电由各公司所在地供电局供应，水由各公司所在地自来水公司供应，蒸汽由各公司所在地热能公司供应，长电科技成立以来以上能源的供应均保持稳定。

图表 5.15：发行人近三年及一期所用主要能源均价变化情况

能源	2019 年 1-6 月	2018 年	2017 年	2016 度
水（元/吨）	4.03	3.24	3.24	3.24
电（元/度）	0.61	0.61	0.61	0.63
蒸汽（元/吨）	182.64	170.27	163.72	163.72

注：能源数据仅采集江阴市的数据。

### （六）行业关键工艺

目前公司已经掌握一系列高端集成电路封装测试技术，特别是 WLCSP、Copper Pillar Bumping、FC 等封装技术在同行业中处于领先地位；收购了星科金朋后，公司掌握了晶圆封装中 eWLB（嵌入式晶圆级球栅阵列）、TSV（硅通孔封装技术）、3D 封装、SiP（系统级封装）、PiP（堆叠组装）、PoP（堆叠封装）等代表行业未来发展趋势的先进技术。

#### 1、主要技术工艺及用途

主要技术工艺及用途列示如下表所示：

图表 5.16：发行人主要技术工艺及用途简介

技术工艺名称	技术工艺用途简介
先进封装	

技术工艺名称	技术工艺用途简介
FC	倒装芯片封装是将裸硅片通过焊料凸块而非焊线接合过程直接固定在基板上。倒装芯片互连可实现尺寸最小化，降低封装寄生效应，并支持其他传统封装无法实施的新型电源线和地线分布。
WLP	WLP服务包括成套晶圆凸焊服务，还可灵活选择锡膏凸块印刷技术的晶圆再钝化层、再分布层和IPD层，如聚酰亚胺介电材料或焊锡合金。
eWLB	eWLB是一种通用的扇出型晶圆级封装（FO-WLP）技术，专门用于解决互连间隙越来越不匹配的问题，并且较传统封装集成度更高，电气性能更优，垂直互连路径更短。
WLCSP	WLCSP是一种尺寸非常接近裸硅片的封装。WLCSP封装融合了各种封装技术的优势，如裸片封装的尺寸和性能优势、囊封器件的可靠性优势。芯片尺寸封装（“CSP”）的尺寸更小、厚度更薄，重量更轻，非常适合移动设备应用，如手机、笔记本电脑、掌上型电脑、数位相机及个人行动装置。
eWLCSP	eWLCSP™封装方案解决了客户对28纳米先进硅节点的高耐久性要求，并且具有良好成本效益。其特点是在裸片四个侧面涂了一层薄的保护涂层，提高了标准WLCSP尺寸规格内实现耐久性和可靠性。
TSV	利用短而垂直的电气接口或通过硅片的“通孔”，建立从裸片有缘面到背面的电气连接。与焊线接合、倒装芯片堆叠技术相比，TSV技术提高了空间效率和互连密度。与微凸块接合、先进倒装芯片技术联合使用，TSV还可实现高度功能集成和更小形状的特殊性能。
SiP	利用各种堆叠集成技术，将多个具有不同功能的芯片及被动元件集成到尺寸更小的封装元件上。
PoP\PiP	封装利用传统的焊线接合或倒装芯片制程进行堆叠和互连，制成传统的堆叠裸片和堆叠封装结构。
焊线封装	
层压封装	层压基板封装是半导体封装行业增长最快的细分市场之一。这种封装主要应用于计算机平台、网络、手持消费品、无线通信设备、个人数位处理、摄像机、家用电子产品（如DVD）和游戏机。
引脚封装	“引脚”或“引脚框”封装是使用最广泛的封装方式，几乎涵盖每项电子应用，包括汽车、家电、桌面式和笔记本电脑、电信产品。引脚封装自半导体初次生产以来就被广泛应用至今，其特点是半导体芯片被封装在塑料模内，封装体外围布满金属引脚。
增强型引脚框封装	星科金朋的增强型引脚框封装在设计上与标准引脚框封装相似，但更薄更小，并且具有先进的热导电特性，这是许多用于通讯应用的最先进半导体产品所必需具备的。

技术工艺名称	技术工艺用途简介
测试	
混合讯号和射频测试	星科金朋可对各种数位类比混合讯号及射频半导体产品进行测试, 包括通讯应用产品 (如网络路由器、交换机和接口卡)、宽带产品 (如电缆调制解调器机顶盒)、无线通讯产品 (如手机、基站、无线局域网络 (“WLAN”)、蓝牙 (TM) 设备)、PC 和电子消费产品应用。
数位测试	星科金朋可对各种数位半导体产品进行测试, 测试对象包括 PC、磁盘驱动器、调制解调器和网络系统使用的高性能半导体产品。

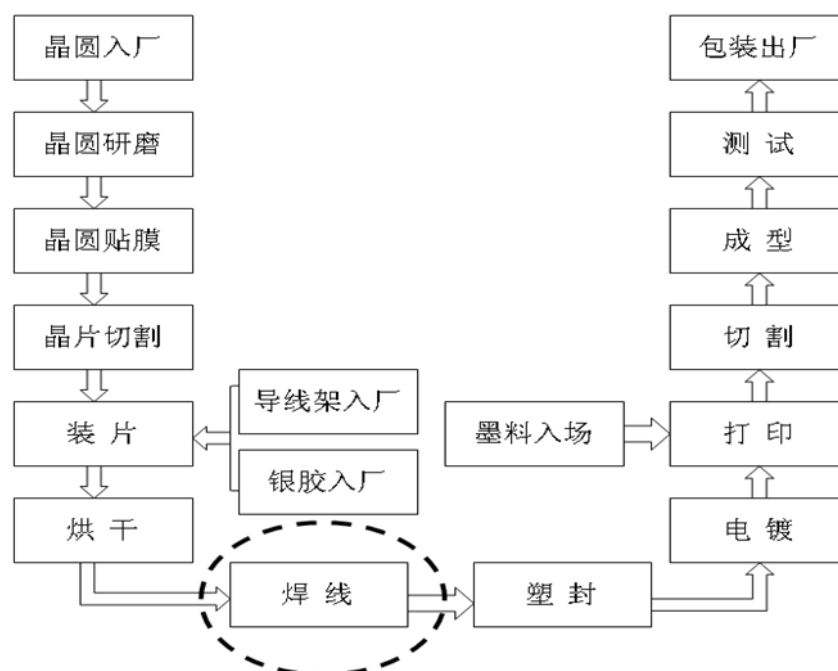
上述主要技术工艺均已处于量产阶段。

## 2、主要技术的工艺流程

先进封装、焊线封装和测试的主要技术的工艺流程大体相同, 具体生产工艺流程如下:

### (1) 焊线封装

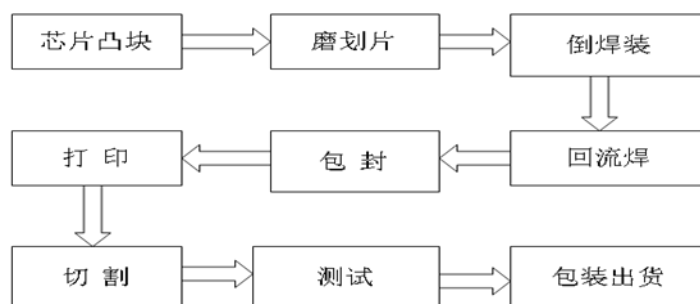
焊线封装产品的主要工艺流程如下图所示:



### (2) 先进封装 (以倒装产品为例)

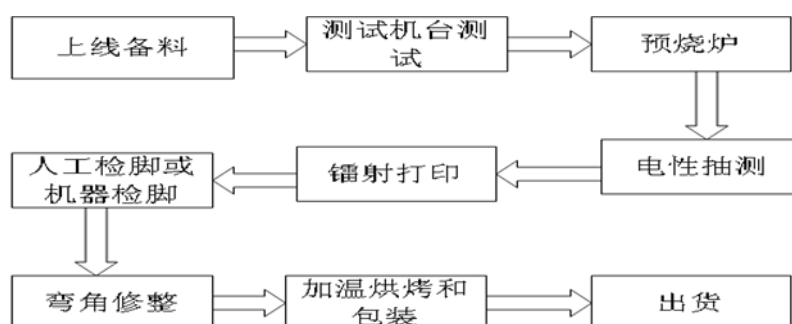
先进封装产品系列较多, 工艺复杂, 下图以倒装产品为例, 介绍其工艺流程:





### (3) 测试

测试旨在确保封装后的集成电路满足性能规格。测试环节包括利用复杂的测试设备测试仪和定制软件对封装后集成电路的多项特性进行电气测试，具体包括功能性、速度、预测耐久性和耗电情况，测试的主要工艺流程如下图所示：



### (七) 技术研发情况

公司 2008 年 10 月被认定为“高新技术企业”。随着封装技术的不断提高，公司已逐步摆脱了低端市场的无序竞争，进入良性发展轨道。公司的整体技术水平达到了目前国内外先进水平。

集成电路封装测试方面，发展重点转向 FBP/QFN、WLCSP、SiP 等高端市场，而在 DIP 类低端封装市场业务规模相应缩减。公司曾先后开发出了应用于快闪存储记忆体的集成电路 TSOP、TQFP 和应用于逻辑线路的 SSOP、HSIP、MSOP 等一批集成电路封装技术，自主研发出具有多项知识产权和技术创新的 FBP、SiP 等封装技术，并通过引进吸收和二次研发成功实现了圆片级芯片尺寸封装（WLCSP）技术的产业化，目前全球能够实现该技术产业化的封装测试企业主要有日月光、安靠、矽品以及长电科技四家公司，从而亦奠定了公司在国内封装领域的领先地位。

分立器件封装测试方面，公司先后开发 SOT/SOD 等一系列超小型高附加值的二极管、三极管封装测试技术。同时，分立器件的片式化改造也使公司摆脱了恶性竞争的低端市场，进入良性发展的轨道。公司目前是国内内资企业中片式分立器件规模最大的厂商。

近三年发行人累计研发投入约 23.1 亿元，用于多种封装技术的研究与开发。持续加强先进封装测试技术的领先优势，并通过实施各种先进研发项目来实现产品组合的多元化。尤其在 2008 年下半年美国金融危机爆发以来，面对市场需求

下降、资金短缺的不利情况，发行人仍持续加大研发创新，不断进行产品结构的调整，逐渐增加中高端产品的市场份额，并保存一定的技术储备。

2009 年 6 月，公司联合中科院微电子研究所、清华大学微电子所、深圳先进技术研究院、深南电路有限公司共同组建了国内首家“高密度集成电路封装技术国家工程实验室”，意味着国家重点扶持的我国集成电路封装技术产学研相结合的工程实验平台正式启动。

实验室将为我国先进电子封装技术的产业化提供核心、共性技术支撑，提供企业所需要的产前核心技术、专利与人才培养，提高自主创新的核心竞争力，为我国封装产业的发展和产业升级提供引领和带动作用；实验室的目标是在若干先进封装核心技术和关键工艺方面取得突破，接近或达到世界先进水平。

实验室的组建方均在行业内具有较强的技术及研究实力，长电科技依托该实验室，通过与其他各方的合作，开发研究实力将进一步增强。

自公司成立以来，公司始终努力提高自主创新能力，目前公司（含控股子公司）拥有多类型、多品种专利。上述专利不存在权属纠纷。截至 2018 年末，发行人拥有专利 3673 件，其中发明专利 2844 件（在美国获得的专利为 1798 件），覆盖中高端封测领域，研发实力很强。

## 九、发行人在建工程与拟建工程

### （一）在建项目情况

图表5.17： 发行人主要在建项目情况表

单位：亿元

项目名称	预计竣工	总投资	截至 2019 年 6 月末 累计投资	未来投资计划			资金来源
				2019 年 6-12 月	2020 年	2021 年	
年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目	2020 年	17.35	11.96	2.13	3.26	-	自筹+募集
通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目	2021 年	23.50	10.88	2.47	5.00	5.15	自筹+募集
低功耗电源管理类集成电路生产线技改扩能	2019 年	1.20	0.89	0.31	-	-	自筹
江阴城东厂南区二期厂房进行净化装修	2019 年	4.20	3.60	0.60	-	-	自筹
江阴城东厂新建污水处理站	2019 年	0.70	0.58	0.12	-	-	自筹
新建高密度集成 SIP 封装测试生产线	2019 年	1.26	0.79	0.47	-	-	自筹
对 4G 高端射频模块集成电路和产线技改扩能	2019 年	5.40	4.21	1.19	-	-	自筹
长电滁州超小型分立器件等生产线技改扩能	2019 年	2.99	2.84	0.15	-	-	自筹

长电(宿迁)扩充集成电路封测产能	2019 年	3.98	2.20	0.70	1.08	-	自筹
宿迁新生产基地建设	2021 年	15.80	0.07	2.00	5.43	8.30	自筹
Bumping 生产线扩能	2021 年	3.16	1.66	0.49	0.50	0.51	自筹
WLCSP/COG 生产线扩能	2019 年	2.30	2.22	0.08	-	-	自筹
星科金朋(韩国)有限公司新建 BUMP 生产线并对部分生产线填平补齐	2021 年	7.78	2.93	0.96	2.00	1.89	自筹
星科金朋半导体(江阴)有限公司部分生产线填平补齐	2020 年	4.74	4.74	-	-	-	自筹
星科金朋新加坡厂 WL-CSP 生产线填平补齐	2020 年	2.44	0.98	0.48	0.98	-	自筹
<b>合计</b>	-	<b>96.80</b>	<b>50.55</b>	<b>12.15</b>	<b>18.25</b>	<b>15.85</b>	-

### 1、通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目

经江阴市经济和信息化委员会批准(备案号: 3202851600839), 发行人总投资35606万美元, 引进晶磨划片机、等离子刻蚀机、表面贴片机等进口设备322台, 购置晶圆涂胶机、光刻机、晶圆单片湿法腐蚀机等国产设备91台。项目建成后, 形成年产47亿颗通讯与物联网集成电路中道封装(WLCSP/FOWLP/TSV封装等)的生产能力。

### 2、年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目

经无锡江阴市经信委批准(备案证号: 江阴经信委{2017}69号)。本项目产品为通信用集成电路及模块封装产品, 高密度集成电路封装具有良好的电和热性能、体积小, 重量轻、其应用正在快速增长。引进全自动磨片机、全自动晶圆切割机、全自动晶圆激光切割机等进口设备1478台, 配套购置风冷式烤箱等国产设备173台, 并对现有厂房内的水、电、气进行适应性改造。项目完成后, 形成年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装产品的生产能力。

### 3、宿迁新生产基地建设

经宿迁市苏宿工业园区招商与经济发展局批准(备案号: 苏宿园备{2018}7号)。本项目用地约86亩, 建成后新建厂房建筑面积70000m<sup>2</sup>, 产品为通信用高密度混合集成电路及模块封装。项目从国外引进全自动晶圆划片机、回流焊炉等进口设备1640台, 配置国产设备测试主机等370台, 建成后形成年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装产品的生产能力。

## (二) 拟建工程

图表 5.18: 发行人主要拟建项目情况表

单位: 万元

序号	项目名称	计划总投资	自筹资金	2019 投入	2020 投入
1	倒装测试产能扩充项目	96,286.00	96,286.00	96,286.00	-
2	SOT-23 扩排项目	2,197.65	2,197.65	900.00	1,297.65

#### 1、倒装测试产能扩充项目

本项目是承担 PMU/AP/RFIC 产品封装和测试的生产，覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案。项目从国外引进多台测试机、分选机、切割机、植球机、切割治具、包封模具等设备。

#### 2、SOT-23 扩排项目

由于现有 SOT-23(6FN)封装窄排产品密度较小、成本较高、毛利率较低，通过框架设计优化，增加自动化设备，以提高产品密度、降低产品成本。

### 十、发行人业务发展目标

公司总体经营思路：抓住中国集成电路产业崛起带来的巨大发展机会，全面加深并拓宽与大客户的业务合作；积极实施面向未来的技术研发布局；重点开拓潜力细分市场业务；建成各具特色及优势的全球工厂布局。在质量、服务、管理等方面实现全面赶上；在产品和技术领域实现局部超越。实现把长电科技建成全球数一数二的集成电路封测企业的战略目标。

根据公司的业务发展规划，公司未来将打造一个具有自主知识产权、拥有核心技术，在规模和技术上领先于国内同行的、世界级的半导体封装测试知名企业；未来三年的经营目标之一为在充分释放近年来规模化投资后新增产能的同时，疏通瓶颈进行适量投资，并依托“高密度集成电路封装技术国家工程实验室”的平台，整合资源，重点研发高技术含量、高附加值的产品并进行产业化，强化公司在封装领域里的核心竞争能力，力争使公司成为世界级的半导体封装企业。

因此，虽然公司目前在技术和规模上均具备一定的竞争实力，未来几年大规模的资本性支出将逐渐减少，但公司所处行业为资本和技术密集型行业，资本投入大，为保持公司在行业中的核心竞争优势和竞争实力，未来仍将进行适量的投资。

### 十一、发行人所在行业情况

#### (一) 行业现状

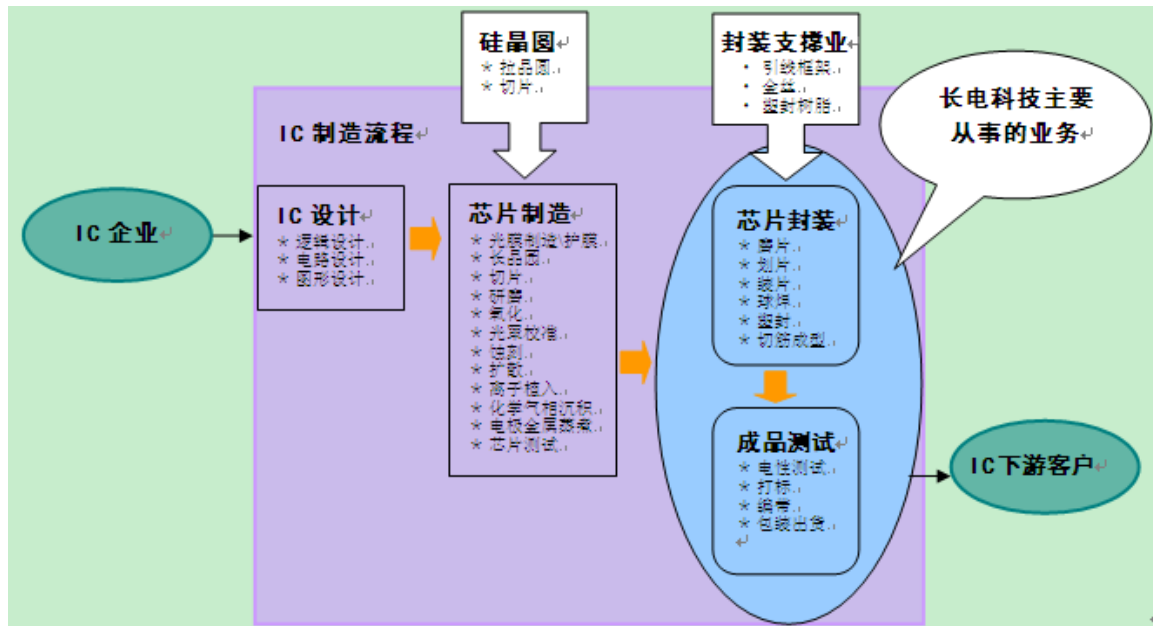
##### 1、行业基本情况介绍

集成电路和分立器件封装测试属半导体行业，半导体市场由集成电路、分立器件、光电子器件和传感器四类市场构成。各分支包含的产品种类繁多，被广泛应用于消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等诸多领域。半导

体行业中，集成电路一直占据主导地位，2018 年度，根据美国半导体行业协会（SIA）统计数据计算，集成电路市场份额达到整个半导体市场的 83.9% 左右。

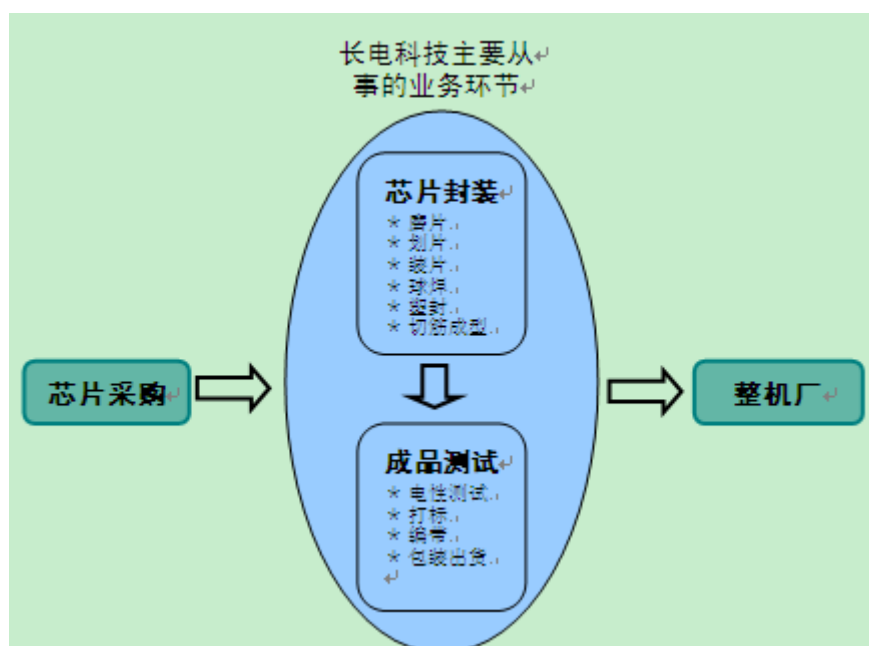
集成电路产业（产业链如下图所示）是半导体产业中的典型代表，因为其技术的复杂性，产业结构向高度专业化转化，整个产业细分为 IC 设计业、芯片制造业及 IC 封装测试业三个子产业群。

图表 5.19: 集成电路产业链



在半导体产业中，产品集成化的发展趋势引人瞩目。按照摩尔定律，集成电路上可容纳的晶体管数目，约每隔 18 个月增加一倍，性能也将提升一倍，而价格下降一半。但半导体分立器件的应用仍不可替代，特别是大功率、大电流、高反压及低噪声分立器件，由于其不易集成或集成成本高，仍具有非常广阔的发展空间。即便是集成技术难度较低的小型号晶体管，由于分立器件明显的价格优势，也仍具有相当稳定的市场空间。相对而言，分立器件行业的专业化分工细化程度不如集成电路行业，如下图所示，分立器件制造工序与集成电路基本相同，但其设计和芯片制造往往融为一体。

图表 5.20: 分立器件产业链



如上图所示，无论是集成电路还是分立器件，封装测试都是整个制造过程中的重要环节，发行人专注于封装技术的不断提高，通过将小型化、超小型精密制造的封装技术应用于集成电路和分立器件的生产，使产品满足了电子器件更小、更薄、更轻、高可靠、多功能、低功耗和低成本的市场需求，得到了客户的广泛认同。

## 2、行业竞争格局及主要企业

### (1) 全球竞争格局及主要企业

公司主要从事集成电路和分立器件的封装、测试。从全球范围来看，国际厂商掌握高端技术，资本力量雄厚，拥有丰富经验，具有较强的竞争优势；国内企业起步较晚，但发展迅速，正在逐步缩小与国际厂商之间的差距，其中个别公司的技术已经基本和全球同步。

#### ① 集成电路封装测试业

就集成电路封装测试产业而言，其产能已逐步从欧美发达国家向亚太地区转移，目前，全球从事半导体封装测试的国家和地区主要是台湾地区、马来西亚、中国大陆、菲律宾、韩国和新加坡。台湾地区依靠集成电路封装测试起家，在全球集成电路封装测试行业占据领先地位。2019 年一季度全球前十大封装测试公司中，台湾地区的企业占据了其中的五个，公司排名全球第 3 位。

#### ② 分立器件行业

全球分立器件主要厂商均为半导体器件行业巨头，从地域分布来看，主要集中在日本、美国和欧洲。国际分立器件市场中，日资企业产品销售额占全球行业销售额的 50% 以上，全球前 20 大分立器件厂商中日本厂商占 10 家，包括东芝、瑞萨、罗姆、松下、NEC、三肯、富士电子、三洋、新电元以及富士通等。美国厂商在全球分立器件市场也具有较重要的地位，代表厂商有 Vishay、仙童、国际

整流器公司以及安森美等。欧洲也是分立器件产业发达的地区，主要厂商包括飞利浦半导体、意法半导体和英飞凌等。

近年来，亚太地区半导体市场发展最为迅速，韩国、台湾、新加坡、马来西亚等国家和地区电子信息制造业的高速发展为该等地区半导体市场提供了广阔的需求空间。目前，全球半导体市场的增长主要是由亚太地区支撑，但该地区分立器件企业的规模相对较小，进入世界前 20 大分立器件厂商的企业仅有韩国电子（KEC）一家。

## （2）国内竞争格局及主要企业

### ① 集成电路封装测试业

国内封装测试企业主要集中于长三角地区，珠三角地区和京津环渤海湾地区，其中长三角地区封装测试业占到全国的 75% 左右。封装测试产业集中度最高的省份为江苏，占全国封装测试业的 60% 左右，其次为上海和广东。

我国集成电路封装测试企业中外资占据主导地位。近年来，国外半导体企业纷纷投入巨资建立独资或合资的封装测试工厂，形成了我国集成电路封装测试业由外资主导局面，由飞思卡尔、英特尔、飞索、松下、富士通、意法半导体、瑞萨、英飞凌等国际大型集成电路企业在华投资设立的封装测试厂，无论在规模上还是在技术水平上都居于领先地位，目前外商投资企业占据国内封装测试产业的 60% 以上。

内资企业在资本规模、投资能力、技术水平等方面均与外资企业存在明显的差距，但是近年来，技术差距在迅速缩小。由于资金和技术等因素的限制，大部分内资企业的封装形式仍停留在 DIP、TO、QFP 等中低端领域，但以长电科技、华天科技等为代表的一批封装企业在近几年得到了国家和资本市场的支持，在技术研发和先进装备方面进行了大量的投资，产品档次逐步由低端向中高端发展，在 SOP/TSSOP、PGA、BGA 和 CSP 以及 SiP、MCM 等先进封装形式的开发和应用方面取得了显著成果，与国际先进技术水平的差距正迅速缩小。

### ② 分立器件行业

与集成电路封装测试行业类似，国内分立器件行业也是外商独资、合资企业占据主导地位，内资企业虽然已经得到相当程度的发展，但无论在企业规模还是技术水平上，均差距明显，外资品牌产品仍占据了国内市场的绝大部分销售份额。

## （二）半导体行业市场状况

### （1）全球半导体市场情况

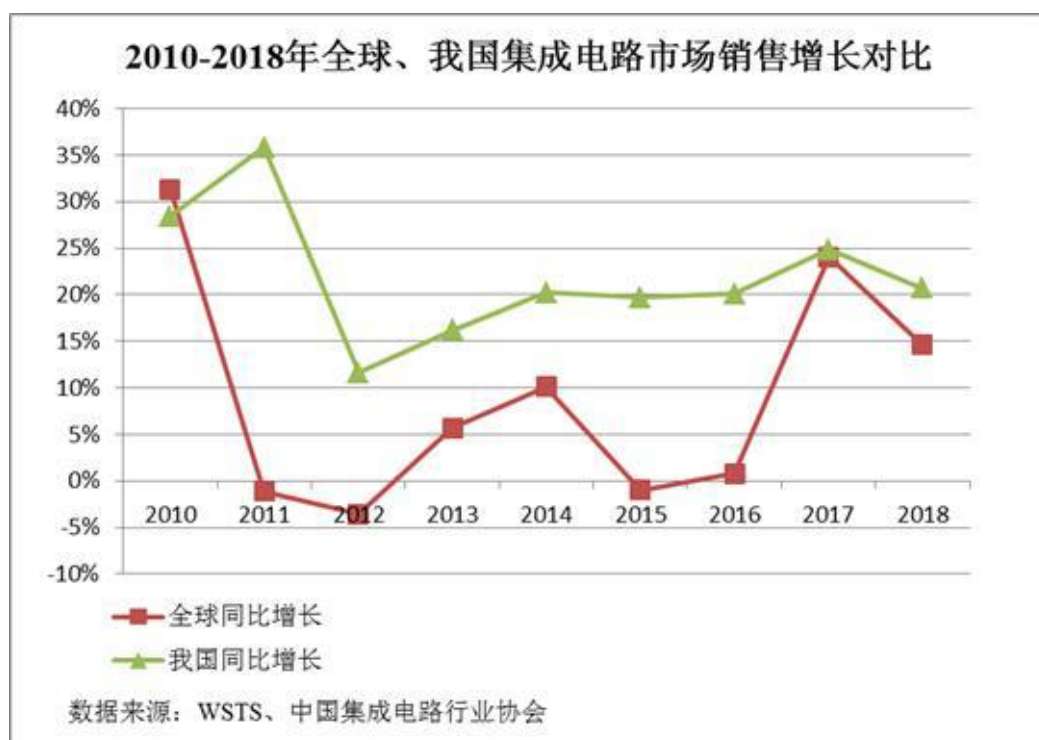
据世界半导体贸易统计协会（“WSTS”）的报告，2018 年全球半导体市场销售收入 4,688 亿美元，同比增长 13.7%，其中集成电路市场同比增长 14.6%，存储器芯片市场同比增长 27.4%。受半导体景气周期影响，同时随着存储器芯片市场的供需关系渐趋于合理，预计 2019 年全球半导体市场销售收入将下降

12.10%，集成电路销售收入将下降 4.3%。

## (2) 我国集成电路市场情况

在国家政策大力支持下，我国集成电路市场保持高速增长，根据中国半导体行业协会统计，自 2009 年至 2018 年，我国集成电路销售规模从 1,109 亿元增长至 6,532 亿元，期间的年均复合增长率达到 21.78%。2018 年，受第四季度全球半导体市场下滑影响，中国集成电路产业 2018 年全年增速有所放缓，同比增长 20.7%，其中，设计业同比增长 21.5%；制造业同比增长 25.6%；封装测试业同比增长 16.1%。

图表 5.21: 2010-2018 年全球、我国集成电路市场销售增长对比



## (3) 封装测试子行业:

由于市场对于微型化、更强功能性及热电性能改善的需求提升，半导体封测技术的精密性、复杂度和定制性继续增强。该趋势导致众多集成电路制造商将封测业务外包给专门的封测外包企业，不仅有利于提升产品品质，同时还可以降低此资本密集度较高行业的资本支出。许多集成电路制造商还将封测外包企业作为获得封测新设计和先进互连技术的主要来源，同时借此降低内部研发成本，所以市场对于封测外包企业的技术和质量要求也越来越高。

集成电路封装技术的演进主要为了符合终端系统产品的需求，为配合系统产品多任务、小体积的发展趋势，集成电路封装技术的演进方向即为高密度、高脚位、薄型化、小型化。集成电路封装技术的发展可分为四个阶段，第一阶段：插孔原件时代；第二阶段：表面贴装时代；第三阶段：面积阵列封装时代；第四阶段：高密度系统级封装时代。目前，全球半导体封装的主流正处在第三阶段的



成熟期，FC、QFN、BGA 和 WLCSP 等主要封装技术进行大规模生产，部分产品已开始向第四阶段发展。SiP 和 3D 是封装未来重要的发展趋势，但鉴于目前多芯片系统级封装技术及 3D 封装技术难度较大、成本较高，倒装技术和芯片尺寸封装仍是现阶段业界应用的主要技术。

#### （4）行业上下游情况：

集成电路产业链包括集成电路设计、集成电路制造、封装与测试、装备材料行业。公司所属封装与测试位于产业链中下游，是集成电路产业链上重要的一个环节。集成电路封测的客户是集成电路设计公司和系统集成商，设计公司设计出芯片方案或系统集成方案，委托集成电路制造商生产晶圆（芯片），然后将芯片委托封测企业进行封装、测试，再由上述客户将封测好的产品销售给电子终端产品组装厂。

集成电路封装测试行业的供应商是装备材料。封测的主要原材料为：芯片、基板、合金线、金线、引线框、塑封料等，原材料的供应影响封测行业的生产，原材料价格的波动影响封测行业的成本。近年来我国集成电路封装测试行业的快速增长，也带动了集成电路支撑产业的发展，国产装备和材料的进口替代份额正在逐步增加。

集成电路封装测试行业是为集成电路设计公司及系统集成商提供芯片封测服务。设计公司及系统集成商可以根据消费市场的需求不断创新产品，同时新产品又创造了新的需求，拉动消费市场的增长。终端设备的智能化、功能多样化、轻薄小型化促使芯片封测技术不断向高密度、高速率、高散热、低功耗、低时延、低成本演进。集成电路设计拉动了半导体产业的技术进步和产品更新，而制造业、封测业及支撑业的技术进步又促进了集成电路设计业的发展，随着集成电路进入后摩尔时代，集成电路上下游产业链的协同创新的作用显得更为突出和重要。

### （三）进入本行业的主要障碍

#### 1、资本需求大

封装测试业是资本密集型行业，且规模效应显著。封装测试所需的机器设备大部分要从国外进口，资金需求量较大。经过十多年的发展，行业内的主要企业均具有相当的规模，大大抬高了新进企业的初始投资门槛。就国内而言，近年来在封装测试业投资的主要是国外半导体企业（如飞思卡尔、海力士）、国际专业封装测试企业（如日月光）和国内上市公司（如长电科技、通富微电、华天科技），其中，外资企业的初始投资较大，远远超过内资企业的投资规模。

#### 2、技术要求高，且需要持续的工艺积累

半导体封装测试行业属于技术密集型行业，行业的进入需要丰富的生产加工经验，技术水平要求较高。半导体封装测试行业属于高度标准化的行业，表现在产品上，各种形式的产品均为标准化的。行业的创新主要体现为产品生产工艺上的创新，技术水平主要体现为产品加工的工艺水平。生产工艺的创新和技术水平

主要来源于企业长时间、大规模的生产实践和研究开发，需要持续的生产经验的积累。

### 3、专业人才要求高

本行业属于高科技行业，对专业技术人才的要求较高，企业的专业人才供应主要有两个来源：一是自身培养，二是外部引进。目前行业内掌握专业技术的人才供给是有限的，尚不能满足行业发展的需求，因此对新进入的企业，将面临专业人才较缺乏的问题。

### 4、客户对企业严格的认证制度

根据本行业的特性，公司在与下游客户建立合作关系、接受订单前，需要通过客户的严格认证，该认证主要包括对公司质量管理体系的认证、对公司的内部生产管理流程审查以及判断公司产品可靠性是否达到行业标准、公司的财务状况是否满足客户的及时交货要求等。客户认证的周期较长，一般都在半年以上，个别国外客户认证期甚至长达两年。严格的客户认证制度增加了新进入的企业获得订单的难度。

#### （四）行业管理体制

我国半导体产业的行政主管部门是国家工业和信息化部（以下简称“工信部”，2008年6月29日正式挂牌，前身是国家信息产业部），主要负责产业政策、发展规划的制订及项目审批。

中国半导体行业协会（CSIA）是半导体制造业的行业自律管理机构，是由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位及其它相关的企、事业单位自愿参加的、非营利性的、行业自律的全国性社会团体，主要职责是规范行业行为，协调价格，维护公平竞争，汇总发布行业信息，研究分析行业发展动向，为企业提供行业咨询服务等。下设集成电路分会、半导体分立器件分会、半导体封装分会、集成电路设计分会和半导体支撑业分会共5个分会。公司是半导体行业协会的常务理事单位，封装分会的副理事长单位，分立器件分会的理事长单位。

#### （五）行业主要政策

半导体产业一直是国家重点鼓励和支持的产业，国家也相继出台了若干配套政策，促进了半导体行业的飞速发展，并为半导体行业在“十一五”期间的技术突破和产业升级奠定了坚实的基础。

图表5.22：发行人所处行业主要政策

序号	法规名称	发布时间	颁布主体
1	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发18号文）	2000.6.24	国务院
2	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业	2002.10.10	财政部、国家税务总局

序号	法规名称	发布时间	颁布主体
	《发展税收政策的通知》		
3	《集成电路产业研究与开发专项基金管理暂行办法》	2005.4.11	财政部、发改委、信息产业部
4	《国家鼓励的集成电路企业认定管理办法》	2005.12	发改委、信息产业部、国家税务总局、海关总署
5	《产业结构调整指导目录》（2005 本）	2005.12.2	国务院
6	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》	2006.2.9	国务院
7	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》	2007.1.23	发改委、科学技术部、商务部
8	《电子信息产品污染控制管理办法》	2007.3.1	信息产业部等
9	《集成电路产业“十一五”专项规划》	2008.1.8	信息产业部
10	《电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划》	2008.1.9	信息产业部
11	《关于企业所得税若干优惠政策的通知》	2008.3.19	财政部国家税务总局
12	《电子信息产业调整和振兴规划》	2009.4.15	国务院
13	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的政策措施》	2011.1.12	国务院
14	《集成电路产业“十二五”发展规划》	2011.12	工信部
15	《国家集成电路产业发展推进纲要》	2014.6.24	国务院
16	《中国制造 2025》	2015.05	国务院
17	《集成电路产业“十三五”发展规划》	2015.11	国务院
18	《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于进一步鼓励集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	2016.01	财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部
19	《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》	2018.03	财政部
20	《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	2019.05	财政部

相关主要政策具体内容如下：

2000 年国务院出台《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发 18 号文），是集成电路产业的核心政策。《集成电路产业研究与开发专项基金管理暂行办法》（财建[2005]132 号）为 18 号文修改后的重要补充部分，按照

该办法，以后每年国家将会持续提供资金来支持集成电路的研发项目，并明确将资金的申请对象扩大到封装测试企业。

《国家鼓励的集成电路企业认定管理办法》将从事集成电路芯片制造、封装、测试以及 6 英寸（含）以上硅单晶材料生产的具有独立法人资格的组织归类为集成电路制造企业。通过该办法认定为集成电路企业的公司，可享受财税激励、技术创新、市场促进、人才保障等方面的政策优惠，加速企业的发展。

《产业结构调整指导目录》（2005 年本）将信息产业中大规模集成电路装备制造、新型电子元器件制造列为鼓励发展的产业。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》中，先进封装工艺开发及产业化被列为 02 专项，主要包括：研究开发球栅阵列封装 BGA、芯片尺寸封装 CSP、多芯片封装 MCP、圆片级封装 WLP、倒装封装 FC、封装内封装 PIP、大容量闪存集成封装等。

《集成电路产业“十一五”专项规划》从打造完善产业链的角度，结合产业链各环节的特点，提出了我国集成电路产业发展思路。提出在封装测试领域，要主要考虑结构调整和技术升级，要进一步加强先进封装能力的建设，使国内封装测试业的技术水平达到国际主流，多种新型封装形式能实现规模生产，并要求提升产品档次，满足集成电路产业的技术进步，大力发展先进的 BGA、PGA、CSP、MCM、SiP 等先进封装技术，提高测试技术和水平，继续保持竞争优势。

《电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划》规划到 2010 年，我国电子元器件总产量达到 1.8 万亿只，阻容感片式化率达到 90%。电子元器件国际市场占有率达到 30%，国内市场占有率达到 50%。电子元件百强企业的销售收入占元器件全行业的 40%以上。

《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号），对软件、集成电路产业的企业所得税优惠政策进行了明确。规定自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年底，对集成电路生产企业、封装企业的投资者，以其取得的缴纳企业所得税后的利润，直接投资于本企业增加注册资本，或作为资本投资开办其他集成电路生产企业、封装企业，经营期不少于 5 年的，按 40%的比例退还其再投资部分已缴纳的企业所得税税款。

《电子信息产业调整和振兴规划》，规划强调完善集成电路产业体系。支持骨干制造企业整合优势资源，加大创新投入，推进工艺升级。继续引导和支持国际芯片制造企业加大在我国投资力度，增设生产基地和研发中心。完善集成电路设计支撑服务体系，促进产业集聚。引导芯片设计企业与整机制造企业加强合作，依靠整机升级扩大国内有效需求。支持设计企业间的兼并重组，培育具有国际竞争力的大企业。支持集成电路重大项目建设与科技重大专项攻关相结合，推动高端通用芯片的设计开发和产业化，实现部分专用设备的产业化应用，形成较为先进完整的集成电路产业链。

《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的政策措施》，（1）强化投融资支持。中央预算内投资支持符合条件的集成电路企业技术进步和技术改造项目。鼓励、支持企业跨地区重组并购，加强产业资源整合。引导设立股权或创业投资基金，积极推动企业利用知识产权等无形资产进行质押贷款，拓宽企业融资渠道。（2）加大对研究开发的支持力度。发挥国家科技重大专项的引导作用，大力支持软件和集成电路重大关键技术的研发，加快具有自主知识产权技术的产业化和推广应用。鼓励企业建立产学研用相结合的产业技术创新战略联盟。（3）实施税收优惠。继续实行对软件产品的增值税优惠政策，对符合条件的企业分别给予营业税和所得税优惠。（4）加强人才培养和引进。完善对研发人员的激励机制。加强高校软件工程和微电子专业建设，鼓励有条件的高校与集成电路企业联合建立微电子学院，支持建立校企结合的人才综合培训和实践基地。加快海外高层次人才引进。（5）严格落实软件和集成电路知识产权保护制度，依法打击各类侵权行为。进一步推进软件正版化，全面落实政府机关使用正版软件的政策措施，大力引导企业和社会公众使用正版软件。支持企业依法到国外申请知识产权。（6）加强市场引导，规范市场秩序；加强反垄断工作，创造良好产业发展环境；维护消费者合法权益；完善进出口支持政策。

《集成电路产业“十二五”发展规划》（以下简称“规划”）将提升封测业层次和能力、发展先进封测技术和产品作为提升集成电路产业核心竞争力的重要途径；大力发展先进封装和测试技术，支持封装工艺技术升级和产能扩充；提高测试技术水平和产业规模。规划的发布为我国半导体企业进一步扩大规模和提高核心技术提供了较大的发展空间

2014 年 6 月 24 日，国务院发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，成立国家集成电路产业发展领导小组，在 IC 设计、晶元制造、芯片封测以及基础材料上提出中长期目标及要求，同时设立国家产业投资基金，支持设立地方性集成电路产业投资基金，加大金融支持力度，在多方面对产业给与扶持，落实税收支持政策，所得税优惠政策、装备和产品关键零部件及原材料进口免税政策方面给予支持。

2016 年 1 月 6 日，财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部发布了《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于进一步鼓励集成电路产业发展企业所得税政策的通知》。政策主要内容：符合条件的集成电路封装、测试企业以及集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业，在 2017 年（含 2017 年）前实现获利的，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止；2017 年前未实现获利的，自 2017 年起计算优惠期，享受至期满为止。

2018 年 3 月 28 日，财政部、税务总局、国家发展改革委及工业和信息化部

发布了《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》，提出的政策优惠包括：对符合条件的企业免征及一定时间后按照 25% 的法定税率减半征收所得税；在过去“两免三减半”基础上享受“五免四减半”的进一步优惠等。

2019 年 5 月 17 日，财政部、税务总局发布了《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

## （六）半导体行业未来发展趋势

### 1、下游需求的高速增长和产品的不断升级

半导体终端需求的增长来源于下游整机市场的拉动，包括 PC、手机、消费电子、汽车电子等，其中智能终端已经取代 PC 成为半导体应用的最大市场。

首先，受益于全球新兴市场需求的快速增长以及成熟市场对于新功能手机的更新换代需求，全球手机市场将保持快速增长的态势。国内方面，由于中国智能手机渗透率相对成熟市场仍有差距，国内 5G 的不断建设，中国智能手机市场仍有一定的增长空间。其次，PC 销量保持平稳、平板电脑渗透率持续提升，预计未来几年平板电脑出货量将保持 20% 以上的增长速度；虽受到平板电脑的冲击，但由于平板电脑现在不能满足人们日常高负荷办公应用需求，笔记本电脑在办公应用方面有刚性需求，同时考虑到现有电脑的更新换代，笔记本电脑仍将维持一定增长。最后，随着全球经济逐步复苏，数码相机、便携媒体播放器、游戏机、电子书阅读器等消费电子将保持快速增长。

技术方面，随着经济持续动荡，用户对于电子产品的需求转向技术先进功能强并具有经济性的创新产品。同时，受互联网、云计算、5G 等新技术的推动，电子产业进入互联互通的时代，在此背景下，半导体产业技术创新更为活跃。受技术不断创新的影响，半导体行业将进入上升期。

全球半导体委外封测市场在 2019 年一季度有所下滑。根据美国半导体产业协会(SIA)统计，2019 年全球半导体销售步调将从去年高景气度开始下滑，很大程度是因为全球经济不确定性及半导体企业库存高企；在 2019 年上半年虚拟货币市场大幅下滑；预估 2019 年下半年销售将温和回升。

总体上看，尽管短期内景气度开始下滑，但半导体下游需求增长，技术创新不断出现，同时产能暂时不会出现快速扩张，下游订单的增长，行业产能利用率将显著提高，行业景气度保持较高水平。

### 2、产业结构的优化升级

我国半导体行业正在逐步由中低端向中高端转化，尤其在集成电路设计及封

装测试子行业中已经拥有高端技术，并完全具备技术产业化的能力，产业结构提升空间十分广阔。从实际情况来看，近年国内半导体企业的产品结构升级趋势十分明显，且这种趋势仍将持续。

### 3、进口替代的逐渐加强

以前大量进口高端产品是因为国内自身高端产品生产能力有限，难以从国内下游市场增长中受益（国内下游需求增长以高端为主）。但近几年国内半导体产业结构逐渐向高端发展，以满足更多的国内高端需求。从历史数据来看，在过去的几年里，我国半导体产品的自给率在逐年提升，国内企业因此能更多地从国内需求增长中受益。

## （七）所处行业与上、下游行业之间的关联性

### 1、公司所处行业上下游的界定

集成电路产业链是以电路设计为主导，由电路设计公司设计出集成电路，然后委托芯片制造厂生产晶圆，再委托封装厂进行集成电路封装、测试，然后销售给电子整机产品生产企业。集成电路设计企业委托公司进行封装加工，是客户；封装支撑企业为公司提供生产所需的原材料，是公司的供应商。

公司的分立器件业务采用代工模式部分和上述界定类似。

### 2、上下游行业的影响分析

半导体封装测试行业的上游是封装测试材料（引线框架、键合金丝和塑封材料等）行业，也可以称之为封装测试支撑业。近年来我国半导体封装测试行业快速稳定发展，也带动了上游企业的稳定增长，以不断满足封装测试行业的市场需求。

①引线框架：随着全球封装业向国内的转移，我国引线框架的需求增长迅速。目前国内主要引线框架企业有 10 多家，规模差距不大。随着封装方式向尺寸小、密度高的方向发展，引线框架也在向高端化发展，其引脚越来越多、间距越来越小、精度则越来越高，而且在 BGA、CSP、MCM 和 SiP 等先进封装技术中，已出现引线框架被层压基板所取代的现象，国内引线框架业的产业结构将随之作出调整。

②键合金丝：随着国内封装技术的进步，低端键合金丝产品的需求日趋下降。为满足不断提高的市场需求，键合金丝生产企业也不断加大投入，研发制造出可以适应先进封装技术的更细线径的、拥有更高性能电参数、强度参数、成球参数等指标的优质键合金丝产品。

③塑封材料：由于国内半导体封装技术的发展和产品技术的升级换代，特别是海外封装企业加快向国内转移，一些高端的封装产品相继在大陆市场上加工投产，导致芯片塑封料市场需求量持续增长。塑封料厂家顺应这种趋势，不断加大投入以扩大规模和提高技术，产品结构逐渐优化，技术持续升级，芯片塑封料

的国内自给率将不断提高。目前中国大陆芯片塑封料年产能已达到 8 万吨。

公司与行业上游的重要企业建立了长期的合作关系。

公司下游行业集成电路设计业的需求直接带动本行业的销售增长，集成电路设计的需求变化导致本行业的工艺变化和技术更新，因此下游行业对本行业的发展有决定性的影响。

与上述类似，公司分立器件制造的下游行业计算机、通讯和消费类电子产品的需求也直接带动本行业的增长，

## 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势

### （一）发行人行业地位

发行人已经掌握了集成电路封装测试的中高端技术，特别是 FBP/QFN、WLCSP、SiP、EWLB 等封装技术在同行业中处于领先地位，公司有把握封装测试代工业务增量市场的机遇。公司主要面向的客户为国际代工、设计厂商，产品则主要定位于消费电子、电源管理和汽车电子等应用领域。

作为国内第一家半导体封装测试行业上市企业，公司业务持续高速增长，连续多年被原信息产业部评为“中国电子百强企业”，“中国电子质量百强企业”，公司的“长江”品牌获“江苏省名牌产品”、“中国半导体十大品牌”称号。2018 年末，公司业务规模位已居世界前列。近三年公司在全球十大封装测试企业排名如下：

图表 5.23: 封测行业前十大封测外包企业近两年市场占有率

排名	公司	地区	2017 年市场占有率	2018 年市场占有率
1	日月光 (ASE)	台湾	19.2%	18.91%
2	安靠 (Amkor)	美国	15.0%	15.62%
3	长电科技	中国大陆	11.9%	13.14%
4	矽品 (SPIL)	台湾	9.9%	10.25%
5	力成科技 (Powertech)	台湾	7.0%	7.89%
6	通富微电	中国大陆	3.3%	3.92%
7	华天科技	中国大陆	3.9%	3.85%
8	联合科技 (UTAC)	新加坡	2.5%	2.81%
9	南茂科技 (ChipMOS)	台湾	2.2%	2.41%
10	欣邦科技 (Chipbond)	台湾	-	2.16%

### （二）发行人竞争优势



## 1、规模优势

能否提供足够的产能储备，是否拥有大规模、高品质供货的能力，是世界级公司选择长期合作伙伴的重要条件。为建立在国内封装测试行业的规模优势，公司大规模投资进行了产能的扩充和技术改造。

目前，公司拥有国际先进的净化厂房、大规模封装测试设备和一系列的失效分析系统及可靠性试验设备。多年的持续投入既带来公司技术的进步，也增加了产能，提升了规模，巩固了公司行业领先的地位。从 2000 年以来，公司集成电路和分立器件产销量一直保持高速增长。据统计，2015 年收购新加坡的新科金朋后，到 2016 年已成为全球集成电路封测外包行业第三大企业。在国内内资半导体封装测试企业中连续多年排名第一。公司在激烈的市场竞争中已取得明显的规模优势。

## 2、研发优势

凭借优秀的研发团队、持续的研发投入、国家的政策支持以及多年的生产积累，发行人取得了较多研究成果，并逐步形成自主创新能力，在行业内具备了与国外企业竞争的實力。研发优势是公司的重要核心竞争力之一。

### (1) 优秀的研发团队

发行人拥有实践经验丰富的研究团队。董事长周子学先生从业十多年，目前还担任国内最大的晶圆代工企业中芯国际董事长，对国内外半导体行业具有独到深刻的理解和判断，曾在工业和信息化领域有逾三十年的经济运行调节、管理工作经验。

名誉董事长王新潮先生任国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟理事长，高密度集成电路封装技术国家工程实验室理事长，中国半导体行业协会副理事长，江苏省半导体行业协会理事长，SEMI 全球委员会董事等

公司 CEO 兼首席技术长李春兴先生具有几十年半导体行业从业经验，长期从事生产、技术工作，曾历任全球第二大封测企业安靠研发中心负责人、全球采购负责人、高端封装事业群副总、集团副总、高级副总和首席技术长。

上述核心管理技术人员为发行人先后培育出了众多优秀的研发人员，公司核心技术人员稳定，研发成果显著。为加快公司本土人才的成长，提高技术引进和消化吸收的效率，公司还建立了自有本土人才向境外专家的“拜师制度”，举行“收徒仪式”，由境外专家对公司储备人才进行“传、帮、带”。截至目前，这种富有中国特色的制度安排显效明显。作为具有自主创新能力的高新技术企业，2018 年末公司员工构成中技术人员占总人数的 25.04%。

(2) 持续的研发投入。尤其在 2008 年下半年美国金融危机爆发以来，面对市场需求下降、资金紧张的不利情况，发行人仍持续加大研发创新，不断进行产品结构的调整，逐渐增加中高端产品的市场份额，同时瞄准前沿技术和先进技术，

并保存一定的技术储备，为未来获取更大的市场空间做好充分准备。

### (3) 建立国内首家“高密度集成电路封装技术国家工程实验室”

2009 年 6 月，公司联合中科院微电子研究所、清华大学微电子所、深圳先进技术研究院、深南电路有限公司共同组建了国内首家“高密度集成电路封装技术国家工程实验室”，意味着国家重点扶持的我国集成电路封装技术产学研相结合的工程实验平台正式启动。

实验室将为我国先进电子封装技术的产业化提供核心、共性技术支撑，提供企业所需要的产研核心技术、专利与人才培养，提高自主创新的核心竞争力，为我国封装产业的发展和产业升级提供引领和带动作用；实验室的目标是在若干先进封装核心技术和关键工艺方面取得突破，接近或达到世界先进水平。

实验室的组建方均在行业内具有较强的技术及研究实力，长电科技依托该实验室，通过与其他各方的合作，开发研究实力将进一步增强。

### 3、产品与技术创新优势

作为一家具有自主创新能力的高新技术企业，公司长期坚持以先进技术提升生产效率和产品品质，逐步在国内同行业中取得了明显的技术优势。公司 2008 年 10 月被认定为“高新技术企业”。随着封装技术的不断提高，公司已逐步摆脱了低端市场的无序竞争，进入良性发展轨道。

集成电路封装测试方面，发展重点转向 FBP/QFN、WLCSP、Bump、SiP、eWLB、FC 等高端市场，而在 DIP 类低端封装市场业务规模相应缩减。公司曾先后开发出了应用于快闪存储记忆体的集成电路 TSOP、TQFP 和应用于逻辑线路的 SSOP、HSIP、MSOP 等一批集成电路封装技术，自主研发出具有多项知识产权和技术创新的 FBP、SiP 等封装技术，并通过引进吸收和二次研发成功实现了圆片级芯片尺寸封装（WLCSP）技术的产业化，目前全球能够实现该技术产业化的封装测试企业主要有日月光、安靠、矽品以及长电科技四家公司，从而亦奠定了公司在国内封装领域的领先地位。近几年公司持续加强先进封装测试技术的领先优势，并通过实施各种先进研发项目来实现产品组合的多元化，例如，用于 5G /毫米波，网络，存储，高性能计算（HPC），MEMS /传感器和汽车应用等的项目包括采用超出 7nm 先进硅节点技术的高端倒装产品，先进的射频和功率产品，及高度集成的 3D SiP 模块开发。美国专利商标局（USPTO）迄今已授予超过 1,800 项专利。

分立器件方面，公司先后开发出了高反压三极管芯片、高频中小功率管芯片、肖特基二极管芯片、稳压二极管芯片、变容二极管芯片、可控硅、达林顿管等国家十五计划重点规划的产品，以及 SOT/SOD 等一系列超小型高附加值的二极管、三极管封装测试技术。同时，分立器件的片式化改造也使公司摆脱了恶性竞争的低端市场，进入良性发展的轨道。公司目前是国内内资企业中片式分立器件规模最大的厂商。

#### 4、质量控制优势

长电科技建立了严格的质量保证体系，具有较强的质量控制能力，先后通过国际知名厂商的认证，建立了长期合作关系。“树立为销售服务，让客户满意”的经营理念，取得了国内外知名客户的各类奖项和荣誉：

公司坚持“精益求精 一丝不苟”的企业精神，以“客户零投诉”为管理目标，公司积极开展全面质量管理（TQC）、合理化建议、全员 QC 攻关等活动，推行 5S、6σ 管理，先后通过了 ISO 9001:2000 质量管理体系认证，ISO14001:1996 环境管理体系认证、ISO 9002:1994/QS-9000:1998 质量体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证及 ISO/TS16949:2002 质量体系认证（汽车行业生产件、相关服务件质量体系认证）、TS16949 质量体系认证（汽车行业生产件、相关服务件质量体系认证）、QC080000 有害物质管理体系认证以及 SONY GP 绿色伙伴认证。公司近年来投入大量的资金进行技术改造，进口了大量的先进生产设备和可靠性测试设备，从原材料进厂到成品出厂，实行了严格的质量管理。

公司“长江”牌分立器件于 2000 年被评为江苏省重点名牌产品，在由中国商学会、中国质量学会联合举办的“2000 年中国市场商品质量调查活动中”被列为同行业十大品牌产品之一。2003 年获江苏省质量技术监督局“质量保证确认证书”，2004 年被江苏省工商行政管理局授予“免检企业”称号，被江苏省质量技术监督局授予“江苏省质量管理奖”，2005 年 2 月 28 日，中国电子质量管理协会授予公司“中国电子企业质量百强企业”称号，2012 年“长江”牌商标被江苏省工商行政管理局授予“江苏省著名商标（2011-2014）”，2018 年公司获国家质量监督检验检疫总局授予的“中国进出口质量安全示范企业”称号，2019 年 7 月“长江”牌商标获得国家知识产权局商标局授予的“中国驰名商标”。

#### 5、管理优势

长电科技目前拥有一支经验丰富的管理团队，对于半导体行业和市场具有深入的了解。公司名誉董事长王新潮先生是中国半导体行业协会集成电路专业分会及分立器件专业分会的副理事长，在发行人从事技术和管理工作已有近三十年的历史，具有了丰富的理论知识和实践经验，亲自主持了公司历年的技术改造、规划和项目的管理实施。

公司从台湾引进了行业内的资深专家担任技术总监和质量总监，专门从事公司的产品规划和技术开发、质量管理。公司其它高管人员大部分都在生产一线从事了近二十年技术和管理工作，有较为丰富的实践经验。公司注重运用现代企业管理方法，借助 ERP 系统实现科学管理。此外，公司现在的管理团队中有多人在创业初期即进入公司，对公司具有较高忠诚度。公司优秀的管理团队是公司在未来持续发展的关键。

#### 6、企业文化优势

公司始终坚持“吸收创新自我积累，不屈不挠敢于争先”的企业宗旨，以创造“心与芯的家园”作为公司的愿景，经过多年的文化积淀，形成了“争先、高效、团结、严谨、重才、守纪”的企业精神。人性化的管理、和睦家庭式企业文化氛围，影响和培养了一支热爱公司、严格高效、吃苦耐劳的员工队伍，使得公司在半导体行业中后来居上。在深厚的企业文化内涵和人性化经营理念熏陶下，员工自我成就和归宿感与日俱增，逐步实现了社会、企业、员工价值的和谐发展。

## 第六章 发行人主要财务状况

提示：投资者在阅读以下财务信息时，应当参阅读发行人完整的财务报表以及本募集说明书附录部分对于发行人财务指标的解释。

### 一、财务报表及审计意见

本募集说明书中的财务数据来源于发行人 2016-2018 度经审计的年度财务报表及 2019 年半年度未经审计报表。在阅读本募集说明书中财务报表的信息时，应当参阅读发行人上述的报表、注释以及本募集说明书中其他部分对于公司历史财务数据的注释。

发行人 2016-2018 合并及母公司财务报表已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了安永华明(2017)审字第 61121126\_B01 号、安永华明(2018)审字第 61121126\_B01 号和安永华明(2019)审字第 61121126\_B01 号标准无保留审计意见审计报告。

安永是首批获准在中国大陆开展业务的专业服务机构之一，1981 年安永即在北京设立中国代表处，拥有会计师事务所执业、H 股审计、证券、期货等相关资质证书。根据中国注册会计师协会发布的对全国会计师事务所的统计数据，安永拥有非常优良的质量纪录。

### 二、财务报表适用的会计制度及主要会计政策变更情况

发行人自 2007 年 1 月 1 日起执行国家财政部 2006 年新颁布的《企业会计准则》、相应的企业会计准则指南及有关补充规定。

2016-2018 年，发行人无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正及重大遗漏信息补充的情况。

近三年涉及重要会计政策和会计估计变更如下：

会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号，以下简称“新政府补助准则”），并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于会计准则的修订，公司需对原会计政策按上述文件规定进行相应变更。公司根据要求，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。</p> <p>公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。</p>	<p>公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。</p>	<p>本次会计政策变更对公司 2017 年 1-12 月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 28,744.63 万元，“营业外收入”科目减少 28,744.63 万元。</p>

会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年 4 月 28 日,财政部颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]13 号,以下简称“《企业会计准则第 42 号》”),并要求自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法。公司根据《企业会计准则第 42 号》要求,在利润表中增加“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目,分别列示持续经营损益和终止经营损益。	公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本议案无需提交股东大会审议。	本次会计政策变更对公司财务报表累积影响为:2017 年度利润表中“持续经营净利润”列示 73,539,801.08 元,2016 年度利润表中“持续经营净利润”列示 -316,133,515.50 元。
2017 年 12 月 25 日,财政部颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号,以下简称“《新修订的财务报表格式》”),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。公司根据《新修订的财务报表格式》要求,将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益变更为列报于“资产处置收益”,并相应追溯重述了比较报表。	公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本议案无需提交股东大会审议。	本次会计政策变更对公司财务报表累积影响为:2017 年度利润表中“资产处置收益”增加 51,510,622.04 元、“营业外收入”减少 53,092,681.87 元、“营业外支出”减少 1,582,059.83 元;比较数据相应进行追溯调整,调减 2016 年度“营业外收入”12,151,601.85 元、调减“营业外支出”779,279.14 元、调增“资产处置收益”11,372,322.71 元。
财务报表列报方式变更 根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)要求,资产负债表中,将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目,将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目,将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目,将“工程物资”归并至“在建工程”项目,将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目,将“应付利息”和“应付股利”归并至“其他应付款”项目,将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目;在利润表中,增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出,“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。		请见下表 6.1
与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更 根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,编制现金流量表时,将原作为筹资活动的现金流量,变更作为经营活动的现金流量。本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中筹资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额,但对现金和现金等价物净增加额无影响		不适用

图表 6.1-1: 2018 年重要会计政策变更影响科目情况

单位: 万元

科目	合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日		合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	9,132.31	0.00	13,744.91	0.00

科目	合并资产负债表 2018年12月31日		合并资产负债表 2017年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收账款	277,938.26	0.00	284,123.33	0.00
应收票据及应收账款	0.00	287,070.57	0.00	297,868.24
应付票据	65,009.76	0.00	50,785.34	0.00
应付账款	416,988.73	0.00	472,003.38	0.00
应付票据及应付账款	0.00	481,998.49	0.00	522,788.72
应付利息	6,843.96	0.00	18,757.19	0.00
其他应付款	29,411.56	36,255.52	23,029.22	41,786.41

图表6.1-2: 2018年重要会计政策变更影响科目情况

单位: 万元

科目	合并利润表 2018年1-12月		合并利润表 2017年1-12月	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	199,890.55	111,052.03	200,816.83	122,380.66
研发费用	0.00	88,838.52	0.00	78,436.17
利息费用	0.00	90,784.18	0.00	87,806.66
利息收入	0.00	3,513.47	0.00	2,230.96

### 三、财务报表合并范围及变动情况

(一) 截至2019年6月末, 发行人财务报表合并范围如下:

图表6.2: 截至2019年半年度财务报表合并范围

序号	子公司名称	注册资本	持股比例		表决权比例(%)	业务性质	级次
			直接(%)	间接(%)			
1	长电科技(宿迁)有限公司	25,000.00 万元	100.00	-	100.00	生产、销售	一级
2	长电科技(滁州)有限公司	30,000.00 万元	100.00	-	100.00	生产、销售	一级

序号	子公司名称	注册资本	持股比例		表决	业务性质	级次
3	江阴芯长电子材料有限公司	5,000.00 万元	100.00	-	100.00	销售	一级
4	苏州长电新科投资有限公司	754,340.00 万元	100.00	-	100.00	实业投资	一级
5	江阴新基电子设备有限公司	2,002.34 万元	74.78	-	74.78	生产、销售	一级
6	江阴长电先进封装有限公司	5,100.00 万美元	96.49	3.51	100.00	生产、销售	一级
7	江阴达仕新能源科技有限公司	10,000.00 万元	100.00	-	100.00	生产、销售	一级
8	江阴城东科林环境有限公司	300.00 万元	100.00	-	100.00	污水处理及其再生利用	一级
9	长电国际(香港)贸易投资有限公司	186,291.08 万港元	100.00	-	100.00	销售	一级
10	JCET Stats ChipPac Korea Limited	4,521,925.00 万韩元	-	100.00	100.00	生产、销售	二级
11	苏州长电新朋投资有限公司	976,223.00 万元	22.73	77.27	100.00	实业投资	二级
12	JCET-SC(Singapore) Pte. Ltd.	128,061.89 万美元	-	100.00	100.00	投资控股	三级
13	STATS ChipPAC Pte. Ltd.	322,067.61 万新加坡元	-	100.00	100.00	提供高端半导体产品的封装测试	四级
14	星科金朋半导体(江阴)有限公司	32,500.00 万美元	-	100.00	100.00	生产、销售	五级
15	STATS ChipPAC(Thailand) Limited.	12,500.00 万泰铢	-	100.00	100.00	生产、销售	五级
16	STATS ChipPAC, Inc.	51.00 美元	-	100.00	100.00	销售	五级
17	STATS ChipPAC Services(Thailand) Limited.	600.00 万泰铢	-	100.00	100.00	交易和投资	五级
18	星科金朋集成电路测试(江阴)有限公司	30,000.00 万元	-	100.00	100.00	生产、销售	六级
19	STATS ChipPAC (Barbados) Ltd.	24,533.21 万美元	-	100.00	100.00	投资控股	六级
20	ChipPAC International Company Limited	100.00 美元	-	100.00	100.00	投资控股	六级
21	STATS ChipPAC (BVI) Limited	14,999.99 万美元	-	100.00	100.00	销售	七级
22	STATS ChipPAC Shanghai Co., Ltd.	910.00 万美元	-	100.00	100.00	生产、销售	八级
23	STATS ChipPAC Korea Ltd.	13,311,174.00 万韩元	-	100.00	100.00	生产、销售	八级

(二) 合并财务报表范围变化的说明: 2017年8月, 公司新设成立全资子公司江阴城东科林环境有限公司, 注册资本为人民币3,000,000元。2018年12月, 公司出售持有的江阴新顺微电子有限公司75%股权、深圳长电科技有限公司80.67%



股权及江阴新申弘达半导体销售有限公司 100% 股权。故自 2018 年 12 月 24 日起，江阴新顺微电子有限公司、深圳长电科技有限公司及其子公司长电科技（香港）有限公司资产负债不再纳入公司合并范围。公司于 2018 年 3 月 6 日，以现金人民币 20,824,850.75 元向江阴达仕新能源科技有限公司其他股东收购了其持有的该公司 59.38% 股权。交易结束后，持有该公司 100% 股权。2018 年 3 月 14 日，子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司在江阴综合保税区注册设立全资子公司星科金朋集成电路测试（江阴）有限公司，注册资本 3 亿元人民币，主营业务为集成电路封装测试。

图表 6.3: 2016-2018 年及 2019 年半年度财务报表合并范围变动情况

项目	企业名称	持股比例	合并范围变更原因
<b>2016 年度</b>			
合并范围增加	-	-	-
合并范围减少	-	-	-
<b>2017 年度</b>			
合并范围增加	江阴城东科林环境有限公司	100%	新设立子公司
合并范围减少	-	-	-
<b>2018 年度</b>			
合并范围增加	江阴达仕新能源科技有限公司	100%	收购
	星科金朋集成电路测试（江阴）有限公司	100%	新设立子公司
合并范围减少	江阴新顺微电子有限公司	75%	出售
	深圳长电科技有限公司	80.67%	出售
<b>2019 年半年度</b>			
合并范围增加	-	-	-
合并范围减少	-	-	-

#### 四、发行人近三年及一期财务报表

##### 1、合并财务报表

图表 6.4: 发行人 2016-2018 年及 2019 年半年度合并资产负债表

单位：万元

项目	2019年6月末	2018年末	2017年末	2016年末
<b>流动资产:</b>				
货币资金	330,113.47	477,426.99	214,776.12	224,922.74
衍生金融资产	448.99	192.24	1,859.59	58.71
应收票据	12,460.93	9,132.31	13,744.91	17,592.70
应收账款	270,799.73	277,938.26	284,123.33	272,179.98
预付款项	17,901.64	19,736.23	15,863.65	17,026.47
其他应收款	6,192.57	15,161.31	33,204.50	26,516.74
存货	216,250.85	227,358.49	231,302.72	185,131.21
一年内到期的非流动资产	-	12,423.84	1,338.03	
其他流动资产	45,358.96	51,168.44	53,819.81	30,193.54
<b>流动资产合计</b>	<b>899,527.14</b>	<b>1,090,538.11</b>	<b>850,032.66</b>	<b>773,622.10</b>
<b>非流动资产:</b>				
可供出售金融资产		40,590.97	2,952.25	2,148.79
其他权益工具投资	3,187.22	-	-	-
其他非流动金融资产	37,527.71	-	-	-
长期应收款	4,296.93	4,713.00	16,236.41	16,209.47
长期股权投资	18,731.33	19,036.92	21,789.23	28,657.39
投资性房地产	11,543.67	11,752.67	6,581.18	6,766.40
固定资产	1,523,712.66	1,617,920.97	1,580,957.87	1,543,358.42
在建工程	431,593.49	345,386.12	267,382.46	264,808.87
无形资产	64,847.14	63,518.80	56,931.65	62,519.57
商誉	227,572.03	227,130.16	251,066.69	266,543.67
长期待摊费用	18.18	77.29	627.66	895.65
递延所得税资产	28,587.82	8,360.05	7,401.72	5,962.65
其他非流动资产	13,178.88	13,715.04	7,910.66	432.10
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,364,797.06</b>	<b>2,352,201.99</b>	<b>2,219,837.80</b>	<b>2,198,303.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,264,324.20</b>	<b>3,442,740.10</b>	<b>3,069,870.47</b>	<b>2,971,925.09</b>
<b>流动负债:</b>				
短期借款	1,106,666.02	712,869.99	342,474.49	373,279.70
衍生金融负债	13,910.75	13,793.51	10,481.83	44,025.00
应付票据	52,148.81	65,009.76	50,785.34	57,361.58
应付账款	369,325.94	416,988.73	472,003.38	377,483.27
预收款项	1,681.62	11,280.83	5,964.41	3,133.40
应付职工薪酬	30,927.08	45,330.15	44,442.76	37,976.08
应交税费	3,751.43	10,939.82	9,741.44	6,569.91
应付利息	4,153.57	6,843.96	18,757.19	7,063.49
其他应付款	22,140.90	29,411.56	23,029.22	24,104.73
一年内到期的非流动负债	91,300.73	528,019.42	332,179.16	203,699.62
<b>流动负债合计</b>	<b>1,696,006.85</b>	<b>1,840,487.72</b>	<b>1,309,859.22</b>	<b>1,138,259.45</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	221,567.28	293,379.00	372,117.62	402,670.25
应付债券	-	-	272,127.15	477,616.98
长期应付款	99,686.85	32,909.03	113,515.26	201,318.02
长期应付职工薪酬	180.03	81.59	295.11	398.62
预计负债	-	-	-	16,430.38
递延所得税负债	18,499.48	16,540.74	19,251.39	19,058.99

项目	2019年6月末	2018年末	2017年末	2016年末
递延收益-非流动负债	28,884.73	26,935.12	24,931.77	38,062.73
其他非流动负债	-	2,890.49	-	10,880.92
<b>非流动负债合计</b>	<b>368,818.37</b>	<b>372,735.97</b>	<b>802,238.31</b>	<b>1,166,436.89</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,064,825.21</b>	<b>2,213,223.69</b>	<b>2,112,097.53</b>	<b>2,304,696.34</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>				
实收资本(或股本)	160,287.46	160,287.46	135,984.40	103,591.48
资本公积金	1,024,249.84	1,024,249.84	689,122.52	241,369.24
其它综合收益	13,976.78	18,194.45	-4,421.67	23,466.78
盈余公积金	12,228.40	12,228.40	12,228.40	9,971.34
未分配利润	-11,627.60	14,262.25	111,593.40	81,069.65
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,199,114.87</b>	<b>1,229,222.40</b>	<b>944,507.04</b>	<b>459,468.48</b>
少数股东权益	384.12	294.01	13,265.90	207,760.27
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,199,498.99</b>	<b>1,229,516.41</b>	<b>957,772.94</b>	<b>667,228.76</b>

图表 6.5: 发行人 2016-2018 年及 2019 年半年度合并利润表

单位: 万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
<b>营业总收入</b>	<b>914,846.16</b>	<b>2,385,648.74</b>	<b>2,385,551.24</b>	<b>1,915,452.77</b>
营业收入	914,846.16	2,385,648.74	2,385,551.24	1,915,452.77
<b>营业总成本</b>	<b>979,536.18</b>	<b>2,513,890.21</b>	<b>2,436,948.59</b>	<b>1,978,365.16</b>
营业成本	829,739.98	2,113,075.83	2,106,101.27	1,689,061.57
税金及附加	1,744.36	4,592.18	5,347.24	3,151.85
销售费用	12,766.59	28,537.14	24,128.86	23,356.50
管理费用	54,896.17	111,052.03	200,816.83	159,510.47
研发费用	34,863.35	88,838.52	-	-
财务费用	43,362.24	113,102.51	98,285.02	96,429.98
其中: 利息费用	36,863.81	90,784.18	-	-
利息收入	1,244.36	3,513.47	-	-
资产减值损失	1,402.74	54,692.00	2,269.38	6,854.79
信用减值损失	760.76	-	-	-
加: 其他收益	18,499.10	15,484.71	28,744.63	-
投资净收益	-375.00	45,229.70	8,505.55	1,865.59
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-375.00	-69.53	-335.22	-275.19
公允价值变动净收益	-	-12,336.72	6,807.49	15,411.73
资产处置收益	673.46	-520.09	5,151.06	-
<b>营业利润</b>	<b>-45,892.47</b>	<b>-80,383.87</b>	<b>-2,188.62</b>	<b>-45,635.06</b>
加: 营业外收入	47.69	986.37	7,017.31	23,053.18
减: 营业外支出	370.79	1,902.06	2,431.69	2,515.20
<b>利润总额</b>	<b>-46,215.56</b>	<b>-81,299.56</b>	<b>2,397.00</b>	<b>-25,097.09</b>
减: 所得税	-20,415.81	11,364.49	-4,956.98	6,516.26
<b>净利润</b>	<b>-25,799.75</b>	<b>-92,664.05</b>	<b>7,353.98</b>	<b>-31,613.35</b>
减: 少数股东损益	90.11	1,267.48	-26,980.70	-42,246.79

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
归属于母公司所有者的净利润	-25,889.86	-93,931.53	34,334.68	10,633.44
加：其他综合收益	-4,217.68	22,629.72	-27,960.82	30,997.95
<b>综合收益总额</b>	<b>-30,017.42</b>	<b>-70,034.33</b>	<b>-20,606.84</b>	<b>-615.40</b>
减：归属于少数股东的综合收益总额	90.11	1,281.07	-27,053.07	-29,692.97
归属于母公司普通股股东综合收益总额	-30,107.53	-71,315.40	6,446.23	29,077.57

图 6.6: 发行人 2016-2018 年及 2019 半年度合并现金流量表

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	995,581.47	2,520,014.16	2,509,459.68	1,956,329.65
收到的税费返还	15,826.88	31,754.33	42,908.17	36,802.87
收到其他与经营活动有关的现金	20,747.17	22,623.10	16,411.47	6,779.14
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,032,155.53</b>	<b>2,574,391.59</b>	<b>2,568,779.32</b>	<b>1,999,911.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	717,599.08	1,808,940.44	1,701,238.11	1,243,752.35
支付给职工以及为职工支付的现金	178,789.32	381,987.58	362,996.26	350,356.64
支付的各项税费	23,783.78	44,155.28	24,201.00	22,487.04
支付其他与经营活动有关的现金	30,275.58	88,389.02	114,619.41	116,387.33
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>950,447.76</b>	<b>2,323,472.32</b>	<b>2,203,054.79</b>	<b>1,732,983.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>81,707.77</b>	<b>250,919.27</b>	<b>365,724.53</b>	<b>266,928.32</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	6,588.33	155,065.56	34,000.00	28,662.42
取得投资收益收到的现金	-	724.84	354.93	2,340.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,444.50	7,050.03	14,551.41	12,414.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	57,417.28	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,000.00	28,805.08	55,602.41	25,670.90
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,032.84</b>	<b>249,062.79</b>	<b>104,508.75</b>	<b>69,088.53</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,972.59	431,112.78	428,408.04	476,820.33
投资支付的现金	-	171,456.94	38,405.00	21,955.00
取得子公司及其他营业	-	2,078.80	-	-

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
单位支付的现金净额				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>152,972.59</b>	<b>604,648.52</b>	<b>466,813.04</b>	<b>498,775.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-142,939.75</b>	<b>-355,585.73</b>	<b>-362,304.29</b>	<b>-429,686.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	359,932.49	261,286.50	-
取得借款收到的现金	849,371.31	1,014,454.37	606,356.76	865,478.47
收到其他与筹资活动有关的现金	77,663.69	-	100,508.02	287,181.28
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>927,035.00</b>	<b>1,374,386.86</b>	<b>968,151.28</b>	<b>1,152,659.75</b>
偿还债务支付的现金	920,624.33	801,530.01	729,439.31	910,511.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,746.31	97,929.25	78,542.83	81,296.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	668.30	290.00	638.96
支付其他与筹资活动有关的现金	71,537.72	132,739.53	162,071.44	57,101.10
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,035,908.36</b>	<b>1,032,198.80</b>	<b>970,053.58</b>	<b>1,048,909.82</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-108,873.36</b>	<b>342,188.06</b>	<b>-1,902.30</b>	<b>103,749.93</b>
汇率变动对现金的影响	633.33	9,149.89	-5,381.02	7,113.00
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-169,472.00</b>	<b>246,671.48</b>	<b>-3,863.07</b>	<b>-51,895.55</b>
期初现金及现金等价物余额	420,634.75	173,963.27	177,826.34	229,721.90
期末现金及现金等价物余额	251,162.75	420,634.75	173,963.27	177,826.34

## 2、母公司财务报表

图表 6.7：发行人 2016-2018 年及 2019 年半年度母公司资产负债表

单位：万元

项目	2019 年 6 月末	2018 年末	2017 年末	2016 年末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	188,283.40	186,014.39	88,735.91	70,708.94
衍生金融资产	-	-	-	54.00
应收票据	11,719.93	7,794.40	5,228.74	11,368.88
应收账款	97,646.16	72,249.07	69,031.10	69,902.40
预付款项	6,691.89	6,486.77	4,893.57	6,160.96
应收股利	-	-	-	968.00
其他应收款	163,624.55	173,908.79	91,809.29	67,454.95
存货	98,018.48	109,983.77	104,485.13	85,926.15
一年内到期的非流动资产	-	12,423.84	-	-
其他流动资产	10,887.53	16,342.68	19,273.33	28,050.88
<b>流动资产合计</b>	<b>576,871.93</b>	<b>585,203.71</b>	<b>383,457.08</b>	<b>340,595.16</b>
<b>非流动资产：</b>				

项目	2019年6月末	2018年末	2017年末	2016年末
可供出售金融资产	-	2,407.20	2,217.20	1,362.20
其他权益工具投资	2,407.20	-	-	-
长期应收款	-	-	11,577.38	10,840.85
长期股权投资	929,646.25	780,491.20	883,503.07	470,482.88
投资性房地产	11,543.67	11,752.67	6,581.18	6,766.40
固定资产	-	-	331,680.09	277,581.30
在建工程	-	-	117,858.03	77,801.44
无形资产	21,789.00	21,371.87	18,229.26	17,297.83
长期待摊费用	0.93	22.42	148.33	189.95
递延所得税资产	3,667.51	3,464.81	3,219.91	3,320.22
其他非流动资产	12,978.87	12,978.87	7,292.88	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,495,828.18</b>	<b>1,347,859.92</b>	<b>1,382,307.32</b>	<b>865,643.08</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,072,700.11</b>	<b>1,933,063.63</b>	<b>1,765,764.40</b>	<b>1,206,238.24</b>
<b>流动负债:</b>				
短期借款	433,524.82	301,217.92	156,314.20	208,106.99
交易性金融负债	11,003.60	11,003.60	11,003.60	14,571.95
应付票据	171,509.00	-	56,016.00	66,764.50
应付账款	130,411.73	-	116,634.21	94,787.31
预收款项	813.41	5,959.65	18,268.01	19,310.66
应付职工薪酬	5,483.16	12,296.81	11,260.80	8,075.83
应交税费	647.01	6,455.58	1,758.46	748.90
应付利息	837.84	580.69	616.23	445.91
其他应付款	-	-	96,493.31	61,111.74
一年内到期的非流动负债	48,878.88	127,839.46	122,476.22	135,226.76
<b>流动负债合计</b>	<b>819,504.48</b>	<b>708,932.42</b>	<b>590,841.03</b>	<b>609,150.56</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	126,336.84	92,933.69	135,618.99	43,098.15
长期应付款	-	-	74,805.64	124,341.39
长期应付职工薪酬	40.08	73.83	203.73	294.42
递延收益-非流动负债	14,045.98	15,328.47	14,833.32	21,228.48
<b>非流动负债合计</b>	<b>140,422.89</b>	<b>112,991.94</b>	<b>225,461.68</b>	<b>188,962.45</b>
<b>负债合计</b>	<b>959,927.37</b>	<b>821,924.36</b>	<b>816,302.72</b>	<b>798,113.01</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>				
实收资本(或股本)	160,287.46	160,287.46	135,984.40	103,591.48
资本公积金	1,083,688.90	1,083,688.90	748,610.18	260,683.31
盈余公积金	12,228.40	12,228.40	12,228.40	9,971.34
未分配利润	-143,432.01	-145,065.48	52,638.70	33,879.09
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,112,772.74</b>	<b>1,111,139.27</b>	<b>949,461.68</b>	<b>408,125.23</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,112,772.74</b>	<b>1,111,139.27</b>	<b>949,461.68</b>	<b>408,125.23</b>

图表 6.8: 发行人 2016-2018 年及 2019 年半年度母公司利润表

单位: 万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>营业总收入</b>	<b>373,683.04</b>	<b>769,017.53</b>	<b>700,669.31</b>	<b>616,464.50</b>
营业收入	373,683.04	769,017.53	700,669.31	616,464.50
<b>营业总成本</b>	<b>376,279.80</b>	<b>1,112,133.40</b>	<b>715,197.90</b>	<b>621,323.01</b>
营业成本	316,844.99	673,865.36	610,971.89	527,494.15
税金及附加	759.48	1,659.13	2,389.83	985.90
销售费用	3,770.08	9,043.87	8,344.93	8,620.79
管理费用	17,545.18	40,345.00	65,179.33	53,961.92
研发费用	17,742.72	31,389.42	-	-
财务费用	18,266.01	28,404.92	28,410.11	30,030.83
其中：利息费用	14,994.47	27,025.18	-	-
利息收入	829.64	2,835.57	-	-
资产减值损失	275.79	327,425.71	-98.19	229.41
信用减值损失	1,075.54	-	-	-
加：其他收益	2,236.97	4,128.26	12,440.45	-
投资净收益	132.05	149,436.32	20,288.15	2,741.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	254.43	315.30	549.56
公允价值变动净收益	-	-	-	36.22
资产处置收益	50.22	-36.72	11.52	-
<b>营业利润</b>	<b>-177.52</b>	<b>-189,588.01</b>	<b>18,211.53</b>	<b>-2,081.28</b>
加：营业外收入	1.09	21.55	6,338.57	13,027.20
减：营业外支出	216.03	211.13	71.60	239.35
<b>利润总额</b>	<b>-392.45</b>	<b>-189,777.59</b>	<b>24,478.51</b>	<b>10,706.57</b>
减：所得税	-2,025.93	4,526.98	1,907.97	-818.36
<b>净利润</b>	<b>1,633.47</b>	<b>-194,304.57</b>	<b>22,570.54</b>	<b>11,524.93</b>
持续经营净利润	1,633.47	-194,304.57	22,570.54	-
归属于母公司所有者的净利润	1,633.47	-194,304.57	22,570.54	11,524.93
<b>综合收益总额</b>	<b>1,633.47</b>	<b>-194,304.57</b>	<b>22,570.54</b>	<b>11,524.93</b>
归属于母公司普通股股东综合收益总额	1,633.47	-194,304.57	22,570.54	11,524.93

图 6.9：发行人 2016-2018 年及 2019 年半年度母公司现金流量表

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	364,634.07	814,550.02	764,118.32	656,057.16
收到的税费返还	9,861.75	25,708.15	23,796.21	19,566.10
收到其他与经营活动有关	1,485.05	7,743.31	3,311.57	3,248.67

项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
的现金				
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>375,980.87</b>	<b>848,001.48</b>	<b>791,226.10</b>	<b>678,871.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	300,810.36	711,633.11	577,100.23	485,345.56
支付给职工以及为职工支付的现金	42,633.93	86,804.72	70,689.42	61,043.16
支付的各项税费	7,740.89	2,153.92	2,606.99	2,180.30
支付其他与经营活动有关的现金	16,834.63	38,090.91	25,561.66	33,884.12
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>368,019.81</b>	<b>838,682.66</b>	<b>675,958.30</b>	<b>582,453.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,961.05</b>	<b>9,318.82</b>	<b>115,267.80</b>	<b>96,418.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金	6,588.33	203,895.00	26,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	82,407.60	12,455.02	1,423.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.80	1,370.75	780.10	1,040.06
收到其他与投资活动有关的现金	-	10,500.00	71,677.66	79,279.91
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,597.13</b>	<b>298,173.35</b>	<b>110,912.77</b>	<b>81,743.33</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,712.95	173,184.15	152,323.90	114,194.92
投资支付的现金	149,023.00	366,321.49	231,191.85	107,520.65
支付其他与投资活动有关的现金	29,155.00	48,939.88	39,348.83	49,793.31
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>221,890.95</b>	<b>588,445.51</b>	<b>422,864.59</b>	<b>271,508.88</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-215,293.81</b>	<b>-290,272.16</b>	<b>-311,951.81</b>	<b>-189,765.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资收到的现金	-	359,932.49	261,286.50	-
取得借款收到的现金	373,599.00	456,900.00	357,511.03	290,527.12
收到其他与筹资活动有关的现金	145,509.23	-	63,502.68	216,719.13
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>519,108.23</b>	<b>816,832.49</b>	<b>682,300.21</b>	<b>507,246.25</b>
偿还债务支付的现金	244,043.89	329,995.68	347,390.48	406,695.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,494.23	21,822.63	19,754.10	27,309.71
支付其他与筹资活动有关的现金	71,537.72	105,318.93	100,297.99	30,151.98
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>333,075.83</b>	<b>457,137.23</b>	<b>467,442.57</b>	<b>464,157.40</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>186,032.40</b>	<b>359,695.26</b>	<b>214,857.64</b>	<b>43,088.84</b>
汇率变动对现金的影响	627.08	1,252.57	-1,040.79	456.66
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-20,673.28</b>	<b>79,994.48</b>	<b>17,132.84</b>	<b>-49,801.26</b>
期初现金及现金等价物余额	130,204.74	50,210.26	33,077.42	82,878.68
期末现金及现金等价物余额	109,531.46	130,204.74	50,210.26	33,077.42



项目	2019 年 1-6 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
额				

## 五、主要财务数据及指标分析

### (一) 资产结构分析

图表 6.10: 2016-2018 年及 2019 年半年度资产结构数据表

单位: 万元, %

项目	2016 年末		2017 年末		2018 年末		2019 年 6 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	773,622.10	26.03	850,032.66	27.69	1,090,538.11	31.68	899,527.14	27.56
非流动资产	2,198,303.00	73.97	2,219,837.80	72.31	2,352,201.99	68.32	2,364,797.06	72.44
资产总计	<b>2,971,925.09</b>	<b>100.00</b>	<b>3,069,870.47</b>	<b>100.00</b>	<b>3,442,740.10</b>	<b>100.00</b>	<b>3,264,324.20</b>	<b>100.00</b>

近三年及一期, 发行人资产总额分别为 2,971,925.09 万元、3,069,870.47 万元、3,442,740.10 万元和 3,264,324.20 万元, 随着发行人经营规模的不断扩大, 近三年发行人资产总额保持稳定增长, 年均复合增长率达 7.7%, 其中 2018 年末较 2017 年末增长 12.15%, 主要是流动资产中的货币资金增加所致, 具体为发行人 2018 年定增给国家集成电路产业基金和中芯国际带来了较多的募集资金; 2017 年末较 2016 年末增长 3.3%, 主要系流动资产中的应收账款增加增加所致, 近三年末公司非流动资产金额均呈上升趋势, 流动资产在 2019 年 6 月末大幅下降主要系募集货币资金使用较多。

从资产结构来看, 发行人流动资产占比较少, 但 2016-2018 年呈整体上升趋势, 流动资产占总资产的比例从 26.03% 上升至 31.68%, 主要系募集货币资金增加, 非流动资产占总资产的比例从 73.97% 下降至 68.32%。

#### 1、流动资产结构分析

图表 6.11: 2016-2018 年及 2019 年半年度流动资产结构表

单位: 万元, %

项目	2016 年末		2017 年末		2018 年末		2019 年 6 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	224,922.74	7.57	214,776.12	7.00	477,426.99	13.87	330,113.47	10.11

项目	2016 年末		2017 年末		2018 年末		2019 年 6 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应收票据	17,592.70	0.59	13,744.91	0.45	9,132.31	0.27	12,460.93	0.38
应收账款	272,179.98	9.16	284,123.33	9.26	277,938.26	8.07	270,799.73	8.30
预付款项	17,026.47	0.57	15,863.65	0.52	19,736.23	0.57	17,901.64	0.55
其他应收款	26,516.74	0.89	33,204.50	1.08	15,161.31	0.44	6,192.57	0.19
存货	185,131.21	6.23	231,302.72	7.53	227,358.49	6.60	216,250.85	6.62
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	1,338.03	0.04	12,423.84	0.36	0.00	0.00
其他流动资产	30,193.54	1.02	53,819.81	1.75	51,168.44	1.49	45,358.96	1.39
<b>流动资产合计</b>	<b>773,622.10</b>	<b>26.03</b>	<b>850,032.66</b>	<b>27.69</b>	<b>1,090,538.11</b>	<b>31.68</b>	<b>899,527.14</b>	<b>27.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,971,925.09</b>	<b>100.00</b>	<b>3,069,870.47</b>	<b>100.00</b>	<b>3,442,740.10</b>	<b>100.00</b>	<b>3,264,324.20</b>	<b>100.00</b>

2016-2018 年及 2019 年 6 月末, 发行人流动资产总额分别为 773,622.10 万元、850,032.66 万元、1,090,538.11 万元和 899,527.14 万元, 近三年呈稳定增长趋势。流动资产主要由货币资金、应收账款和存货等构成。截至 2019 年 6 月末, 上述科目分别为 330,113.47 万元、270,799.73 万元和 216,250.85 万元, 占总资产比例分别为 10.11%、8.30%和 6.62%, 上述科目合计占流动资产合计比例为 90.84 %。流动资产的具体构成如下:

#### (1) 货币资金

2016-2018 年及 2019 年 6 月末, 发行人货币资金分别为 224,922.74 万元、214,776.12 万元、477,426.99 万元和 330,113.47 万元, 2018 年货币资金大幅增加主要系向国家大基金、芯电半导体和金投领航定增募集资金共 36.19 亿元。2019 年 6 月末货币资金较 2018 年年末大幅减少 14.73 亿元主要系长电于 2019 年 1 月提前赎回星科金朋 4.25 亿美元优先票据。

图表 6.12: 近三年及一期货币资金构成表

单位: 万元, %

项目	2016 年末		2017 年末		2018 年末		2019 年 6 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
现金	35.28	0.02	31.39	0.01	35.54	0.00	34.99	0.01%
银行存款	177,791.06	79.05	173,931.88	80.98	420,599.22	88.10	251,127.76	76.07%

项目	2016 年末		2017 年末		2018 年末		2019 年 6 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他货币资金	47,096.40	20.94	40,812.75	19.00	56,792.24	11.90	78,950.72	23.92%
合计	<b>224,922.74</b>	<b>100.00</b>	<b>214,776.12</b>	<b>100.00</b>	<b>477,426.99</b>	<b>100.00</b>	<b>330,113.47</b>	<b>100.00%</b>

截至 2019 年 6 月末，货币资金中主要为银行承兑票据保证金、银行借款保证金及信用证保证金，回收风险较小。

#### (2) 衍生金融资产

2016-2018 年及 2019 年 6 月末，发行人衍生金融资产余额分别为 58.71 万元、1,859.59 万元、192.24 万元和 448.99 万元，均为发行人子公司星科金朋发生的远期结售汇交易。基于星科金朋签订的远期合约，因为预测套期保值具有很高的可能性，因此将其作为现金流量套期保值进行会计记录，并将此衍生工具指定为有效套期工具以其公允价值进行列示。2018 年末衍生金融资产余额较年初大幅下降 89.66%，主要系星科金朋发生的远期结售汇交易变动所致。

#### (3) 应收票据

2016-2018 年及 2019 年 6 月末，发行人应收票据余额分别为 17,592.70 万元、13,744.91 万元、9,132.31 万元和 12,460.93 万元，主要系发行人收到的银行承兑汇票。由于票据到期结算减少，该科目余额总体表现为下降。

#### (4) 应收账款

2016-2018 年及 2019 年 6 月末，发行人应收账款余额分别为 272,179.98 万元、284,123.33 万元、277,938.26 万元和 270,799.73 万元，2017 年的应收账款余额呈现增长的态势，主要系发行人生产规模扩大产生的相应自然增加，且由于市场资金流动性趋紧，发行人客户回款速度相对较慢。2019 年 6 月末应收账款较年初有所下降，主要系公司上半年受到行业景气度影响营收同比下滑 19.06%，应收账款也随之同步下滑。

发行人的应收账款账龄以一年以内为主。截至 2019 年 6 月末，一年以内的应收账款为 128,784.64 万元，发行人对应收账款计提坏账准备共计 6,439.23 万元。

图表 6.13: 截至 2019 年 6 月末应收账款的账龄结构

单位：万元、%

名称	2019 年 6 月末		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	128,784.64	6,439.23	5.00
1 至 2 年	1,148.64	114.86	10.00

名称	2019 年 6 月末		
	应收账款	坏账准备	计提比例
2 至 3 年	275.92	55.18	20.00
3 至 5 年	83.24	41.62	50.00
5 年以上	1,430.38	1,430.38	100.00
合计	<b>131,722.82</b>	<b>8,081.28</b>	<b>6.14</b>

发行人应收账款主要为销售商品的货款，产品主要应用于通讯类产品、资讯类产品、电器类产品、工业自动化系统等，下游客户相对分散。截至 2019 年 6 月末，发行人按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 7.40 亿元，占应收账款期末余额合计数的比例为 27.32%。

图表 6.14: 2019 年 6 月末应收账款前 5 名客户明细

单位：万元、%

序号	客户名称	金额	账龄	占应收账款的比例
1	客户 A	22,033.27	一年以内	8.14
2	客户 B	16,825.32	一年以内	6.21
3	客户 C	12,697.82	一年以内	4.69
4	客户 D	11,437.49	一年以内	4.22
5	客户 E	10,999.59	一年以内	4.06
合计		<b>73,993.498</b>	-	<b>27.32</b>

#### (5) 预付款项

2016-2018 年及 2019 年 6 月末，发行人预付款项余额分别 17,026.47 万元、15,863.65 万元、19,736.23 万元和 17,901.64 万元。2017 年较 2016 年减少 6.83%，2018 年预付账款较 2017 年增加较多，主要原因是预付原材料和设备款项的增加所致。2019 年 6 月末预付账款较年初减少 9.30%，主要是减少了一年以内的设备预付款。

发行人预付账款账龄集中在一年以内，近三年及一期的预付账款中账龄在一年以内的账款比例约 99%，主要明细如下：

图表 6.15: 近三年及一期发行人预付账款账龄结构

单位：万元、%

账龄	2016 年末		2017 年末		2018 年末		2019 年 6 月末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

账龄	2016 年末		2017 年末		2018 年末		2019 年 6 月末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,884.02	99.16	15,710.91	99.04	19,578.34	99.20	17,737.11	99.08
1 至 2 年	108.78	0.64	151.89	0.96	145.54	0.74	151.78	0.85
2 至 3 年	29.15	0.17	0.00	0.00	12.33	0.06	12.72	0.07
3 年以上	4.52	0.03	0.85	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00
合计	<b>17,026.47</b>	<b>100.00</b>	<b>15,863.65</b>	<b>100.00</b>	<b>19,736.23</b>	<b>100.00</b>	<b>17,901.64</b>	<b>100.00</b>

#### (6) 其他应收款

2016-2018 年及 2019 年 6 月末,发行人其他应收款余额分别 26,516.74 万元、33,204.50 万元、15,161.31 万元和 6,192.57 万元。其他应收款占总资产的规模较小,最高的为 2017 年年末,占比为 1.08%,其余均小于 1%。2018 年其他应收款较上年下降 54.34%,主要由于收到部分上海厂搬迁补偿款及新增按合同约定未到期的剥离分立器件自销业务相关资产转让款。

发行人的大部分其他应收款账龄在一年以内。发行人在 2019 年 6 月末已按规定按不同比例提取坏账准备合计 217.34 万元。

图表 6.16: 近三年及一期发行人其他应收款账龄结构

单位: 万元

分类	2016 年末	2017 年末	2018 年末	2019 年 6 月末
1 年以内	26,526.53	33,170.53	15,301.98	6,233.60
1-2 年	22.75	34.65	276.94	152.04
2-3 年	19.46	19.45	12.93	12.98
3-5 年	0.00	18.46	11.02	11.30
其他应收款账面价值合计	<b>26,568.74</b>	<b>33,243.09</b>	<b>15,602.87</b>	<b>6,409.91</b>
减: 其他应收款坏账准备	52.00	38.59	441.56	217.34
其他应收款净额	<b>26,516.74</b>	<b>33,204.50</b>	<b>15,161.31</b>	<b>6,192.57</b>

#### (7) 存货

发行人的存货主要是原材料、自制半成品及在产品、产成品(库存商品)和低值易耗品。2016-2018 年及 2019 年 6 月末,发行人存货余额分别为 185,131.21 万元、231,302.72 万元、227,358.49 万元和 216,250.85 万元。2017-2018 年行业景气度回升,发行人产销两旺,发行人加备原材料以满足生产经营需求。

图表 6.17: 发行人近三年及一期存货明细表

单位: 万元

项目	2016 年末	2017 年末	2018 年末	2019 年 6 月末
原材料	78,865.64	118,469.52	129,608.05	132,148.91
自制半成品及在产品	66,854.54	65,000.29	46,071.14	49,232.23
库存商品	36,726.16	48,143.37	56,781.12	40,894.99
低值易耗品	6,006.53	4,209.02	4,483.73	3,703.48
账面余额总计	<b>188,452.86</b>	<b>235,822.21</b>	<b>236,944.04</b>	<b>225,979.60</b>
减: 跌价准备	<b>3,321.65</b>	<b>4,519.49</b>	<b>9,585.55</b>	<b>9,728.75</b>
账面价值合计	<b>185,131.21</b>	<b>231,302.72</b>	<b>227,358.49</b>	<b>216,250.85</b>

## (8) 一年内到期的非流动资产

2016-2018 年及 2019 年 6 月末, 发行人一年内到期的非流动资产余额分别为 0.00 万元、1,338.03 万元、12,423.84 万元和 0.00 万元。2018 年末的一年内到期的非流动资产较年初大幅增长 828.52%, 主要系一年内到期的融资租赁保证金增加。

## (9) 其他流动资产

2016-2018 年及 2019 年 6 月末, 发行人其他流动资产余额分别 30,193.54 万元、53,819.81 万元、51,168.44 万元和 45,358.96 万元。2017 年其他流动资产较 2016 年末增加 78.25%, 主要系公司购买 1.75 亿的银行理财产品。2018 年末较 2017 年末基本持平, 2019 年 6 月末其他流动资产较年初减少 11.35%, 主要系留抵增值税的变动和理财产品到期所致。

## 2、非流动资产分析

图表 6.18: 2016-2018 年及 2019 年 6 月末非流动资产构成数据表

单位: 万元、%

项目	2016 年末		2017 年末		2018 年末		2019 年 6 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	2,148.79	0.07	2,952.25	0.10	40,590.97	1.18	0.00	0.00
其他权益工具投资	-	-	-	-	-	-	3,187.22	0.10
其他非流动金融资产	-	-	-	-	-	-	37,527.71	1.15
长期应收款	16,209.47	0.55	16,236.41	0.53	4,713.00	0.14	4,296.93	0.13
长期股权投资	28,657.39	0.96	21,789.23	0.71	19,036.92	0.55	18,731.33	0.57
投资性房地产	6,766.40	0.23	6,581.18	0.21	11,752.67	0.34	11,543.67	0.35

项目	2016 年末		2017 年末		2018 年末		2019 年 6 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	1,543,358.42	51.93	1,580,957.86	51.50	1,617,920.97	47.00	1,523,712.66	46.68
在建工程	264,808.87	8.91	267,382.46	8.71	345,386.12	10.03	431,593.49	13.22
无形资产	62,519.57	2.10	56,931.65	1.85	63,518.80	1.85	64,847.14	1.99
商誉	266,543.67	8.97	251,066.69	8.18	227,130.16	6.60	227,572.03	6.97
长期待摊费用	895.65	0.03	627.66	0.02	77.29	0.00	18.18	0.00
递延所得税资产	5,962.65	0.20	7,401.72	0.24	8,360.05	0.24	28,587.82	0.88
其他非流动资产	432.1	0.01	7,910.66	0.26	13,715.04	0.40	13,178.88	0.40
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,198,303.00</b>	<b>73.97</b>	<b>2,219,837.80</b>	<b>72.31</b>	<b>2,352,201.99</b>	<b>68.32</b>	<b>2,364,797.06</b>	<b>72.44</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,971,925.09</b>	<b>100.00</b>	<b>3,069,870.47</b>	<b>100.00</b>	<b>3,442,740.10</b>	<b>100.00</b>	<b>3,264,324.20</b>	<b>100.00</b>

2016-2018 年及 2019 年 6 月末，发行人非流动资产分别 2,198,303.00 万元、2,219,837.80 万元、2,352,201.99 万元和 2,364,797.06 万元，呈稳步增长的态势，主要是国内外市场需求持续回升，发行人持续改进生产线，加大固定资产投入所致。2015 年，随着收购星科金朋，发行人非流动资产的规模进一步增大，占总资产的比重也随之上升。从非流动资产结构来看，发行人非流动资产的主要形式是固定资产，2019 年 6 月末占发行人非流动资产的 64.43%。

#### (1) 可供出售金融资产

2016-2018 年及 2019 年 6 月末，发行人可供出售金融资产余额分别为 2,148.79 万元、2,952.25 万元、40,590.97 万元和 0.00 万元。2018 年可供出售金融资产较 2017 年大幅增加，同比上涨 1,274.92%，主要系增加江阴芯智联电子科技有限公司和芯鑫融资租赁有限责任公司的投资。

#### (2) 长期应收款

2016-2018 年及 2019 年 6 月末，发行人长期应收款余额分别为 16,209.47 万元、16,236.41 万元、4,713.00 万元和 4,296.93 万元，2017 年与 2016 年基本持平。2018 年较 2017 年下降 70.97%，主要系一年以上到期的融资租赁保证金减少。2019 年 6 月末长期应收款较年初保持稳定。

#### (3) 长期股权投资

2016-2018 年及 2019 年 6 月末，发行人长期股权投资余额分别为 28,657.39 万元、21,789.23 万元、19,036.92 万元和 18,731.33 万元。2017 年较 2016 年下滑 23.97%，主要系减少了国富瑞数据系统有限公司的投资。2018 年较 2017 年下滑 12.63%，主要系主要系报告期内购买联营企业达仕新能源股权使其成为公司全资子公司。

图表 6.19: 2019 年 6 月末长期股权投资明细情况

被投资单位名称	持股比例	账面金额	核算方法
---------	------	------	------

被投资单位名称	持股比例	账面金额	核算方法
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	8.53%	1,647.68	权益法
SJ SEMICONDUCTOR CORPORATION	19.06%	17,083.65	权益法
<b>合计</b>		<b>18,731.33</b>	-

#### (4) 投资性房地产

2016-2018 年及 2019 年 6 月末，发行人投资性房地产余额分别为 6,766.40 万元、6,581.18 万元、11,752.67 万元和 11,543.67 万元。2018 年较 2017 年同比增加 78.58%，主要系发行人出租房屋建筑物增加。

#### (5) 固定资产

2016-2018 年及 2019 年 6 月末，发行人固定资产余额分别为 1,543,358.42 万元、1,580,957.87 万元、1,617,920.97 万元和 1,523,712.66 万元。2017 年末较 2016 年末增加 37,599.44 万元，增幅为 2.44%；2018 年末较 2017 年相比，无重大变化；2019 年 6 月末较年初小幅下降。近三年及一期发行人固定资产分类明细如下：

图表 6.20：近三年及一期发行人固定资产明细情况

单位：万元、%

项目	2016 年度		2017 年度		2018 年度		2019 年 6 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋及建筑物	377,638.17	24.47	428,598.46	27.11	475,428.54	29.39	464,099.33	30.46
机器设备	1,122,519.92	72.73	1,107,509.76	70.05	1,097,034.03	67.81	1,019,288.00	66.90
电子设备	4,911.55	0.32	6,090.62	0.39	6,421.62	0.40	6,740.62	0.44
运输工具	1,075.94	0.07	853.38	0.05	470.76	0.03	711.29	0.04
其他设备	37,212.84	2.41	37,905.65	2.40	38,566.03	2.38	32,873.43	2.16
<b>合计</b>	<b>1,543,358.42</b>	<b>100.00</b>	<b>1,580,957.87</b>	<b>100.00</b>	<b>1,617,920.97</b>	<b>100.00</b>	<b>1,523,712.66</b>	<b>100.00</b>

#### (6) 在建工程

2016-2018 年及 2019 年 6 月末，发行人在建工程余额分别为 264,808.87 万元、267,382.46 万元、345,386.12 万元和 431,593.49 万元。2017 年较 2016 年变化较小。2018 年末在建工程较 2017 年末增加 78,003.66 万元，增幅为 29.17%，其中主要新增为长电滁州超小型分立器件等生产线技改扩能、长电(宿迁)扩充集成电路封测产能、通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目和高阶 SIP 产品封装测试等项目。2019 年 6 月末在建工程较 2018 年新增 86,207.37 万元，主要是年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目以及对 4G 高端射频模块



集成电路和产线技改扩能等重点产能扩充项目的新增投资所致。

#### (7) 无形资产

发行人的无形资产包括土地使用权、技术使用费、计算机软件、专有技术和专利技术。2016-2018 年及 2019 年 6 月末, 发行人无形资产余额分别为 62,519.57 万元、56,931.65 万元、63,518.80 万元和 64,847.14 万元。2017 年无形资产较 2016 年下降 8.94%, 主要系专利技术的减值。2018 年较 2017 年增加 6,587.15 万元, 增幅为 11.57%, 主要为新购置的土地使用权和计算机软件等。

#### (8) 商誉

2016-2018 年及 2019 年 6 月末, 发行人商誉余额分别为 266,543.67 万元、251,066.69 万元、227,130.16 万元和 227,572.03 万元。近三年来的商誉价值变动主要系收购合并星科金朋所致。2018 年较 2017 年商誉下降 9.53%, 下降幅度较大主要系 2018 年星科金朋持续出现大幅亏损故计提 3.66 亿元。

#### (9) 长期待摊费用

发行人的长期待摊费用是指已经支出, 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上 (不含 1 年) 的各项费用, 该费用在受益期内平均摊销。2016-2018 年及 2019 年 6 月末, 发行人长期待摊费用余额分别为 895.65 万元、627.66 万元、77.29 万元和 18.18 万元。发行人长期待摊费用随着 2012 年对厂房设备的更新投入增大, 相应的生产用模具、设备改造和厂区改造等逐渐增加。2018 年及 2019 年 6 月末, 长期待摊费用大幅减少, 主要系进行重分类调整, 部分调入固定资产, 费用摊销余额减少。

#### (10) 其他非流动资产

2016-2018 年及 2019 年 6 月末, 发行人其他非流动资产余额分别为 432.10 万元、7,910.66 万元、13,715.04 万元和 13,178.88 万元。2018 年末其他非流动资产较年初增加 73.37%, 主要系新增按合同约定未到期的剥离分立器件自销业务相关资产分红款。

### (二) 负债结构分析

图表 6.21: 发行人 2016-2018 年及 2019 年 6 月末负债结构表

单位: 万元, %

项目	2016年末		2017年末		2018年末		2019年6月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	1,138,259.45	49.39	1,309,859.22	62.02	1,840,487.72	83.16	1,696,006.85	82.14

项目	2016年末		2017年末		2018年末		2019年6月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
非流动负债合计	1,166,436.89	50.61	802,238.31	37.98	372,735.97	16.84	368,818.37	17.86
<b>总负债</b>	<b>2,304,696.34</b>	<b>100.00</b>	<b>2,112,097.53</b>	<b>100.00</b>	<b>2,213,223.69</b>	<b>100.00</b>	<b>2,064,825.21</b>	<b>100.00</b>

2016-2018 年末及 2019 年第 6 月末，公司总负债分别为 2,304,696.34 万元、2,112,097.53 万元、2,213,223.69 万元和 2,064,825.21 万元，总负债近三年基本保持稳定，其中流动负债占比逐年增加，非流动负债在总负债中的占比逐年减少。

### 1、流动负债结构分析

图表 6.22: 发行人 2016-2018 年及 2019 年 6 月末流动负债结构表

单位: 万元、%

项目	2016年末		2017年末		2018年末		2019年6月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	373,279.70	16.20	342,474.49	16.21	712,869.99	32.21	1,106,666.02	53.60
衍生金融负债	44,025.00	1.91	10,481.83	0.50	13,793.51	0.62	13,910.75	0.67
应付票据	57,361.58	2.49	50,785.34	2.40	65,009.76	2.94	52,148.81	2.53
应付账款	377,483.27	16.38	472,003.38	22.35	416,988.73	18.84	369,325.94	17.89
预收款项	3,133.40	0.14	5,964.41	0.28	11,280.83	0.51	1,681.62	0.08
应付职工薪酬	37,976.08	1.65	44,442.76	2.10	45,330.15	2.05	30,927.08	1.50
应交税费	6,569.91	0.29	9,741.44	0.46	10,939.82	0.49	3,751.43	0.18
其他应付款	31,168.23	1.35	41,786.41	1.98	36,255.52	1.64	26,294.46	1.07
一年内到期的非流动负债	203,699.62	8.84	332,179.16	15.73	528,019.42	23.86	91,300.73	4.42
<b>流动总负债</b>	<b>1,138,259.45</b>	<b>49.39</b>	<b>1,309,859.22</b>	<b>62.02</b>	<b>1,840,487.72</b>	<b>83.16</b>	<b>1,696,006.85</b>	<b>82.14</b>
<b>总负债</b>	<b>2,304,696.34</b>	<b>100.00</b>	<b>2,112,097.53</b>	<b>100.00</b>	<b>2,213,223.69</b>	<b>100.00</b>	<b>2,064,825.21</b>	<b>100.00</b>

2016-2018 年末及 2019 年第 6 月末，流动负债分别为 1,138,259.45 万元、1,309,859.22 万元、1,840,487.72 万元和 1,696,006.85 万元。2018 年末公司流动负债较 2017 年末增加了 530,628.50 万元，增长 40.51%，增幅较大，主要是由于短期借款及一年内到期的非流动负债增加较多。公司的流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债等科目构成。近三年末，上述四项合计占总负债的比例分别为 42.77%、56.27%和 76.55%。

### (1) 短期借款

2016-2018年末及2019年6月末，发行人短期借款分别为373,279.70万元、342,474.49万元、712,869.99万元和1,106,666.02万元，增长速度较快，2018年较2017年短期借款增加37.04亿元，增幅达到108.15%，主要系客户为偿还星科金朋2亿美元永续债本息及拟于2019年1月提前赎回4.25亿美元优先票据增加了短期质押借款。2019年6月末较2018年末增长55.24%，主要由于增加部分短期借款用于提前赎回4.25亿美元优先票据及提前归还银团贷款2.46亿美元。

图表6.23: 近三年及一期发行人短期借款的信用结构

单位: 万元

项目	2016 年末	2017 年末	2018 年末	2019 年 6 月末
质押借款	4,887.30	32,142.04	186,718.51	78,371.58
抵押借款	15,000.00	68,200.00	7,000.00	54,000.00
保证借款	279,142.84	210,096.88	398,251.48	960,594.44
信用借款	74,249.56	32,035.58	120,900.00	13,700.00
合计	<b>373,279.70</b>	<b>342,474.49</b>	<b>712,869.99</b>	<b>1,106,666.02</b>

### (2) 交易性金融负债

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人的交易性金融负债余额分别为 3,562.65 万元、0.00 万元、0.00 万元和 0.00 万元。主要系发行人办理的黄金租赁融资业务，目前已逐步到期而减少。

### (3) 衍生金融负债

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人的衍生金融负债余额分别为 44,025.00 万元、10,481.83 万元、13,793.51 万元和 13,910.75 万元。2017 年较 2016 年大幅下滑 76.19%，主要系对台湾子公司约定最低采购金额大幅减少。2018 年增长，主要系星科金朋支付台星科最低采购承诺及最低采购承诺价值变动。

### (4) 应付票据

发行人的应付票据主要是采购原材料所办理的银行承兑汇票。2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人应付票据余额分别为 57,361.58 万元、50,785.34 万元、65,009.76 万元和 52,148.81 万元。2018 年年末较年初增加 14,224.42 万元，主要系票据支付原材料款增加较多所致。

### (5) 应付账款

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人应付账款分别为 377,483.27 万元、472,003.38 万元、416,988.73 万元和 369,325.94 万元，2017 年增幅较大，达到 25.04%，主要系 2017 年长电科技经营效益较好，订单增多，导致应付账款明显增加。

图表 6.24: 近三年及一期发行人应付账款账龄情况

单位：万元

项目	2016 年末	2017 年末	2018 年末	2019 年 6 月末
1 年以内	374,400.04	466,360.52	411,338.37	364,629.27
1-2 年	2,234.11	4,400.81	4,207.93	3,421.87
2-3 年	365.88	1,024.79	1,381.76	1,218.40
3 年以上	483.24	217.27	60.67	56.40
<b>合计</b>	<b>377,483.27</b>	<b>472,003.38</b>	<b>416,988.73</b>	<b>369,325.94</b>

#### (6) 预收账款

发行人的预收账款主要是预收客户的货款，账龄基本在 1 年以内。2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人预收账款余额分别为 3,133.40 万元、5,964.41 万元、11,280.83 万元和 1,681.62 万元，占发行人负债的比例较小。2018 年末预收账款增加的原因主要系报告期末收到客户预收款增加。

#### (7) 应付职工薪酬

发行人应付职工薪酬主要由短期薪酬和设定提存计划的离职后福利构成。2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人应付职工薪酬余额分别为 37,976.08 万元、44,442.76 万元、45,330.15 万元和 30,927.08 万元。近三年来，发行人的人力资源薪酬支出逐年增加。

#### (8) 应交税费

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人应交税费分别为 6,569.91 万元、9,741.44 万元、10,939.82 万元和 3,751.43 万元，2016-2018 年，应付个人所得税、增值税及印花税的增加，使应交税费保持增长趋势。

#### (9) 应付利息

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人应付利息分别为 7,063.49 万元、18,757.19 万元、6,843.96 万元和 4,153.57 万元，占发行人负债的比例较小，主要系发行人对外融资应支付的利息。

#### (10) 其他应付款

发行人其他应付款主要为向业务销售人员收取的产品销售风险金和向供应商收取的部分押金等。2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人其他应付款分别为 31,168.23 万元、41,786.41 万元、36,255.52 万元和 26,294.46 万元。2016-2018 年，其他应付款占发行人负债的比例较小，且基本保持稳定，主要构成为向业务销售人员收取的产品销售风险金和向供应商收取的部分押金及水电费等。

#### (11) 一年内到期的非流动负债

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人非流动负债分别为 203,699.62 万元、332,179.16 万元、528,019.42 万元和 91,300.73 万元，近三年逐年上升，2018 年较 2017 年增长 58.96%，主要系星科金朋 2015 年发行的 4.25 亿美元 5 年期优先

票据拟于 2019 年 1 月提前赎回，故转入一年内到期的非流动负债。

图表 6.25: 近三年及一期一年内到期的非流动负债分类情况

单位: 万元

项目	2016 年末	2017 年末	2018 年末	2019 年 6 月末
1 年内到期的长期借款	110,020.02	83,750.91	152,457.33	49,728.00
1 年内到期的应付债券	-	130,684.00	291,686.00	-
1 年内到期的长期应付款	93,679.60	117,744.24	83,876.09	41,572.73
合计	<b>203,699.62</b>	<b>332,179.16</b>	<b>528,019.42</b>	<b>91,300.73</b>

## 2、非流动负债结构分析

图表 6.26: 发行人 2016-2018 年及 2019 年 6 月末非流动负债结构数据表

单位: 万元、%

项目	2016 年末		2017 年末		2018 年末		2019 年 6 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	402,670.25	17.47	372,117.62	17.62	293,379.00	13.26	221,567.28	10.73
应付债券	477,616.98	20.72	272,127.15	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	201,318.02	8.74	113,515.26	5.37	32,909.03	1.49	99,686.85	4.83
递延所得税负债	19,058.99	0.83	19,251.39	0.91	16,540.74	0.75	18,499.48	0.90
递延收益-非流动负债	38,062.73	1.65	24,931.77	1.18	26,935.12	1.22	28,884.73	1.40
其他非流动负债	10,880.92	0.47	0.00	0.00	2,890.49	0.13	0.00	0.00
非流动负债合计	1,166,436.89	50.61	802,238.31	37.98	372,735.97	16.84	368,818.37	17.86
负债合计	<b>2,304,696.34</b>	<b>100.00</b>	<b>2,112,097.53</b>	<b>100.00</b>	<b>2,213,223.69</b>	<b>100.00</b>	<b>2,064,825.21</b>	<b>100.00</b>

近三年及一期，公司非流动负债分别为 1,166,436.89 万元、802,238.31 万元、372,735.97 万元和 368,818.37 万元，呈逐渐下降趋势。非流动负债占总负债的比例分别为 50.61%、37.98%、16.84%和 17.86%。公司的非流动负债主要由长期借款、应付债券、长期应付款等构成。

### (1) 长期借款

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人长期借款余额分别为 402,670.25 万元、372,117.62 万元、293,379.00 万元和 221,567.28 万元。长期借款逐年下滑，主要系发行人通过银行短期融资来逐步偿还子公司星科金朋的长期债务。

图表 6.27: 近三年及一期长期借款的信用结构

单位：万元

项目	2016 年末	2017 年末	2018 年末	2019 年 6 月末
质押借款	302,830.06	181,869.06	198,114.25	63,066.00
抵押借款	81,539.56	61,210.43	80,190.19	69,974.48
保证借款	74,183.87	114,394.66	119,746.63	138,254.80
信用借款	54,136.77	98,394.37	47,785.26	-
减：1 年以内到期的长期借款	-110,020.02	-83,750.91	-152,457.33	-49,728.00
<b>合计</b>	<b>402,670.25</b>	<b>372,117.62</b>	<b>293,379.00</b>	<b>221,567.28</b>

### (2) 应付债券

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人应付债券余额分别为 477,616.98 万元、272,127.15 万元、0 万元和 0 万元。2018 年应付债券的大幅减少主要系星科金朋的 2 亿美元永续债在 2018 年 8 月份清偿完毕，同时星科金朋的 4.25 亿美元优先票据拟于 2019 年 1 月提前赎回，而调整至一年内到期的非流动负债，故目前暂无应付债券。

### (3) 长期应付款

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人长期应付款余额分别为 201,318.02 万元、113,515.26 万元、32,909.03 万元和 99,686.85 万元，2018 年大幅下降 71.01%，主要系固定资产融资租赁应付款大幅下滑。

图表 6.28：近三年及一期长期应付款分类情况

单位：万元

项目	2016 年末	2017 年末	2018 年末	2019 年 6 月末
固定资产融资租赁应付款	293,891.84	228,487.99	112,553.24	136,423.17
长期租赁费	1,105.79	2,771.51	4,231.87	4,836.41
减：一年内到期的固定资产融资租赁应付款	-93,679.60	-117,744.24	-83,876.09	-41,572.73
<b>合计</b>	<b>201,318.02</b>	<b>113,515.26</b>	<b>32,909.03</b>	<b>99,686.85</b>

### (4) 预计负债

2016 年末，发行人预计负债余额为 16,430.38 万元，自 2017 年末起，发行人预计负债为 0。预计负债主要系 2015 年 8 月长电科技收购星科金朋而产生的

可能的额外税务风险的最佳估计。2017 年，韩国主管税务机关进行了转让定价调查并对韩国星科金朋 2013-2015 年度转让定价事项作出了转让定价调整，于 2017 年 9 月支付了转移定价相关的税金约 163 万美金(折合人民币 1,082 万元)，同时转回了原计提的相关预计负债的超出部分。故此后续无预计负债余额。

#### (5) 递延所得税负债

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人递延所得税负债余额分别为 19,058.99 万元、19,251.39 万元、16,540.74 万元和 18,499.48 万元。主要系发行人合并星科金朋的递延所得税负债，其中包括固定资产折旧及收购时评估增值的合并调整等。

#### (6) 递延收益

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人递延收益余额分别为 38,062.73 万元、24,931.77 万元、26,935.12 万元和 28,884.73 万元。递延收益部分较为稳定，主要构成为发行人所收到的各类政府补贴。

#### (7) 其他非流动负债

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人其他非流动负债余额分别为 10,880.92 万元、0.00 万元、2,890.49 万元和 0.00 万元。2017 年其他非流动负债下降至 0 主要系星科金朋对已剥离的其原台湾子公司的最低收入承诺，期限大于一年的部分计入永续债应付长期利息。2018 年及 2019 年 6 月变动的的原因主要系超过一年的最低采购承诺及最低采购承诺价值变动。

### (三) 所有者权益结构分析

图表 6.29: 发行人 2016-2018 年及 2019 年 6 月末所有者权益构成分类表

单位: 万元、%

项目	2016 年末		2017 年末		2018 年末		2019 年 6 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
实收资本(或股本)	103,591.48	15.53	135,984.40	14.20	160,287.46	13.04	160,287.46	13.36
资本公积金	241,369.24	36.17	689,122.52	71.95	1,024,249.84	83.31	1,024,249.84	85.39
其它综合收益	23,466.78	3.52	-4,421.67	-0.46	18,194.45	1.48	13,976.78	1.17
盈余公积金	9,971.34	1.49	12,228.40	1.28	12,228.40	0.99	12,228.40	1.02
未分配利润	81,069.65	12.15	111,593.40	11.65	14,262.25	1.16	-11,627.60	-0.97

项目	2016 年末		2017 年末		2018 年末		2019 年 6 月末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
归属于母公司所有者权益合计	459,468.48	68.86	944,507.04	98.61	1,229,222.40	99.98	1,199,114.87	99.97
少数股东权益	207,760.27	31.14	13,265.90	1.39	294.01	0.02	384.12	0.03
所有者权益合计	667,228.76	100.00	957,772.94	100.00	1,229,516.41	100.00	1,199,498.99	100.00

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末, 发行人所有者权益随着资产规模的扩大也保持了较大规模, 申请人总权益分别为 667,228.76 万元、957,772.94 万元、1,229,516.41 万元和 1,199,498.99 万元, 其中归属于母公司权益分别为 459,468.48 万元、944,507.04 万元、1,229,222.4 万元和 1,199,114.87 万元, 分别占总权益的 68.86%、98.61%、99.98% 和 99.97%。

#### (1) 实收资本

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末, 发行人的实收资本分别为 103,591.48 万元、135,984.4 万元、160,287.46 万元和 160,287.46 万元, 分别占公司总权益的 15.53%、14.20%、13.04% 和 13.36%。

#### (2) 资本公积

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末, 发行人的资本公积分别为 241,369.24 万元、689,122.52 万元、1,024,249.84 万元和 1,024,249.84 万元, 分别占公司总权益的 36.17%、71.95%、83.31% 和 85.39%。2018 年, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1085 号《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准, 公司向产业基金、芯电半导体和金投领航非公开发行 174,754,771 股、34,696,198 股和 33,579,583 股有限售条件的股票; 出资额溢价部分扣除发行费用和相应的印花税后合计人民币 3,350,787,168.78 元, 计入资本公积, 故 2018 年末较年初资本公积增长 48.63%。

#### (3) 其他综合收益

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末, 发行人的其他综合收益分别为 23,466.78 万元、-4,421.67 万元、18,194.45 万元和 13,976.78 万元, 近年来该科目变动原因主要系汇率变动影响外币财务报表折算差额。

#### (4) 未分配利润

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末, 发行人的未分配利润分别为 81,069.65 万元、111,593.40 万元、14,262.25 万元和 -11,627.60 万元。2017 年较 2016 年末未分配利润上涨 37.65%, 主要系盈利增加所致。2018 年末较年初的未分配利润大



幅下降 87.22%，2019 年 6 月末未分配利润为负，主要系经营亏损所致。

#### (5) 少数股东权益

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末，发行人的少数股东权益 207,760.27 万元、13,265.90 万元、294.01 万元和 384.12 万元。2017 年末该科目余额较 2016 年末大幅下降 93.61%，主要系星科金朋亏损，2017 年 6 月完成资产重组完成后少数股东权益占比由 60.61% 变为 0%。2018 年末，该科目余额较 2017 年末下降 97.78%，主要系剥离分立器件自销业务相关资产后权益减少。

从所有者权益的结构来看，发行人的所有者权益主要由股本、资本公积和未分配利润构成。2016-2018 年末资本公积连续大幅增加主要系发行人进行了两次定向增发。

发行人利润分配政策如下：

根据发行人《公司章程》第一百五十七条规定，公司利润分配政策为：公司实行持续、稳定的利润分配制度，可以采取现金或股利方式分配股利。公司在盈利年度用于现金分红的金额最近三年平均每年不得少于当年实现的可分配利润的 10%。

图表 6.30：公司近三年的分红情况表

单位：万元

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比例 (%)
2016 年	1,553.87	10,633.44	14.61
2017 年	3,399.61	34,334.68	9.90
2018 年	0.00	-93,931.53	0.00

发行人未来的利润分配计划将根据公司章程的相关规定并结合公司的实际经营情况来确定。

#### (四) 盈利能力分析

图表 6.31：2016-2018 年及 2019 年 1-6 月盈利能力指标

单位：万元

项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年 1-6 月
营业收入	1,915,452.77	2,385,551.24	2,385,648.74	914,846.16
营业成本	1,689,061.57	2,106,101.27	2,113,075.83	829,739.98

项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年 1-6 月
投资收益	1,865.59	8,505.55	45,229.70	-375.00
营业利润	-44,497.83	-2,188.62	-80,383.87	-45,892.47
利润总额	-25,097.09	2,397.00	-81,299.56	-46,215.56
净利润	-31,613.35	7,353.98	-92,664.05	-25,799.75
销售毛利率	11.82%	11.71%	11.43%	9.30%
销售净利率	-1.65%	0.31%	-3.88%	-2.82%
总资产报酬率	1.97%	2.91%	0.18%	-0.32%
总资产净利率	-1.14%	0.24%	-2.85%	-0.77%

### 1、盈利情况分析

2016-2018 年及 2019 年 1-6 月,发行人分别实现营业收入 1,915,452.77 万元、2,385,551.24 万元、2,385,648.74 万元和 914,846.16 万元。2017 年较 2016 年增加了 470,098.47 万元,增长率为 24.54%,主要因为 2017 年行业景气度增加,同时发行人高端产品快速增长,结构优化,产能大幅度提升。

2016-2018 年及 2019 年 1-6 月,发行人的销售毛利率分别为 11.82%、11.71%、11.43%和 9.30%,波动幅度较小。

2016-2018 年及 2019 年 1-6 月,发行人营业利润分别为-44,497.83 万元、-2,188.62 万元、-80,383.87 万元和-45,892.47 万元,近三年及一期利润均为负,主要系星科金朋暂时处于亏损状态,拖累发行人整体的盈利能力。

### 2、期间费用分析

图表 6.32: 发行人 2016-2018 年及 2019 年 1-6 月期间费用情况

单位: 万元

项目	2016 年度		2017 年度		2018 年度		2019 年 1-6 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	23,356.50	8.36%	24,128.86	7.46%	28,537.14	8.36%	12,766.59	8.75%
管理费用	159,510.47	57.11%	200,816.83	62.13%	111,052.03	32.52%	54,896.17	37.63%
研发费用	-	-	-	-	88,838.52	26.01%	34,863.35	23.90%
财务费用	96,429.98	34.53%	98,285.02	30.41%	113,102.51	33.12%	43,362.24	29.72%
期间费用合计	279,296.95	100.00%	323,230.71	100.00%	341,530.20	100.00%	145,888.35	100.00%
期间费用占收入之比	14.58%		13.55%		14.32%		15.95%	

发行人销售费用主要包括运输费用、销售人员工资及广告费等。2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，发行人的销售费用分别为 23,356.50 万元、24,128.86 万元、28,537.14 万元和 12,766.59 万元。销售费用保持相对稳定。

发行人管理费用主要由管理行政人员的薪酬、研发费用、折旧费等组成。2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，发行人的管理费用分别为 159,510.47 万元、200,816.83 万元、111,052.03 万元和 54,896.17 万元。2017 年的管理费用和 2016 年同期相比增长了 25.90%，主要原因是由于发行人研发费用增加及职工社会统筹金上缴比例提高。2018 年较 2017 年大幅下滑主要系会计准则的变更研发费用单列。

发行人财务费用主要为银行借款利息支出，2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，发行人的财务费用分别为 96,429.98 万元、98,285.02 万元、113,102.51 万元和 43,362.24 万元，呈逐年上升的趋势，主要原因是随着近几年来发行人规模的扩大和资金周转的需要，发行人的有息债务逐年增加，所支付的借款利息因此逐年增加。2018 年较 2017 年财务费用增加主要系汇兑损益、合并星科金朋的利息费用、交换要约和赎回费用、债务发行安排费及融资利息支出的增加。

### 3、投资收益及营业外收支情况分析

图表 6.33: 发行人 2016-2018 年及 2019 年 1-6 月投资收益及营业外收支情况

单位: 万元

项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年 1-6 月
投资收益	1,865.59	8,505.55	45,229.70	-375.00
营业外收入	21,838.02	7,017.31	986.37	47.69
营业外支出	2,437.28	2,431.69	1,902.06	370.79

2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，发行人投资收益分别为 1,865.59 万元、8,505.55 万元、45,229.70 万元和 -375.00 万元，主要系发行人投资参股公司所得到的分红，在利润总额中占比很小。

发行人的营业外收入主要是所获得的政府各项扶持、奖励补贴，系政府部门给予公司技术改造项目的补贴资金，主要系国家重大科技专项验收通过及地方政府奖励增加所致。营业外支出主要是非流动资产处置的损失。

发行人的营业外支出在营业收入中占比很小。

### (五) 偿债能力分析

图表 6.34: 发行人 2016-2018 年及 2019 年 6 月末流动性和偿债能力指标

单位: 万元、%

项目	2016 年末	2017 年末	2018 年末	2019 年 6 月末
流动负债	1,138,259.45	1,309,859.22	1,840,487.72	1,696,006.85
负债总额	2,304,696.34	2,112,097.53	2,213,223.69	2,064,825.21
流动比率	0.68	0.65	0.59	0.53
速动比率	0.52	0.47	0.47	0.40
资产负债率	77.55	68.80	64.29	63.25
EBITDA 利息保障倍数	4.08	4.73	3.62	3.81

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末,发行人资产负债率分别为 77.55%、68.80%、64.29%和 63.25%, 2016 年负债比例较高主要系收购星科晶朋进行了较多融资, 2017 年开始资产负债率逐年下降主要系公司发行了两次定增, 使得所有者权益增加。

2016-2018 年末及 2019 年 6 月末,发行人的流动比率分别为 0.68、0.65、0.59 和 0.53, 速动比率分别为 0.52、0.47、0.47 和 0.40。流动比率及速度比率逐年下降, 主要是由于公司调整资本债务结构造成短期债务增加。

2016-2018 年末,发行人 EBITDA 利息保障倍数分别为 4.08、4.73、3.62, 公司对债务的保障能力较强。其中 2017 年随着行业整体形势好转, 发行人利润总额大幅增加, EBITDA 指标强劲。2018 年发行人 EBITDA 相较 2017 年有所减少, 主要原因是发行人 2018 年营业收入与 2017 年相近但净利润减少较多。

#### (六) 营运效率分析

图表 6.35: 发行人 2016-2018 年资产营运效率比率分析表

项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年 1-6 月
应收账款周转率	8.40	8.58	8.49	3.33
存货周转率	10.74	10.11	9.21	3.74
总资产周转率	0.69	0.79	0.73	0.27

2016-2018 年, 发行人应收账款周转率分别为 8.40、8.58 和 8.49。总体处于较高水平, 应收账款回收状况良好。

2016-2018 年, 发行人存货周转率分别为 10.74、10.11 和 9.21, 总体处于较高水平, 存货管理能力良好。

2016-2018 年, 发行人总资产周转率分别为 0.69、0.79 和 0.73。2016-2018 年发行人总资产周转率无重大变动, 资产利用率保持稳定, 基本保持一致。

#### (七) 现金流量分析

图表 6.36: 发行人 2016-2018 年及 2019 年 1-6 月现金流量主要数据

单位：万元

项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年 1-6 月
<b>经营活动产生的现金流量:</b>				
经营活动现金流入	1,999,911.67	2,568,779.32	2,574,391.59	1,032,155.53
经营活动现金流出	1,732,983.35	2,203,054.79	2,323,472.32	950,447.76
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>266,928.32</b>	<b>365,724.53</b>	<b>250,919.27</b>	<b>81,707.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量:</b>				
投资活动现金流入	69,088.53	104,508.75	249,062.79	10,032.84
投资活动现金流出	498,775.33	466,813.04	604,648.52	152,972.59
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-429,686.80</b>	<b>-362,304.29</b>	<b>-355,585.73</b>	<b>-142,939.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量:</b>				
筹资活动现金流入	1,152,659.75	968,151.28	1,374,386.86	927,035.00
筹资活动现金流出	1,048,909.82	970,053.58	1,032,198.80	1,035,908.36
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>103,749.93</b>	<b>-1,902.30</b>	<b>342,188.06</b>	<b>-108,873.36</b>
汇率变动对现金的影响	7,113.00	-5,381.02	9,149.89	633.33
现金及现金等价物净增加额	-51,895.55	-3,863.07	246,671.48	-169,472.00

2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，发行人经营活动现金流量净额分别为 266,928.32 万元、365,724.53 万元、250,919.27 万元和 81,707.77 万元。2017 年的经营活动现金净流量相较 2016 年增长 98,796.21 万元，有较大幅度的增加，主要是因为销售收入增加、票据结算增加所致。2018 年较 2017 年减少 114,805.26 万元，主要是系发行人 2018 年受到中美贸易战、数字货币市场、4G 手机市场增长乏力等影响造成业绩现金流量减少。

2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为 -429,686.80 万元、-362,304.29 万元、-355,585.73 万元和 -142,939.75 万元。公司投资活动产生的现金流量净额均为负值，主要是近年来公司利用逐步掌握的先进封装测试技术，进行了大规模技术改造及固定资产投入，现金流出较大。投资活动产生的现金流量与公司产品结构调整、业务快速发展相匹配。2016-2018 年，投资活动继续呈大额净流出状态，主要系近年来业务规模扩大，新增工程项目较多，用于购建固定资产、无形资产和其他长期投资支付的现金。

2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，发行人筹资活动现金净额分别为 103,749.93

万元、-1,902.30 万元、342,188.06 万元和-108,873.36 万元。公司筹资活动产生的现金净流量主要是由于公司为满足投资需求和业务发展而筹措资金所致。2017 年筹资活动现金净额为负主要是由于新增筹资减少，归还增加。2018 年发行人筹资活动现金净流量为 342,188.06 万元，主要系主要系客户为偿还星科金朋 2 亿美元永续债本息及拟于 2019 年 1 月提前赎回 4.25 亿美元优先票据增加了短期质押借款。

## 六、有息债务

### (一) 间接融资情况

#### 1、债务结构

截至 2018 年末，发行人间接融资总额为 1,158,706.32 万元，其中短期借款为 712,869.99 万元，一年内到期的长期借款为 152,457.33，长期借款为 293,379.00 万元。

截至 2019 年 6 月末，发行人间接融资总额为 1,377,961.30 万元，其中短期借款为 1,106,666.02 万元，一年内到期的长期借款为 49,728.00 万元，长期借款为 221,567.28 万元。

图表 6.37: 公司近一年及一期债务结构表

单位：万元、%

项目	2018 年末		2019 年 6 月末	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	712,869.99	61.52	1,106,666.02	80.31
一年内到期的长期借款	152,457.33	13.16	49,728.00	3.61
长期借款	293,379.00	25.32	221,567.28	16.08
合计	<b>1,158,706.32</b>	<b>100.00</b>	<b>1,377,961.30</b>	<b>100.00</b>

#### 2、债务性质

图表 6.38: 公司近一年及一期银行借款性质表

单位：万元

短期借款性质		
项目	2018 年末	2019 年 6 月末
质押借款	186,718.51	78,371.58
抵押借款	7,000.00	54,000.00
保证借款	398,251.48	960,594.44

信用借款	120,900.00	13,700.00
<b>合计</b>	<b>712,869.99</b>	<b>1,106,666.02</b>
<b>长期借款性质</b>		
<b>项目</b>	<b>2018 年末</b>	<b>2019 年 6 月末</b>
质押借款	198,114.25	63,066.00
抵押借款	80,190.19	69,974.48
保证借款	119,746.63	138,254.80
信用借款	47,785.26	-
减：一年以内到期的长期借款	152,457.33	49,728.00
<b>合计</b>	<b>293,379.00</b>	<b>221,567.28</b>

### 3、主要借款明细

图表 6.39: 截至 2019 年 6 月末主要借款明细表

单位：万元、%

贷款行	金额	币种	借款日	到期日	利率	担保方式
北京银行	10,000.00	CNY	2019/1/14	2019/7/14	4.79	保证
滁州中行	8,950.00	CNY	2019/5/17	2020/5/17	4.35	保证
滁州中行	3,000.00	CNY	2018/9/27	2019/9/27	4.57	保证
滁州中行	4,000.00	CNY	2018/9/7	2019/9/6	4.57	保证
工商银行	5,000.00	CNY	2018/9/10	2020/9/6	4.89	保证
工商银行	10,000.00	CNY	2018/9/10	2020/9/6	4.89	保证
工商银行	10,000.00	CNY	2018/9/10	2020/9/6	4.89	保证
工商银行	9,700.00	CNY	2018/9/10	2020/9/6	4.89	保证
工商银行	9,700.00	CNY	2018/9/10	2020/9/6	4.89	保证
工商银行	5,000.00	CNY	2019/3/8	2020/3/7	4.70	保证
工商银行	5,000.00	CNY	2018/9/12	2019/9/10	4.70	保证
光大银行	6,305.00	CNY	2018/8/16	2020/7/30	5.70	保证
光大银行	4,750.00	CNY	2017/9/19	2020/9/18	5.32	保证
广发银行	10,000.00	CNY	2019/4/1	2020/3/28	4.79	保证
广发银行	25,000.00	CNY	2019/1/2	2020/1/1	4.79	保证
广发银行	5,000.00	CNY	2019/2/18	2019/11/21	4.79	保证
广发银行	10,000.00	CNY	2018/11/22	2019/11/18	4.15	保证
华夏银行	12,800.00	CNY	2019/2/12	2020/2/13	4.93	保证
华夏银行	7,800.00	CNY	2019/1/24	2020/1/24	4.93	保证
华夏银行	20,000.00	CNY	2019/1/3	2020/1/6	4.93	保证
华夏银行	6,500.00	CNY	2018/11/27	2019/11/28	4.93	保证
建设银行	14,500.00	CNY	2019/3/12	2020/3/11	3.85	保证
建设银行	5,500.00	CNY	2019/1/4	2020/1/3	4.35	保证
建设银行	9,500.00	CNY	2019/1/3	2020/1/2	4.35	保证
建设银行	5,000.00	CNY	2018/10/23	2019/10/22	4.35	保证
建设银行	5,000.00	CNY	2019/3/13	2020/3/12	4.35	保证
建设银行	5,000.00	CNY	2018/12/18	2019/12/17	4.35	保证
交通银行	4,400.00	CNY	2019/3/19	2019/9/12	4.70	信用
交通银行	9,300.00	CNY	2019/2/19	2019/8/16	4.65	信用
交通银行	4,800.00	CNY	2019/1/3	2020/1/2	4.57	保证
交通银行	4,000.00	CNY	2019/2/25	2020/2/24	4.79	保证
交通银行	6,300.00	CNY	2019/2/25	2020/2/24	4.79	保证

贷款行	金额	币种	借款日	到期日	利率	担保方式
交通银行	4,700.00	CNY	2019/1/3	2020/1/2	4.57	保证
进出口银行	42,000.00	CNY	2019/6/27	2020/6/27	3.69	抵押
进出口银行	16,500.00	CNY	2019/6/25	2021/6/14	3.69	抵押
进出口银行	15,500.00	CNY	2019/6/14	2021/6/14	3.69	抵押
进出口银行	10,000.00	CNY	2019/3/27	2021/3/27	3.69	保证
进出口银行	2,600.00	CNY	2019/5/17	2019/10/22	4.35	保证
进出口银行	7,400.00	CNY	2019/4/19	2019/9/26	4.35	保证
民生银行	5,000.00	CNY	2019/5/13	2021/5/3	5.00	保证
民生银行	5,000.00	CNY	2019/6/26	2020/6/18	4.70	保证
民生银行	10,000.00	CNY	2019/5/8	2020/4/30	5.00	保证
南洋银行	5,000.00	CNY	2018/12/28	2019/12/1	4.79	保证
南洋银行	7,000.00	CNY	2018/11/27	2019/12/2	3.70	保证
宁波银行	3,500.00	CNY	2018/8/3	2019/8/3	4.79	保证
农商行	7,000.00	CNY	2019/5/10	2020/5/9	5.30	保证
农商行	3,000.00	CNY	2018/10/26	2019/10/25	5.30	保证
农业银行	15,000.00	CNY	2019/1/10	2019/7/9	4.50	保证
农业银行	10,000.00	CNY	2018/10/23	2019/10/22	4.57	保证
农业银行	10,000.00	CNY	2019/4/16	2020/4/15	4.58	保证
平安银行	7,000.00	CNY	2019/6/12	2020/6/11	4.57	保证
平安银行	3,000.00	CNY	2019/6/6	2020/6/5	4.57	保证
平安银行	4,600.00	CNY	2019/3/21	2019/9/18	3.80	保证
平安银行	10,000.00	CNY	2019/1/24	2019/7/25	3.85	保证
浦发银行	9,400.00	CNY	2018/4/27	2021/4/27	5.70	保证
浦发银行	10,000.00	CNY	2019/3/8	2019/9/8	5.22	保证
浦发银行	10,000.00	CNY	2019/3/12	2019/9/12	5.22	保证
浦发银行	7,700.00	CNY	2019/3/7	2019/9/7	5.22	保证
浦发银行	2,000.00	CNY	2018/7/4	2019/7/4	5.34	保证
浦发银行	5,000.00	CNY	2019/1/4	2019/7/3	4.40	保证
兴业银行	10,000.00	CNY	2019/4/12	2019/10/11	4.79	保证
兴业银行	10,000.00	CNY	2019/4/16	2019/10/15	4.79	保证
兴业银行	12,500.00	CNY	2019/4/16	2019/10/15	4.79	保证
兴业银行	5,000.00	CNY	2019/4/12	2019/10/11	4.79	保证
兴业银行	10,000.00	CNY	2019/3/15	2019/9/14	5.22	保证
兴业银行	7,000.00	CNY	2018/7/26	2019/7/25	5.22	保证
兴业银行	7,200.00	CNY	2018/7/12	2019/7/11	5.22	保证
兴业银行	10,000.00	CNY	2018/10/23	2019/10/23	3.91	保证
兴业银行	7,500.00	CNY	2019/3/27	2020/3/26	5.22	保证
宿迁中行	6,000.00	CNY	2018/12/26	2019/12/17	4.35	保证
邮储银行	5,000.00	CNY	2019/6/21	2020/6/20	4.35	保证
邮储银行	20,000.00	CNY	2019/4/28	2020/4/27	4.26	保证
邮储银行	20,000.00	CNY	2018/12/25	2019/12/23	4.26	保证
招商银行	16,666.00	CNY	2019/3/28	2019/9/27	4.93	保证
招商银行	20,000.00	CNY	2019/6/4	2019/12/3	4.35	保证
招商银行	10,000.00	CNY	2019/3/29	2019/9/29	4.57	保证
招商银行	10,000.00	CNY	2018/9/14	2019/9/12	4.79	保证
招商银行	5,000.00	CNY	2018/9/11	2019/9/11	4.79	保证
招商银行	10,000.00	CNY	2019/3/22	2019/9/22	5.22	保证
中国银行	5,000.00	CNY	2019/1/10	2020/1/2	4.35	抵押



贷款行	金额	币种	借款日	到期日	利率	担保方式
中国银行	7,000.00	CNY	2018/7/13	2019/7/11	4.79	抵押
中国银行	1,000.00	CNY	2018/8/31	2020/12/20	5.23	抵押
中国银行	1,000.00	CNY	2018/8/31	2021/6/20	5.23	抵押
中国银行	1,000.00	CNY	2018/8/31	2021/12/20	5.23	抵押
中国银行	1,800.00	CNY	2018/8/31	2022/6/20	5.23	抵押
中国银行	1,800.00	CNY	2018/8/31	2022/12/20	5.23	抵押
中国银行	6,350.00	CNY	2017/8/8	2020/7/31	4.75	抵押
中国银行	1,000.00	CNY	2017/6/16	2020/12/1	4.75	抵押
中国银行	2,000.00	CNY	2017/6/16	2021/6/1	4.75	抵押
中国银行	2,000.00	CNY	2017/6/16	2021/12/1	4.75	抵押
中国银行	13,000.00	CNY	2019/1/31	2019/7/30	4.31	保证
中信银行	17,000.00	CNY	2019/1/10	2020/1/10	3.90	保证
中信银行	10,000.00	CNY	2019/2/15	2020/2/7	4.35	保证
中信银行	7,000.00	CNY	2018/7/27	2019/7/27	5.66	保证
中信银行	10,000.00	CNY	2019/1/10	2020/1/10	4.25	保证
中信银行	7,000.00	CNY	2018/7/18	2019/7/19	5.25	保证
比利时银行	600.00	USD	2019/1/4	2019/7/3	6M+125bp	保证
比利时银行	900.00	USD	2019/6/24	2019/12/24	6M+125bp	保证
港中银	700.00	USD	2017/12/19	2020/12/19	1M+285bp	质押
港中银	700.00	USD	2017/12/19	2021/6/19	1M+285bp	质押
港中银	700.00	USD	2017/12/19	2021/12/19	1M+285bp	质押
港中银	700.00	USD	2017/12/19	2022/6/19	1M+285bp	质押
港中银	800.00	USD	2017/12/19	2022/12/19	1M+285bp	质押
港中银	700.00	USD	2016/8/18	2020/8/18	1M+275bp	质押
港中银	700.00	USD	2016/8/18	2021/2/18	1M+275bp	质押
港中银	800.00	USD	2016/8/18	2021/8/18	1M+275bp	质押
华侨银行	1,500.00	USD	2019/5/6	2020/5/6	3M+110bp	保证
华侨银行	400.00	USD	2019/5/3	2020/4/30	3M+110bp	保证
华侨银行	300.00	USD	2019/3/29	2020/3/27	3M+110bp	保证
华侨银行	300.00	USD	2019/3/8	2020/3/6	3M+110bp	保证
凯基银行	5,000.00	USD	2019/4/15	2020/4/15	3M+150bp	保证
南京国开行	420.00	USD	2015/10/21	2020/8/12	6M+360bp	抵押
香港中行	4,000.00	USD	2019/3/19	2020/1/6	3M+208bp	保证
香港中行	2,000.00	USD	2019/1/10	2020/1/6	3M+208bp	保证
芯晟租赁	11,400.00	USD	2018/7/23	2019/7/11	3M+400bp	质押
星展银行 DBS	3,000.00	USD	2019/5/28	2020/3/12	1M+190bp	保证
星展银行 DBS	16,000.00	USD	2019/3/18	2020/3/12	1M+190bp	保证
中行首尔	2,977.00	USD	2019/3/15	2019/10/17	3M+315bp	保证
<b>合计(折合人民币)<sup>1</sup></b>	<b>1,180,602.39</b>					

截至募集说明书签署日，发行人到期借款本息均按时偿还。

## (二) 直接融资情况

<sup>1</sup> 取 2019 年 6 月 30 日汇率，即 1 美元 = 6.87 元人民币。

截至本募集说明书签署日，发行人无存续的直接融资。

图表 6.40: 发行人已兑付直接融资情况

单位: 亿元、%

证券名称	发行期限	债券评级	票面利率	发行日期	发行规模	类别
12 长电科技 CP001	1 年	A-1	6.10	2012-04-25	4.00	短期融资券
13 长电科技 CP001	1 年	A-1	5.20	2013-03-26	3.00	短期融资券
13 长电科技 PPN001	1 年	-	7.70	2013-10-15	3.00	非公开定向债务融资工具
14 长电科技 CP001	1 年	A-1	6.50	2014-06-19	3.00	短期融资券
14 长电科技 PPN001	1 年	-	7.20	2014-09-23	4.00	非公开定向债务融资工具
14 长电科技 PPN002	1 年	-	7.10	2014-11-17	6.00	非公开定向债务融资工具
15 长电科技 PPN001	180 天	-	4.50	2016-4-30	4.00	非公开定向债务融资工具
15 长电科技 CP001	1 年	A-1	6.25	2015-06-24	4.00	短期融资券
15 长电科技 CP002	1 年	A-1	3.73	2015-10-13	3.00	短期融资券
15 长电科技 CP003	1 年	A-1	3.73	2015-10-22	3.00	短期融资券
15 长电科技 CP004	1 年	A-1	4.30	2015-12-18	6.00	短期融资券

## 七、关联交易

### (一) 关联交易的定价原则、决策程序和决策机制

关联交易活动应遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格应主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。

为规范发行人的关联交易，维护发行人投资者特别是中小投资者的合法权益，保证发行人与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，发行人制定了《关联交易制度》。规定在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决制度；处理发行人与关联人之间的关联交易时，不得损害股东、特别是中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。规定独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。发行人为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议，有关股东应当在股东大会上回避表决。

### (二) 关联方关系

截至 2018 年末，发行人主要关联方关系如下。

#### 1、发行人第一大股东

图表 6.41: 截至 2018 年末发行人第一大股东情况

大股东名称	企业类型	注册地	法人代表	注册资本(万元)	持股比例(%)	公司实际控制人
国家集成电路产业	其他股份有限公司	北京	王占甫	9,872,000	19	王占甫

投资基金 股份有限 公司	(非上 市)					
--------------------	-----------	--	--	--	--	--

截至 2018 年末，国家集成电路产业基金共持有长电科技股份为 19.00%，为公司第一大股东；芯电半导体（上海）有限公司为公司第二大股东，持股比例 14.28%，江苏新潮科技集团有限公司为公司第三大股东，持股比例 10.42%，其余 56.30% 股份均为国内投资者持有（单一投资者持股比例均不超过 3%）。

## 2、发行人子公司情况

截至 2018 年末，发行人在子公司中的权益如下表所示：

子公司 名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
江阴长电先进封装有限公司	江阴市	江阴市	生产、销售	96.488	3.512	设立或投资
长电国际（香港）贸易投资有限公司	香港	香港	销售	100.00	0.00	设立或投资
江阴芯长电子材料有限公司	江阴市	江阴市	销售	100.00	0.00	设立或投资
长电科技（宿迁）有限公司	宿迁市	宿迁市	生产、销售	100.00	0.00	设立或投资
长电科技（滁州）有限公司	滁州市	滁州市	生产、销售	100.00	0.00	设立或投资
苏州长电新科投资有限公司	苏州市	苏州市	实业投资	100.00	0.00	设立或投资
苏州长电新朋投资有限公司	苏州市	苏州市	实业投资	22.73	77.27	设立或投资
JCET-SC (Singapore) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	投资控股	0.00	100.00	设立或投资
JCET Stats ChipPac Korea Ltd.	韩国	韩国	生产、销售	0.00	100.00	设立或投资
江阴城东科林环境有限公司	江阴市	江阴市	污水处理	100.00	0.00	设立或投资
星科金朋集成电路测试（江阴）有限公司	江阴市	江阴市	生产、销售	0.00	100.00	设立或投资
星科金朋新加坡	新加坡	新加坡	生产、销售	0.00	100.00	非同一控制下企业合并
STATS ChipPAC (Barbados) Ltd	巴巴多斯	巴巴多斯	投资控股	0.00	100.00	非同一控制下企业合并
STATS ChipPAC (BVI) Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	销售	0.00	100.00	非同一控制下企业合并
STATS ChipPAC Korea Ltd	韩国	韩国	生产、销售	0.00	100.00	非同一控制下企业合并
星科金朋上海	上海	上海	生产、销售	0.00	100.00	非同一控制下企业合并
星科金朋江阴	江阴市	江阴市	生产、销售	0.00	100.00	非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
STATS ChipPAC, Inc.	美国	美国	销售	0.00	100.00	非同一控制下企业合并
STATS ChipPAC (Thailand) Ltd	泰国	泰国	生产、销售	0.00	100.00	非同一控制下企业合并
STATS ChipPAC Services (Thailand) Limited	泰国	泰国	交易和投资	0.00	100.00	非同一控制下企业合并
ChipPAC International Company Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	控股投资	0.00	100.00	非同一控制下企业合并
江阴达仕新能源科技有限公司	江阴市	江阴市	研发、销售	100.00	0.00	非同一控制下企业合并
江阴新基电子设备有限公司	江阴市	江阴市	生产、销售	74.78	0.00	同一控制下企业合并

## 3、发行人合营和联营企业情况

图表 6.42: 截至 2018 年末发行人联营企业

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例		会计处理
					直接	间接	
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	无锡市	无锡市	研发、销售	人民币 211,000,000.00	9.48	-	权益法
SJ SEMICONDUCTOR CORPORATION	开曼群岛	开曼群岛	对外投资	美元 2,149,423,083.51	-	8.64	权益法

## 4、其他关联方情况。

图表 6.43: 截至 2018 年末不存在控制关系的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江阴新顺微电子有限公司	第一大股东的联营企业
深圳长电科技有限公司	第一大股东的联营企业
长电科技(香港)有限公司	第一大股东的联营企业
江苏新潮科技集团有限公司	第三大股东
中芯长电半导体(江阴)有限公司	与本公司第二大股东受同一方控制
江阴长江电器有限公司	第三大股东的子公司
江阴芯智联电子科技有限公司	第三大股东的子公司
江阴康强电子有限公司	第三大股东的联营企业(注 1)
江苏华海诚科新材料股份有限公司	第三大股东的联营企业
江苏中鹏新材料股份有限公司	第三大股东的联营企业
江苏斯菲尔电气股份有限公司	关联自然人参股的企业
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	与本公司第二大股东受同一方控制
中芯集成电路(宁波)有限公司	第一大股东的联营企业
芯鑫融资租赁有限责任公司	第一大股东的联营企业
中芯集成电路制造(绍兴)有限公司	与本公司第二大股东受同一方控制
江苏长晶科技有限公司	第一大股东的联营企业

注 1: 本集团第三大股东江苏新潮科技集团有限公司于 2018 年 9 月转让其所持有的江阴康强电子有限公司 30% 股权, 自此江阴康强电子有限公司与本集团不存在关联关系, 本财务报表中与江阴康强电子有限公司 2018 年度发生额仅包含 2018 年 1 月至 2018 年 9 月的交易。

### (三) 关联方交易情况

#### 1、采购商品及接受劳务

图表 6.44: 发行人 2018 年采购商品及接受劳务的关联交易

单位: 万元

关联方	关联交易内容	2018 年发生额
合肥图迅电子科技有限公司	采购原材料	868.60
江苏中鹏新材料股份有限公司	采购原材料	673.67
江阴康强电子有限公司	采购原材料	7,291.03
江苏斯菲尔电气股份有限公司	采购原材料	4.98
江苏华海诚科新材料有限公司	采购原材料	1,109.64
江阴芯智联电子科技有限公司	采购原材料	3,789.95
新加坡 Advanpack Solutions PTE LTD 公司	接受技术服务	77.64
中芯长电半导体(江阴)有限公司	采购原材料	80.47
总计		13,895.98

#### 2、销售商品及提供劳务

图表 6.45: 发行人 2018 年销售商品及提供劳务的关联交易

单位: 万元

关联方	关联交易内容	2018 年发生额
江阴芯智联电子科技有限公司	出售库存商品	336.44
江阴芯智联电子科技有限公司	出售原材料	0.05
江阴康强电子有限公司	出售库存商品	14.19
中芯长电半导体(江阴)有限公司	出售库存商品	105.87
江阴长江电器有限公司	出售库存商品	4.56
江苏斯菲尔电气股份有限公司	出售库存商品	133.89
江苏新潮科技集团有限公司	出售库存商品	45.45
合肥图迅电子科技有限公司	出售库存商品	17.09
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	出售库存商品	127.76
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	出售原材料	4.20
江苏斯菲尔电气股份有限公司	出售原材料	16.84
江苏长晶科技有限公司	出售库存商品	7,391.44
江苏长晶科技有限公司	出售原材料	2,256.88
中芯国际集成电路制造(北京)有	出售原材料	1,099.86

关联方	关联交易内容	2018 年发生额
限公司		
中芯集成电路制造（绍兴）有限公司	出售原材料	11.54
中芯集成电路（宁波）有限公司	出售原材料	33.14
江苏梦成教育咨询有限公司	出售库存商品	12.40
中芯国际集成电路制造（天津）有限公司	出售库存商品	83.76
Semiconductor Manufacturing International (BVI) Corporation	出售库存商品	3,376.65
<b>总计</b>		<b>15,072.34</b>

### 3、关联租赁情况

#### ① 本公司作为承租方：

图表 6.46: 发行人 2018 年资产承租的关联情况

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2018 年确认的租赁费
江苏新潮科技集团有限公司	房屋	295.38
中芯长电半导体（江阴）有限公司	设备	12.90
Xin Cheng Leasing Pte. Ltd.	设备	78.38
江阴芯智联电子科技有限公司	设备	12.81
江阴舒心行汽车租赁有限公司	汽车	298.54
<b>总计</b>		<b>698.01</b>

#### ② 本公司作为出租方：

图表 6.47: 发行人 2018 年资产租赁的关联情况

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2018 年确认的租赁收入
江阴芯智联电子科技有限公司	房屋、设备	1,801.98
中芯长电半导体（江阴）有限公司	房屋	315.93
江阴长江电器有限公司	设备	3.24
江苏中鹏新材料股份有限公司	设备	6.89
江苏华海诚科新材料有限公司	设备	7.28
<b>总计</b>		<b>2,135.32</b>

### 4、关联担保情况

#### （1）与关联方之间的担保情况

##### ① 本公司作为担保方：无。

##### ② 本公司作为被担保方：

图表 6.48: 截至 2018 年末发行人与关联方的担保情况

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 50,000,000.00	2018/1/2	2019/1/1	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 78,000,000.00	2018/1/22	2019/1/23	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 500,000.00	2018/1/24	2019/1/24	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 500,000.00	2018/1/24	2019/7/24	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 48,500,000.00	2018/1/24	2020/1/24	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 128,000,000.00	2018/2/9	2019/2/12	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 29,000,000.00	2018/3/14	2019/3/14	是
江苏新潮科技集团有限公司	美元 3,030,000.00	2018/4/1	2019/4/1	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 100,000,000.00	2018/4/2	2019/4/1	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 100,000,000.00	2018/4/26	2019/4/26	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 1,000,000.00	2018/4/27	2019/7/20	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 1,000,000.00	2018/4/27	2019/12/20	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 1,000,000.00	2018/4/27	2020/7/20	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 1,000,000.00	2018/4/27	2020/12/20	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 94,000,000.00	2018/4/27	2021/4/27	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 200,000,000.00	2018/4/28	2019/4/27	是
江苏新潮科技集团有限公司	美元 3,030,000.00	2018/4/29	2019/4/29	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 70,000,000.00	2018/5/11	2019/5/9	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 100,000,000.00	2018/5/15	2019/5/14	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 100,000,000.00	2018/5/25	2019/5/24	是
江苏新潮科技集团有限公司	美元 15,150,000.00	2018/5/25	2019/5/25	是
江苏新潮科技集团有限公司	美元 4,040,000.00	2018/5/27	2019/5/27	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 30,000,000.00	2018/6/5	2019/6/4	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 225,000,000.00	2018/6/8	2019/6/7	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 90,000,000.00	2018/6/15	2019/6/14	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 50,000,000.00	2018/6/27	2019/6/26	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 200,000,000.00	2018/6/28	2019/6/27	否
江苏新潮科技集团有限公司	美元 6,000,000.00	2018/7/5	2019/1/4	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 8,390,000.00	2018/7/9	2019/1/9	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 200,000,000.00	2018/7/13	2019/7/11	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 100,000,000.00	2018/7/17	2019/1/11	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 70,000,000.00	2018/7/18	2019/7/19	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 80,000,000.00	2018/7/19	2019/1/15	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 140,000,000.00	2018/7/24	2019/1/29	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 35,000,000.00	2018/8/3	2019/8/3	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 2,650,000.00	2018/8/14	2019/2/14	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 650,000.00	2018/8/16	2019/1/30	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 650,000.00	2018/8/16	2019/7/30	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 650,000.00	2018/8/16	2020/1/30	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 63,050,000.00	2018/8/16	2020/7/30	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 126,000,000.00	2018/8/20	2019/2/15	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 40,000,000.00	2018/9/7	2019/9/6	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 100,000,000.00	2018/9/14	2019/9/12	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 41,000,000.00	2018/9/17	2019/3/17	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 46,000,000.00	2018/9/20	2019/3/20	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 30,000,000.00	2018/9/27	2019/9/27	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 21,610,000.00	2018/10/15	2019/4/15	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 5,900,000.00	2018/10/19	2019/5/19	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 100,000,000.00	2018/10/23	2019/10/22	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 100,000,000.00	2018/10/23	2019/10/23	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 4,800,000.00	2018/10/24	2019/6/8	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 30,000,000.00	2018/10/26	2019/10/25	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 21,000,000.00	2018/10/31	2019/1/31	是



担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 120,000,000.00	2018/11/5	2019/5/5	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 9,000,000.00	2018/11/21	2019/5/21	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 50,000,000.00	2018/11/22	2019/5/22	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 100,000,000.00	2018/11/22	2019/11/18	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 65,000,000.00	2018/11/27	2019/11/28	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 70,000,000.00	2018/11/27	2019/12/2	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 5,600,000.00	2018/11/28	2019/2/28	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 70,000,000.00	2018/12/6	2019/6/5	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 150,000,000.00	2018/12/7	2019/12/7	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 50,000,000.00	2018/12/11	2019/6/11	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 57,000,000.00	2018/12/12	2019/6/11	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 200,000,000.00	2018/12/25	2019/12/23	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 15,000,000.00	2018/12/28	2019/3/28	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 50,000,000.00	2018/12/28	2019/12/1	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 62,974,700.00	2016/5/27	2019/2/27	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 63,767,500.00	2016/5/27	2019/5/27	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 62,974,800.00	2016/6/17	2019/3/17	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 63,767,500.00	2016/6/17	2019/6/17	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 34,480,300.00	2016/11/30	2019/2/28	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 34,966,400.00	2016/11/30	2019/5/30	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 35,459,400.00	2016/11/30	2019/8/30	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 35,959,300.00	2016/11/30	2019/11/30	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 32,756,300.00	2016/12/14	2019/3/14	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 33,218,100.00	2016/12/14	2019/6/14	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 33,686,400.00	2016/12/14	2019/9/14	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 34,161,300.00	2016/12/14	2019/12/14	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 1,700,000.00	2017/1/23	2019/1/23	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 1,724,000.00	2017/1/23	2019/4/23	是

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 1,748,300.00	2017/1/23	2019/7/23	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 1,773,000.00	2017/1/23	2019/10/23	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 1,798,000.00	2017/1/23	2020/1/23	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 8,500,200.00	2017/2/24	2019/2/24	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 8,620,100.00	2017/2/24	2019/5/24	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 8,741,600.00	2017/2/24	2019/8/24	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 8,864,900.00	2017/2/24	2019/11/24	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 8,989,800.00	2017/2/24	2020/2/24	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 34,001,000.00	2017/3/7	2019/3/7	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 34,480,300.00	2017/3/7	2019/6/7	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 34,966,400.00	2017/3/7	2019/9/7	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 35,459,400.00	2017/3/7	2019/12/7	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 35,959,300.00	2017/3/7	2020/3/7	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 10,000,000.00	2017/6/16	2019/6/1	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 10,000,000.00	2017/6/16	2019/12/1	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 10,000,000.00	2017/6/16	2020/6/1	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 10,000,000.00	2017/6/16	2020/12/1	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 20,000,000.00	2017/6/16	2021/6/1	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 20,000,000.00	2017/6/16	2021/12/1	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 1,000,000.00	2017/8/8	2019/6/1	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 1,000,000.00	2017/8/8	2019/12/1	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 1,000,000.00	2017/8/8	2020/6/1	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 63,500,000.00	2017/8/8	2020/7/31	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 500,000.00	2017/9/19	2019/3/18	是
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 500,000.00	2017/9/19	2019/9/18	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 500,000.00	2017/9/19	2020/3/18	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 47,500,000.00	2017/9/19	2020/9/18	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 50,000,000.00	2017/12/1	2019/12/10	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 139,000,000.00	2017/6/14	2019/7/19	否
江苏新潮科技集团有限公司	人民币 550,000,000.00	2018/6/26	2020/9/6	否
江苏新潮科技集团有限公司	美元 22,900,000.00	2015/3/10	2020/8/12	否

## 5、关联方资产转让、债务重组情况

图表 6.49: 发行人 2018 年资产转让的关联情况

单位: 万元

关联方	关联交易内容	2018 年发生额
Xin Cheng Leasing Pte. Ltd.	采购固定资产	1,812.96
江苏斯菲尔电气股份有限公司	采购固定资产	30.17
江阴芯智联电子科技有限公司	销售固定资产	28.39

## 6、其他关联交易

图表 6.50: 截至 2018 年末的其他关联交易明细

单位: 万元

关联方	交易内容	2018 年收取租赁相关费用
中芯长电半导体(江阴)有限公司	租赁相关动力费	1,700.75
江阴芯智联电子科技有限公司	租赁相关动力费	719.93
新加坡 Advanpack Solutions PTE LTD 公司	其他租赁费	15.04
	总计	2,435.73

## 7、关联方应收、应付款余额

图表 6.51: 截至 2018 年末的关联方应收、应付款余额

单位: 万元

项目名称	关联方	期末账面余额
应收账款	江阴芯智联电子科技有限公司	8.17
应收账款	中芯长电半导体(江阴)有限公司	18.82
应收账款	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	16.40
应收账款	中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	263.42
其他应收款	新加坡 Advanpack Solutions PTE LTD 公司	0.10

项目名称	关联方	期末账面余额
其他应收款	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	0.24
预付账款	江苏华海诚科新材料股份有限公司	0.74
其他应收款	中芯长电半导体（江阴）有限公司	416.81
一年内到期的非流动资产	芯鑫融资租赁有限责任公司	12,423.84
应收账款	深圳长电科技有限公司	8,316.19
应收账款	长电科技（香港）有限公司	358.47
应收账款	中芯集成电路（宁波）有限公司	26.22
应收账款	中芯集成电路制造（绍兴）有限公司	13.17
其他应收款	江阴新顺微电子有限公司	3,404.21
其他应收款	长电科技（香港）有限公司	5.14
其他应收款	江阴芯智联电子科技有限公司	109.06
应收账款	江苏斯菲尔电气股份有限公司	122.00
应收账款	Semiconductor Manufacturing International (BVI) Corporation	345.61
应收账款	中芯国际集成电路制造（天津）有限公司	174.21
应收账款	江苏长晶科技有限公司	11,047.11
其他非流动资产	江阴新顺微电子有限公司	5,302.89
	<b>总计</b>	<b>42,372.81</b>

## 八、或有事项

### （一）对外担保情况

截至 2019 年 6 月末，发行人无对外担保情况。

### （二）未决诉讼、仲裁事项

2013 年 2 月，STATS CHIPPAC PTE. LTD.与 Broadcom Corporation、Broadcom Limited，及 Broadcom Singapore Pte. Ltd.（以下合称“博通公司”）签署了《Semiconductor Packaging Agreement》，合同约定若 STATS CHIPPAC PTE. LTD.提供的封装制造产品侵犯第三人专利导致博通公司遭受损失时，STATS CHIPPAC PTE. LTD.必须赔偿申请人因此所受的损害。

2016 年 5 月，第三人 Tessera Technologies Inc., Tessera Inc.及 Invensas Corp.（以下合称“Tessera”）共同向博通公司提起专利侵权诉讼及其他法律程序（ITC），之后博通公司与 Tessera 于 2017 年 12 月达成和解协议，由博通公司支付和解金

给 Tessera。

博通公司认为部分涉及专利侵权的产品系由 STATS CHIPPAC PTE. LTD. 提供，进而就《Semiconductor Packaging Agreement》合同履行争议事项向美国仲裁委员会（American Arbitration Association）旧金山办公室提起仲裁申请，涉案金额为 1,080 万美元及利息、仲裁费、律师费。美国仲裁协会旧金山办公室已受理，STATS CHIPPAC PTE. LTD. 已于 4 月 23 日收到《仲裁通知书》（案件编号 01-19-0001-2223），尚未开庭。

### （三）承诺事项

发行人要约收购星科金朋时，受限于台湾政策，需将其台湾子公司台星科剥离，但仍要保持双方供应链的业务关系。2015 年 8 月，星科金朋与台星科签署了《技术服务协议》，协议约定了星科金朋每一年度向台星科采购的最低金额，若低于该额度，可将 5% 转到下年度执行，剩余差额以现金补足。

截至本募集说明书签署日，发行人无其他重大承诺事项。

## 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项

截至 2019 年 6 月末，发行人受限资产的账面价值合计 986,941.09 万元，其中货币资金的受限金额为 78,950.72 万元，主要为银票承兑汇票及保函、海关保证金；用于质押的应收票据账面价值为 1,733.56 万元；为取得银行借款用于抵押的固定资产账面价值为 875,418.10 万元；为取得银行借款用于质押的无形资产的账面价值为 30,838.70 万元。

图表 6.52：截至 2019 年 6 月末发行人合并范围大额受限资产明细

单位：万元

抵押/质权人	借款金额	资产明细	受限期限	
中国进出口银行	79,000	房地产+设备抵押	2017/12/4	2021/6/14
中国银行	33,150	房地产+设备抵押	2017/6/16	2022/12/20
建设银行	3,943.58	设备抵押	2015/9/30	2020/9/29
国开行	\$1,720	房产抵押	2015/3/10	2020/8/12
芯鑫租赁	27,756.72	长电科技持有香港长电国际的 6.5 亿人民币股权质押	2016/11/30	2020/3/7
芯鑫租赁	\$4,500	香港长电国际持有 JSCK 的 6950 万美元股权质押	2016/6/13	2021/10/19
香港中行	\$3,600	香港长电国际持有 JSCK 的 2500 万美	2016/8/18	2021/8/18

抵押/质权人	借款金额	资产明细	受限期限	
		无股权质押		
香港中行	\$5,000	香港长电国际持有芯鑫租赁 3.16% 股权质押	2017/12/19	2022/12/19
芯晟租赁	\$11,400	JCET-SC 持有 SCL 的 22.4% 股权质押	2018/7/23	2019/7/18
芯晟租赁	\$11,297	JCET-SC 持有 SCL 的 5% 股权质押	2019/5/28	2022/5/23
合计(折合人民币) <sup>1</sup>	401,592.09			

截至本募集说明书签署之日上述情况无重大变化,除以上所述事项之外,发行人不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

#### 十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况

截止2019年6月末,发行人持有衍生金融资产448.99万元,系发行人子公司星科金朋进行的远期结售汇交易,鉴于星科金朋签订的远期合约,因为预测套期保值交易具有很高的可能性,因此将其作为现金流量套期进行会计记录,并将此衍生工具指定为有效套期工具以其公允价值进行列示。

截止2019年6月末,发行人未从事大宗商品期货交易。

截止2019年6月末,发行人未持有理财产品。

#### 十一、海外投资情况

截止2019年6月末,发行人纳入合并范围的海外子公司如下表所示:

图表6.53: 发行人截止2019年6月末海外子公司清单

序号	公司名称	经营地	注册地	注册资本	持股比例	主营业务	级次
1	长电国际(香港)贸易投资有限公司	香港	香港	186,291.08万港元	100%	进出口贸易	一级
2	JCET Stats ChipPac Korea Ltd.	韩国	韩国	20,000.00万美元	100%	研制、开发、销售半导体、电子原件	二级
3	JCET-SC(SINGAPORE)PTE.LTD.	新加坡	新加坡	128,061.89万美元	100%	控股投资	三级
4	星科金朋	新加坡	新加坡	322,067.61万新加	100%	研制、开发、销售半导体、	四级

<sup>1</sup> 取2019年6月30日汇率,即1美元=6.87元人民币。

序号	公司名称	经营地	注册地	注册资本	持股比例	主营业务	级次
				坡元		电子原件	
5	STATS ChipPAC (Barbados) Ltd	巴巴多斯	巴巴多斯	24,533.21万美元	100%	投资控股	五级
6	STATS ChipPAC (BVI) Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	14,999.99万美元	100%	销售电子产品及原辅材料	五级
7	STATS ChipPAC Korea Co., Ltd	韩国	韩国	13,311,174.00万韩元	100%	研制、开发、销售半导体、电子原件	五级
8	STATS ChipPAC, Inc.	美国	美国	51.00美元	100%	销售电子产品及原辅材料	五级
9	STATS ChipPAC (Thailand) Ltd	泰国	泰国	12,500.00万泰铢	100%	研制、开发、销售半导体、电子原件	五级
10	STATS ChipPAC Services (Thailand) Limited	泰国	泰国	600.00万泰铢	100%	投资控股	五级
11	ChipPAC International Company Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	100.00美元	100%	控股投资	六级

发行人上述海外子公司主要分为两部分：

（一）长电科技自身原有在香港的贸易投资公司-长电国际（香港）贸易投资有限公司，主要对外进行进出口贸易业务、实业投资，注册资金24,800.00万美元。以及长电香港2015年在韩国投资成立JCET Stats ChipPac Korea Ltd.，投资高阶SiP产品封测项目。

（二）2015年末长电科技收购完成星科金朋后，星科金朋原来在新加坡、巴巴多斯、韩国、泰国等地区的子公司均成为发行人子公司。

## 十二、直接债务融资计划

截至本募集说明书签署之日，除本次注册的中期票据，发行人无其他直接债务融资计划。

## 第七章 发行人资信状况

### 一、公司债务融资的历史主体评级

1、2011 年 11 月 9 日，经大公国际资信评估有限公司评定，发行人 2012 年度第一期短期融资券信用等级为 A-1，该级别标识含义为：最高级短期债券，还本付息能力最强，安全性最高；评定发行人主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，该级别表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

2、2012 年 10 月 20 日，根据大公国际资信评估有限公司跟踪评级评定，维持评定发行人 2012 年度第一期短期融资券信用等级为 A-1，该级别标识含义为：最高级短期债券，还本付息能力最强，安全性最高；维持评定发行人主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，该级别表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

3、2013 年 3 月 13 日，根据大公国际资信评估有限公司跟踪评级评定，评定发行人 2013 年度第一期短期融资券信用等级为 A-1，该级别标识含义为：最高级短期债券，还本付息能力最强，安全性最高；维持评定发行人主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，该级别表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

4、2013 年 7 月 5 日，根据大公国际资信评估有限公司跟踪评级评定，评定发行人 2013 年度第一期短期融资券信用等级为 A-1，该级别标识含义为：最高级短期债券，还本付息能力最强，安全性最高；维持评定发行人主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，该级别表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

5、2014 年 1 月 23 日，根据联合资信评估有限公司跟踪评级评定，评定发行人 2013 年度第一期短期融资券信用等级为 A-1，该级别标识含义为：最高级短期债券，还本付息能力最强，安全性最高；维持评定发行人主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，该级别表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

6、2014 年 8 月 20 日，根据联合资信评估有限公司跟踪评级评定，评定发行人 2014 年度第一期短期融资券信用等级为 A-1，该级别标识含义为：最高级短期债券，还本付息能力最强，安全性最高；维持评定发行人主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，该级别表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

7、2015 年 4 月 14 日，根据联合资信评估有限公司跟踪评级评定，评定发行人 2015 年度第一期短期融资券信用等级为 A-1，该级别标识含义为：最高级短期



债券，还本付息能力最强，安全性最高；维持评定发行人主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，该级别表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

8、2015 年 9 月 9 日，根据联合资信评估有限公司跟踪评级评定，评定发行人 2015 年度第三期短期融资券信用等级为 A-1，该级别标识含义为：最高级短期债券，还本付息能力最强，安全性最高；维持评定发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，该级别表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

9、2015 年 9 月 23 日，根据联合资信评估有限公司跟踪评级评定，评定发行人 2015 年度第二期短期融资券信用等级为 A-1，该级别标识含义为：最高级短期债券，还本付息能力最强，安全性最高；维持评定发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，该级别表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

10、2015 年 11 月 23 日，根据联合资信评估有限公司跟踪评级评定，评定发行人 2015 年度第四期短期融资券信用等级为 A-1，该级别标识含义为：最高级短期债券，还本付息能力最强，安全性最高；维持评定发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，该级别表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

11、2016 年 4 月 7 日，根据联合资信评估有限公司跟踪评级评定，评定发行人 2015 年度第四期短期融资券信用等级为 A-1，该级别标识含义为：最高级短期债券，还本付息能力最强，安全性最高；维持评定发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，该级别表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

12、2016 年 7 月 29 日，根据联合资信评估有限公司跟踪评级评定，评定发行人 2015 年度第四期短期融资券信用等级为 A-1，该级别标识含义为：最高级短期债券，还本付息能力最强，安全性最高；维持评定发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，该级别表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

13、2019 年 7 月 8 日，根据中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级评定，评定发行人 2019 年度第一期中期票据信用等级为 AA+，评定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

## 二、中诚信国际评级报告摘要

### （一）评级观点

中诚信国际评定江苏长电科技股份有限公司的主体信用等级为 AA+，评级展

望为稳定；评定江苏长电科技股份有限公司 2019 年度第一期中期票据的债项信用等级为 AA+。

中诚信国际肯定了公司股东实力雄厚，支持力度很强，行业地位显著，规模优势明显，研发实力很强，专利储备丰富，融资渠道畅通等优势对其整体信用实力的支持。但同时，中诚信国际也关注到行业竞争激烈，盈利能力有待提升，面临商誉减值风险，境外业务政治风险及汇率波动风险较大，短期债务占比较高，债务结构有待优化等因素对其经营和整体信用状况的影响。

## （二）优势

1、股东实力雄厚，支持力度很强。截至 2019 年 6 月末，国家集成电路产业投资基金股份有限公司和芯电半导体（上海）有限公司对发行人的持股比例为 19.00% 和 14.28%，其中国家集成电路产业投资基金股份有限公司系为促进国家集成电路产业发展而设立的国家产业投资基金，芯电半导体（上海）有限公司最终控股股东为世界领先的集成电路晶元代工企业之一中芯国际集成电路制造有限公司。近年来股东通过与公司共同出资并购、参与定增等方式向发行人提供资金帮助，支持力度很强。

2、行业地位显著，规模优势明显。发行人是中国内地最大、全球第三大的集成电路委外封装测试企业，全球前二十大半导体公司中大部分已成为其客户；发行人于中国江阴、滁州及新加坡、韩国设有不同特色的生产基地，具有很强的规模优势。

3、研发实力很强，专利储备丰富。发行人自成立以来，一直重视研发和技术创新，截至 2018 年末已拥有专利 3,673 件，其中发明专利 2844 件（美国专利 1798 件），覆盖中高端封测领域，研发实力很强。

4、融资渠道畅通。发行人为 A 股上市公司，近年来多次通过非公开发行股票募集资金；此外，截至 2019 年 6 月末，公司获得银行等金融机构授信总额达到 189.27 亿元，其中尚未使用的额度为 37.81 亿元，直接和间接融资渠道畅通。

## （三）关注

1、行业竞争激烈，盈利能力有待提升，且面临商誉减值风险。集成电路行业技术要求高，更新换代快，需要企业不断进行创新和研发投入；受子公司持续亏损且期间费用维持在较高水平等因素影响，公司盈利能力有待提升。截至 2018 年末因收购星科金朋形成的商誉减值价值为 22.71 亿元，公司已对其累计计提商誉减值准备 3.66 亿元，若星科金朋经营不达预期，未来仍将面临一定商誉减值风险。

2、境外业务占比较高，或面临政治风险或汇率波动风险。受下游大客户主要为境外厂商影响，公司销售以外销为主，近年来境外销售收入占比均超过 75%，

随着中美贸易摩擦的进行,较大规模的境外销售或将面临一定政治风险和汇率波动风险。

3、短期债务占比较高,债务结构有待优化。截至 2019 年 6 月末,公司总债务为 206.48 亿元,其中短期债务占比为 82.14%,公司债务结构有待优化。

### 三、跟踪评级有关安排

信用评级报告及跟踪评级安排的具体内容请见以下网址:

中国货币网: <http://www.chinamoney.com.cn>

上海清算所网站: <http://www.shclearing.com>

### 四、公司其他资信情况

#### (一) 公司主要银行授信情况

##### 1、授信情况

发行人与多家金融机构均保持良好的业务合作关系,截至 2019 年 6 月末,公司共获得各银行授信额度共计人民币 189.27 亿元,其中已使用 150.38 亿元,尚未使用 37.81 亿元,公司间接融资渠道畅通。公司系 A 股上市公司,直接融资渠道畅通。

图表7.1: 截至2019年6月末银行授信情况

单位: 亿元

授信银行	授信额度	已使用额度	未使用额度
工商银行	6.50	5.48	1.02
农业银行	3.50	3.50	0.00
建设银行	8.00	5.12	2.88
中国银行	24.91	19.85	3.98
民生银行	4.00	2.60	1.40
招商银行	10.00	7.30	2.70
华夏银行	5.00	5.00	0.00
交通银行	4.50	4.43	0.07
浦发银行	7.20	5.80	1.40
兴业银行	11.00	9.63	1.37
进出口行	10.40	10.40	0.00
广发银行	6.00	6.00	0.00

授信银行	授信额度	已使用额度	未使用额度
邮储银行	5.00	4.50	0.50
中信银行	8.00	5.40	2.60
北京银行	1.50	1.00	0.50
光大银行	2.00	1.21	0.79
南洋银行	1.68	1.39	0.29
宁波银行	3.00	1.87	1.13
平安银行	5.00	2.72	2.28
农商银行	1.00	1.00	0.00
比利时银行	1.03	1.03	0.00
国开行	1.18	1.18	0.00
芯鑫租赁	33.56	21.48	12.08
星展银行	13.06	13.06	0.00
凯基银行	3.44	3.44	0.00
新韩银行	2.68	2.03	0.65
国民银行	1.58	0.55	1.03
产业银行	0.71	0.71	0.00
韩亚银行	3.43	2.29	1.14
友利银行	0.41	0.41	0.00
<b>合计</b>	<b>189.27</b>	<b>150.38</b>	<b>37.81</b>

## （二）发行人债务违约情况

截至本募集说明书签署日，发行人未出现债务违约情况。

## （三）发行人债务融资工具偿付情况

发行人于 2012 年 4 月 25 日在全国银行间债券市场发行了 4 亿元的短期融资券（12 长电科技 CP01），短期融资券代码 041260022，期限为 365 天，到期日为 2013 年 4 月 26 日，已按期兑付。

发行人于 2013 年 3 月 26 日在全国银行间债券市场发行了 3 亿元的短期融资券（13 长电科技 CP001），短期融资券代码 041360017，期限为 365 天，到期日为 2014 年 3 月 27 日，已按期兑付。

发行人于 2013 年 10 月 15 日在全国银行间债券市场发行了 3 亿元的非公开定向债务融资工具（13 长电科技 PPN001），代码 031390331，期限 1 年，到期日为 2014

年 10 月 15 日，已按期兑付。

发行人于 2014 年 6 月 19 日发行在全国银行间债券市场发行了 3 亿元的短期融资券（14 长电科技 CP001），短期融资券代码 041453073，期限为 365 天，到期日为 2015 年 6 月 19 日，已按期兑付。

发行人于 2014 年 9 月 23 日在全国银行间债券市场发行了 4 亿元的非公开定向债务融资工具（14 长电科技 PPN001），代码 031490836，期限 1 年，到期日为 2015 年 9 月 23 日，已按期兑付。

发行人于 2014 年 11 月 14 日在全国银行间债券市场发行了 6 亿元的非公开定向债务融资工具（14 长电科技 PPN002），代码 031491005，期限 1 年，到期日为 2015 年 11 月 14 日，已按期兑付。

发行人于 2015 年 6 月 24 日发行在全国银行间债券市场发行了 4 亿元的短期融资券（15 长电科技 CP001），短期融资券代码 041554042，期限为 366 天，到期日为 2016 年 6 月 24 日，已按期兑付。

发行人于 2015 年 10 月 13 日发行在全国银行间债券市场发行了 3 亿元的短期融资券（15 长电科技 CP002），短期融资券代码 041560090，期限为 366 天，到期日为 2016 年 10 月 13 日，已按期兑付。

发行人于 2015 年 10 月 22 日发行在全国银行间债券市场发行了 3 亿元的短期融资券（15 长电科技 CP003），短期融资券代码 041553087，期限为 366 天，到期日为 2016 年 10 月 22 日，已按期兑付。

发行人于 2015 年 10 月 30 日在全国银行间债券市场发行了 4 亿元的非公开定向债务融资工具（15 长电科技 PPN001），代码 031564153，期限为 180 天，到期日为 2016 年 4 月 30 日，已按期兑付。

发行人于 2015 年 12 月 17 日发行在全国银行间债券市场发行了 6 亿元的短期融资券（15 长电科技 CP004），短期融资券代码 041560115，期限为 366 天，到期日为 2016 年 12 月 18 日，已按期兑付。

## 第八章 担保

本期中期票据无担保。

## 第九章 税项

本期中期票据的持有人应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本章的分析是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定作出的。如果相关的法律、法规发生变更，本章中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。

下列说明仅供参考，所列税项不构成对投资者的法律或税务建议，也不涉及投资本期中期票据可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期中期票据，并且投资者又属于按照法律、法规的规定需要遵守特别税务规定的投资者，投资者应就有关税务事项咨询专业财税顾问，发行人不承担由此产生的任何责任。

### 一、投资债务融资工具所纳税项

#### （一）增值税

根据 2016 年 5 月 1 日生效的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号），债务融资工具利息收入及买卖价差收入需要缴纳增值税。

#### （二）所得税

根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的法律、法规，企业投资者来源于企业债券的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的债券利息计入企业当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。

#### （三）印花税

根据 1988 年 10 月 1 日生效的《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则，在我国境内买卖、继承、赠与、交换、分割等所书立的产权转移书据，均应缴纳印花税。

但对中期票据在全国银行间债券市场进行的交易，《中华人民共和国印花税暂行条例》尚未列举对其征收印花税。因此，截至本募集说明书之日，投资者买卖、赠与或继承中期票据而书立转让书据时，应不需要缴纳印花税。本公司无法预测国家是否或将会于何时决定对有关中期票据交易征收印花税，也无法预测将会适用税率的水平。

## 二、声明

投资者所应缴纳的上述税项不与中期票据的各项支出构成抵销,上述税项不构成对投资者的纳税建议和纳税依据。



## 第十章 信息披露安排

发行人将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等文件的相关规定，开展相关信息披露工作。披露时间不晚于发行人在证券交易所、指定媒体或其他场合向市场公开披露的时间。

### 一、本期债务融资工具发行前的信息披露

公司在本期债务融资工具发行日2个工作日前，通过中国货币网和上海清算所网站披露如下文件：

- 1、江苏长电科技股份有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书；
- 2、江苏长电科技股份有限公司2019年度第一期中期票据信用评级报告；
- 3、江苏长电科技股份有限公司2019年度第一期中期票据法律意见书；
- 5、近三年经审计的合并及母公司财务报告及2019年半年度未经审计合并及母公司财务报表；
- 6、银行间市场交易商协会要求的其他文件。

### 二、存续期内重大事项的信息披露

发行人在本期中期票据存续期内，可选择采用书面材料邮寄方式、在中国货币网和上海清算所网站公开披露方式两种方式中的任意一种向本协议附件三所载的所有投资人定期披露以下信息：

- 1、每年4月30日以前，披露经注册会计师审计的上一年度财务报表和审计报告；
- 2、每年8月31日以前，披露本年度上半年的资产负债表、利润表和现金流量表；
- 3、每年4月30日和10月31日以前，披露本年度第一季度和第三季度的资产负债表、利润表和现金流量表。

第一季度信息披露时间不得早于上一年度信息披露时间。

### 三、本期中期票据存续期内的定期信息披露安排

发行人在各期中期票据存续期间，可选择采用书面材料邮寄方式、通过在中国货币网和上海清算所网站公开披露的方式两种方式中的任意一种向本协议附件三所载的所有投资人披露可能影响投资人实现其债权的重大事项，包括：

- (一) 企业名称、经营方针和经营范围发生重大变化;
- (二) 企业生产经营的外部条件发生重大变化;
- (三) 企业涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同;
- (四) 企业发生可能影响其偿债能力的资产抵押、质押、出售、转让、划转或报废;
- (五) 企业发生未能清偿到期重大债务的违约情况;
- (六) 企业发生大额赔偿责任或因赔偿责任影响正常生产经营且难以消除的;
- (七) 企业发生超过净资产 10% 以上的重大亏损或重大损失;
- (八) 企业一次免除他人债务超过一定金额, 可能影响其偿债能力的;
- (九) 企业三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长或者总经理发生变动; 董事长或者总经理无法履行职责;
- (十) 企业做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定, 或者依法进入破产程序、被责令关闭;
- (十一) 企业涉及需要说明的市场传闻;
- (十二) 企业涉及重大诉讼、仲裁事项;
- (十三) 企业涉嫌违法违规被有权机关调查, 或者受到刑事处罚、重大行政处罚; 企业董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施;
- (十四) 企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况; 企业主要或者全部业务陷入停顿, 可能影响其偿债能力的;
- (十五) 企业对外提供重大担保。

#### 四、本期中期票据本息兑付前的信息披露安排

公司将在本期债务融资工具本息兑付日前 5 个工作日, 通过中国货币网和上海清算所网站公布本金兑付和付息事项。

如有关信息披露管理制度发生变化, 公司将依据其变化对于信息披露作出调整。

#### 五、发行人承诺

1、公司承诺在本期债务融资工具的发行和交易过程遵循公开、公平、公正、诚信的原则。

2、公司承诺将严格按照中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及配套文件的相关规定, 遵循诚实信用的原则, 真实、准确、完整、及时地进行信息披露, 承诺在所有信息披露的过程中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司承诺将对本期债务融资工具持有人按时足额兑付本息。

4、公司声明自愿接受中国银行间市场交易商协会的自律管理。

## 第十一章 投资者保护机制

为保证按期足额偿付中期票据，发行人制定了相应的偿债计划和保障措施。此外，中期票据的债权人还可以依据法律法规的规定和本募集说明书的约定，以中期票据持有人会议的形式行使有关权利。

### 一、违约事件

如下列任何一项事件发生及继续，则投资者均可向发行人或主承销商（如有代理追偿责任）发出书面通知，表明应即刻启动投资者保护机制。在此情况下，发行人或主承销商（如有代理追偿责任）应依据本条款有关规定即刻启动投资者保护机制。有关事件在发行人或主承销商接获有关通知前已予以纠正的，则另作别论：

1. 拖欠付款：未按期兑付本期中期票据本金或本期中期票据应付利息；
2. 解散：发行人于所有未赎回中期票据获赎回前解散或因其它原因不再存在，因获准重组引致的解散除外；
3. 破产：发行人破产、全面无力偿债、拖欠到期应付款项、停止/暂停支付所有或大部份债务或终止经营其业务，或发行人根据《破产法》规定进入破产程序。

### 二、违约责任

1. 发行人对本期中期票据投资者按时还本付息。如果发行人未能按期向上海清算所指定的资金账户足额划付资金，上海清算所将在本期中期票据本息支付日，通过中国货币网和上海清算所网站及时向投资人公告发行人的违约事实。发行人到期未能偿还本期中期票据本息，投资者可依法提起诉讼。

2. 投资者未能按时交纳认购款项的，应按照延期缴款的天数以日利率万分之二点一（0.21%）承担违约责任。发行人有权根据情况要求投资者履行协议或不履行协议。

### 三、投资者保护机制

#### （一）应急事件

应急事件是指突然出现的，可能导致债务融资工具不能按期、足额兑付，并可能影响到金融市场稳定的事件。

在各期债务融资工具存续期内单独或同时发生下列应急事件时，可以启动投资者保护应急预案：

1. 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务；

2. 发行人或发行人的高级管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到债务融资工具的按时、足额兑付；

3. 发行人发生超过净资产 10%以上重大损失（包括投资损失和经营性亏损），且足以影响到债务融资工具的按时、足额兑付；

4. 发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

5. 发行人受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，且足以影响债务融资工具的按时、足额兑付；

6. 其他可能引起投资者重大损失的事件。

应急事件发生后，发行人和主承销商应立即按照本章的约定启动投资者保护应急预案，保障投资者权益，减小对债券市场的不利影响。

#### （二）投资者保护应急预案的启动

投资者可以在发生上述应急事件时，向发行人和主承销商建议启动投资者保护应急预案；或由发行人和主承销商在发生应急事件后主动启动应急预案；也可在监管机构认为必要时要求启动应急预案。

发行人和主承销商启动应急预案后，可采取下列某项或多项措施保护债权。

1. 公开披露有关事项；
2. 召开持有人会议，商议债权保护有关事宜。

#### （三）信息披露

在出现应急事件时，发行人将主动与主承销商、评级机构、监管机构、媒体等方面及时沟通，并通过指定媒体披露该事件。

应急事件发生时的信息披露工作包括：

1. 跟踪事态发展进程，协助主承销商发布有关声明；
2. 听取监管机构意见，按照监管机构要求做好有关信息披露工作；
3. 主动与评级机构互通情况，督促评级机构做好跟踪评级，并及时披露评级信息；
4. 适时与主承销商联系发布关于应急事件的处置方案，包括信用增级措施、提前偿还计划以及持有人会议决议等；
5. 适时与主承销商联系发布关于应急事件的其他有关声明。

#### （四）持有人会议

持有人会议是指在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议。

## 1. 持有人会议的召开条件

主承销商作为本期债务融资工具的持有人会议的召集人。在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议，并拟定会议议案。

- (1) 发行人未能按照约定足额兑付债务融资工具本金或利息；
- (2) 发行人转移债务融资工具全部或部分清偿义务；
- (3) 发行人变更信用增进安排或信用增进机构，对债务融资工具持有人权益产生重大不利影响的；
- (4) 发行人或者信用增进机构减资、合并、分立、解散、申请破产被接管、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (5) 发行人或者信用增进机构因资产无偿划转、资产转让、债务减免、股权交易、股权托管等原因导致发行人或者信用增进机构净资产减少单次超过最近经审计净资产的百分之十或者两年内累计超过净资产（以首次减资行为发生时对应的最近经审计净资产为准）的百分之十，或者虽未达到上述指标，但对发行人或者信用增进机构的生产、经营影响重大；
- (6) 单独或合计持有百分之三十以上同期债务融资工具余额的持有人提议召开；
- (7) 募集说明书中约定的其他应当召开持有人会议的情形；
- (8) 法律、法规规定的其他应由持有人会议做出决议的情形。

出现上述情形时，发行人应当及时告知召集人。召集人应当自知悉该情形之日起在实际可行的最短期限内召集持有人会议，并拟定会议议案。持有人会议的召集不以发行人或者信用增进机构履行告知义务为前提。

召集人不能履行或者不履行召集职责的，单独或合计持有百分之三十以上同期债务融资工具余额的持有人、发行人、主承销商或信用增进机构均可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责。

在债务融资工具存续期间，发行人或信用增进机构出现《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》列明的重大事项或信息披露变更事项情形之一的，召集人可以召集持有人会议；单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人、发行人和信用增进机构可以向召集人书面提议召开持有人会议，召集人应自收到提议之日起五个工作日内向提议人书面回复是否同意召集持有人会议。

召集人不能履行或者不履行召集职责的，提议人有权自行召集持有人会议，履行召集人的职责。

## 2. 持有人会议的召集

召集人应当至少于持有人会议召开日前十个工作日在上海清算所网站、中国

货币网和交易商协会网站发布召开持有人会议的公告。召开持有人会议的公告内容包括但不限于下列事项：

- (1) 债务融资工具发行情况、持有人会议召开背景；
- (2) 会议召集人、会务负责人姓名及联系方式；
- (3) 会议时间和地点；
- (4) 会议召开形式：持有人会议可以采用现场、非现场或两者相结合的形式；
- (5) 会议拟审议议题：议题属于持有人会议权限范围、有明确的决议事项，并且符合法律、法规和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的相关规定；
- (6) 会议议事程序：包括持有人会议的召集方式、表决方式、表决时间和其他相关事宜；
- (7) 债权登记日：应为持有人会议召开日前一工作日；
- (8) 提交债券账务资料以确认参会资格的截止时点：债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权；
- (9) 委托事项：参会人员应出具授权委托书和身份证明，在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务。

召集人应当至少于持有人会议召开日前七个工作日将议案发送至持有人，并将议案提交至持有人会议审议。

### 3. 持有人会议参会机构

债务融资工具持有人应当于债权登记日向中国人民银行认可的银行间债券市场债券登记托管结算机构申请查询本人当日的债券账务信息，并于会议召开日提供相应债券账务资料以证明参会资格。召集人应当对债务融资工具持有人的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。

除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权出席或者通过出具书面授权书委托合格代理人出席持有人会议。

发行人、债务融资工具清偿义务承继方、信用增进机构等重要关联方应当按照召集人的要求列席持有人会议。交易商协会可以派员列席持有人会议。

持有人会议应当有律师见证。见证律师原则上由为债务融资工具发行出具法律意见的律师担任。非协会会员单位的律师事务所的律师见证持有人会议并出具法律意见的，该律师事务所应当向交易商协会书面声明自愿接受交易商协会自律管理，遵守交易商协会的相关自律规定。

见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。法律意见书应当与持有人会议决议一同披露。

信用评级机构可应召集人邀请列席会议，密切跟踪持有人会议动向，并及时发表公开评级意见。

#### 4. 持有人会议的表决和决议

债务融资工具持有人及其代理人行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。发行人、发行人母公司、发行人下属子公司、债务融资工具清偿义务承继方等重要关联方没有表决权。

除募集说明书另有约定外，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的三分之二以上，会议方可生效。持有人会议的议事程序和表决形式，除《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及本募集说明书有规定外，由召集人规定。

持有人会议对列入议程的各项议案分别审议，逐项表决。持有人会议不得对公告通知中未列明的事项进行决议。单独或合计持有该债务融资工具余额百分之十以上的债务融资工具持有人可以提议修正议案，并提交会议审议。

持有人应当至少于持有人会议召开日前五个工作日以书面形式向召集人提出修订议案，召集人应当至少于持有人会议召开前三个工作日将修订议案发送至持有人，并提交至持有人会议审议。

持有人会议的全部议案在会议召开日后三个工作日内表决结束。

召集人应当于表决截止日向中国人民银行认可的银行间债券市场债券登记托管结算机构申请查询和核对相关债项持有人当日债券账务信息，表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票。

持有人投弃权票的，其所持有的债务融资工具面额计入议案表决的统计中。持有人未做表决或者投票不规范的，视为该持有人投弃权票。

除募集说明书另有约定外，持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持有的表决权的四分之三以上通过后生效。

除因触发《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》第七条第六项规定而召开持有人会议的，因会议有效性或者议案表决有效性未达到本规程所规定的持券比例的，召集人可就本重大事项自行判断是否需要再次召集会议。

持有人会议应有书面会议记录。持有人会议记录由出席会议的召集人代表和律师签名。

召集人应当在持有人会议表决日次一工作日将会议决议公告在上海清算所网站、中国货币网和交易商协会网站披露。会议决议公告包括但不限于以下内容：

- (1) 出席会议的本期债务融资工具持有人（代理人）所持表决权情况；



- (2) 会议有效性;
- (3) 各项议案的议题和表决结果。

如需要发行人答复的,召集人在会议表决截止日次一工作日将会议决议提交至发行人,并代表债务融资工具持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关机构进行沟通。发行人应当自收到会议决议之日起三个工作日内答复是否接受持有人会议通过的决议。

持有人会议的会议公告、会议议案、参会机构与人员以及表决机构与人员名册、会议记录、表决文件、会议决议公告、发行人的答复(若持有人会议决议需发行人答复)、法律意见书、召集人自登记托管机构获取的债权登记日日终和会议表决截止日日终债务融资工具持有人名单等会议文件和资料由召集人保管,并至少保管至对应债务融资工具兑付结束后五年。

如召集人为发行人或者信用增进机构的,上述会议文件、材料由见证持有人会议的律师所在的律师事务所存档。

5、发行人承诺本次债务融资工具的募集资金不用于并购或收购资产,承诺募集资金应用符合国家法律法规及政策要求,不得用于长期投资以及委托贷款、担保等金融业务。

#### 四、不可抗力

(一) 不可抗力是指本期中期票据计划公布后,由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况,致使中期票据相关责任人不能履约的情况。

(二) 不可抗力包括但不限于以下情况:

1. 自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等;
2. 国际、国内金融市场风险事故的发生;
3. 交易系统或交易场所无法正常工作;
4. 社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。

(三) 不可抗力事件的应对措施

1. 不可抗力发生时,发行人或主承销商、联席主承销商应及时通知投资者及中期票据相关各方,并尽最大努力保护中期票据投资者的合法权益。

2. 发行人或主承销商、联席主承销商应召集中期票据投资者会议磋商,决定是否终止中期票据或根据不可抗力事件对中期票据的影响免除或延迟相关义务的履行。

#### 六、弃权

任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利,或宣布对方违约

仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。

## 第十二章 发行有关机构

### 一、发行有关机构的信息披露

- 1. 发行人:** 江苏长电科技股份有限公司  
注册地址: 江苏省无锡市江阴市澄江镇长山路 78 号  
法定代表人: LEE CHOON HEUNG  
联系人: 沈菊  
电话: 0510-86199126  
传真: 0510-86199000  
邮编: 214429
- 2. 主承销商:** 招商银行股份有限公司  
地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦  
法定代表人: 李建红  
联系人: 王斐  
电话: 021-20625967  
传真: 021-20777755-5967  
邮政编码: 200120
- 中国工商银行股份有限公司  
地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号  
法定代表人: 陈四清  
联系人: 蒋琛  
电话: 010-81011708  
传真: 010-66107567  
邮政编码: 100140
- 4. 律师事务所:** 江苏世纪同仁律师事务所  
注册地址: 南京中山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋 5 楼  
负责人: 王凡

联系人: 阚赢  
电话: 025- 83316106  
传真: 025-83329335  
邮编: 210016

**5. 会计师事务所:** 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
地址: 北京市东城区东长安街一号东方广场安永大楼 16 层  
负责人: 毛鞍宁  
联系人: 曾志林  
电话: 0512-67633238  
传真: 0512-67639292  
邮编: 215021

**6. 信用评级机构:** 中诚信国际信用评级有限责任公司  
联系地址: 北京东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO6 号楼  
法定代表人: 闫衍  
联系人: 李迪  
电话: 010-66428877  
传真: 010-66426100  
邮编: 100010

**7. 登记、托管、结算机构:** 银行间市场清算所股份有限公司  
住所: 上海市黄浦区北京东路 2 号  
法定代表人: 谢众  
联系人: 发行岗  
联系电话: 021-23198888  
传真: 021-63326661

**8.集中簿记建档系统** 北京金融资产交易所有限公司  
**技术支持机构:** 地址: 北京市西城区金融大街乙17号  
法定代表人: 郭欠  
联系人: 发行部  
电话: 010-57896722、010-57896516  
传真: 010-57896726  
邮政编码: 100032

## 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系

发行人与上述发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

## 第十三章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、发行人主体信用评级报告及跟踪评级安排；
- 2、江苏长电科技股份有限公司 2016 年、2017 年、2018 年合并及母公司审计报告、2019 年 1-6 月合并及母公司财务报表；
- 3、江苏长电科技股份有限公司 2019 年度第一期中期票据法律意见书；
- 4、江苏长电科技股份有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书。

### 二、查询地址

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人、主承销商和联席主承销商。

(一) 发行人：江苏长电科技股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市江阴市澄江镇长山路 78 号

法定代表人：LEE CHOON HEUNG

联系人：沈菊

电话：0510-86199126

传真：0510-86199000

邮编：214429

(二) 招商银行股份有限公司

地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：王楠

电话：0755-88026165

传真：0755-83195057

邮政编码：200120

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）下载本募集说明书，或在本期中期票据发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

## 附录 指标计算公式

指标名称	计算公式
资产负债率(%)	负债合计/资产总计×100%
流动比率(%)	流动资产合计/流动负债合计×100%
速动比率(%)	(流动资产合计-存货余额)/流动负债合计×100%
EBITDA利息倍数	EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)
EBIT	利润总额+计入财务费用的利息支出
EBITDA	EBIT+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
应收账款周转率 (次)	营业收入/应收账款平均余额
存货周转率(次)	营业成本/存货平均余额
毛利润率(%)	(营业收入-营业成本)/营业收入
总资产报酬率(%)	(利润总额+列入财务费用的利息支出)/总资产平均余额 ×100%
净资产收益率(%)	归属于母公司所有者的净利润/归属母公司所有者权益平均 余额×100%
长期资本化率	长期债务/(长期债务+所有者权益(含少数股东权益))
总资本化率	总债务/(总债务+所有者权益(含少数股东权益))
总债务	长期借款+应付债券+短期借款+应付票据+应付短期债券+一 年内到期的非流动负债+交易性金融负债
长期债务	长期借款+应付债券
短期债务	短期借款+应付票据+应付短期融资券+一年内到期的非流动 负债+交易性金融负债



(本页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书》之盖章页)

江苏长电科技股份有限公司

2019 年 9 月 7 日

